

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

江苏捷捷微电子股份有限公司
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co., Ltd

(注册地址：江苏省启东科技创业园兴龙路8号)

首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书（申报稿）

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。



保荐人（主承销商）

西南证券股份有限公司

（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次发行股票数量不超过 2,360 万股，其中公开发行新股的数量不超过 2,360 万股，公司相关股东公开发售股份数量不超过 1,000 万股，公开发行新股的数量与股东公开发售的股份数量合计不超过本次公开发行股票的上限，即 2,360 万股，公司优先发行新股；最终发行数量以中国证监会核准的额度为准。本次发行新股数量与公司股东公开发售股份数量之和，不低于本次发行后总股本的 25%。
新股发行数量	【 】万股
股东公开发售数量	【 】万股，股东公开发售股份所得资金不归发行人所有
每股面值	人民币 1 元
每股发行价格	【 】元
预计发行日期	【 】年【 】月【 】日
拟上市的证券交易所	深圳证券交易所
发行后总股本	【 】万股
保荐人、主承销商	西南证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【 】年【 】月【 】日

重大事项提示

本公司特别提醒投资者关注下列风险及其他重要事项，并请认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。

一、股东关于股份锁定的承诺

(一) 发行人实际控制人黄善兵、控股股东捷捷投资、股东蓉俊投资和间接持有发行人股份的黄健、李燕分别承诺：

除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

除前述锁定期外，在黄善兵于发行人处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；黄善兵申报离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，若需减持的，减持价格将不低于发行价。

黄健自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的捷捷投资、蓉俊投资的股份，也不由捷捷投资、蓉俊投资回购该部分股权。

李燕自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的蓉俊投资的股份，也不由蓉俊投资回购该部分股权。

(二) 发行人股东南通中创投资管理有限公司、担任发行人高级管理人员的股东张祖蕾和间接持有发行人股份的沈卫群、张家铨分别承诺：

除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

除前述锁定期外，在张祖蕾和沈卫群任意一人于发行人处任职期间，每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的百分之二十五；张祖蕾或沈卫群离职后的六个月内，不转让本人持有的发行人股份。锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，若需减持的，减持价格将不低于发行价。

张祖蕾或沈卫群自发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让持有的发行人股份；若张祖蕾或沈卫群在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让持有的发行人股份。

（三）其他担任发行人董事、高级管理人员的股东王成森、沈欣欣分别承诺：

除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；申报离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。自发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。

锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，若需减持的，减持价格将不低于发行价。

（四）担任发行人监事的股东张玉平、薛治祥分别承诺：

除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；申报离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。自发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。

（五）发行人其余 15 名股东分别承诺：

除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（六）控股股东、实际控制人及 5%以上股东锁定期满后减持意向

序号	股东姓名 或名称	持股数量 (万股)	持股比 例	锁定期满后的减持意向
1	江苏捷捷投资有限公司	3,000.00	42.87%	锁定期（包括延长的锁定期限）届满后24个月内，若需减持，须提前三个交易日予以公告，且每12个月内减持数量不超过发行后总股本的2%，减持价格将不低于发行价。如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。
	南通蓉俊投资管理有限公司	240.00	3.43%	
	黄善兵	960.00	13.72%	
2	南通中创投资管理有限公司	680.00	9.71%	锁定期（包括延长的锁定期限）届满后24个月内，若需减持，须提前三个交易日予以公告，且减持价格将不低于发行价。如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。
	张祖蕾	400.00	5.71%	
3	王成森	480.00	6.86%	锁定期（包括延长的锁定期限）届满后24个

				月内，若需减持，须提前三个交易日予以公告，且减持价格将不低于发行价。如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。
4	天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	400.00	5.71%	锁定期（包括延长的锁定期限）届满后24个月内，若需减持，须提前三个交易日予以公告，且减持价格将不低于发行价。如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。

前述承诺人一致承诺如违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人将违规减持股票所得归公司所有，同时本人持有的剩余股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。

二、关于公司首发上市后股价低于每股净资产时稳定股价预案的承诺

（一）发行人就稳定公司股价事宜的承诺

公司首次公开发行股票并上市后 3 年内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后发生除权除息事项，每股净资产相应进行调整)，且满足监管机构对于增持公司股份的规定条件，则触发公司回购股份的义务，公司董事会应于确认前述事项之日起 10 个工作日内公告回购公司股份的方案，方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容，并提交公司股东大会审议，回购方案经公司股东大会审议通过后生效。如在股东大会会议通知发出后至股东大会召开日期间，公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产，股东大会可决议终止实施该次回购计划。

公司应自股东大会审议通过回购事项之日起 3 个月内遵循以下原则回购公

公司股份：第一、单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；第二、单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属母公司股东净利润的 50%，超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案；第三、公司回购股份的价格不高于最近一期经审计的每股净资产的金额，如股票收盘价已回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产，则公司可终止该次回购股份计划。

公司回购本公司股份的行为应符合我国法律、法规、规范性文件和证券交易所关于上市公司回购股份的相关规定。

该次稳定股份措施实施完毕后 2 个交易日内，公司应将本次稳定股份措施实施情况予以公告。该次稳定股份措施实施完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则公司将按照上述规定再次履行回购计划。

(二) 控股股东捷捷投资就稳定公司股价事宜的承诺

发行人首次公开发行股票并上市后 3 年内，如发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后发生除权除息事项，每股净资产相应进行调整)，且发行人未履行稳定公司股价措施或虽履行稳定股价措施但发行人股票价格仍低于每股净资产，则触发捷捷投资增持发行人股份的义务，捷捷投资将通过证券交易所认可的方式增持发行人股份，单次增持股份金额不低于上一年度本公司从发行人处取的现金分红金额的 10%，增持价格不高于最近一期经审计的每股净资产的金额，单一会计年度累计增持股份的金额达到上一年度捷捷投资从发行人处取的现金分红金额的，有关稳定股价措施在当年度不再继续执行。

捷捷投资将于前述 2 个交易日收盘后启动稳定公司股价的措施并自启动日起 2 个交易日内以书面形式向公司提交本次增持股票的具体增持计划，包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间，价格区间、实施期限等信息并公告。自公告次日起，捷捷投资即实施该次增持计划。该次增持实施完毕后，如再次出现公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后发生除权除息事项，每股净资产相应进行调整)，则捷捷投资将依据前

述承诺继续履行增持义务。

如出现下述情形，捷捷投资可终止该次增持计划：

1、发行人公告启动稳定股价的措施但尚未实施时，发行人股票收盘价已经回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产，则捷捷投资可以不再继续实施稳定股价的措施；

2、捷捷投资实施该次增持计划将导致发行人不符合上市条件。

捷捷投资如未按照上述承诺实施稳定股价措施，发行人有权将其用于回购股票的等额资金从应付捷捷投资的现金分红中予以扣除，前述扣除的现金分红归发行人所有。

（三）实际控制人黄善兵稳定公司股价事宜承诺如下：

公司首次公开发行股票并上市后 3 年内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后发生除权除息事项，每股净资产相应进行调整)，且公司控股股东未履行稳定公司股价措施或虽履行稳定股价措施但公司股票价格仍低于每股净资产，则触发本人增持公司股份的义务，本人在满足监管机构对于增持公司股份规定条件的前提下将通过证券交易所认可的方式增持公司股份，累计增持资金金额不低于本人上一年度从发行人处领取的薪酬总额及现金分红之和的 50%，增持价格不高于最近一期经审计的每股净资产的金额。该次增持实施完毕后，如再次出现公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后发生除权除息事项，每股净资产相应进行调整)，则本人将依据前述承诺继续履行增持义务。

本人将于前述 20 个交易日收盘后启动稳定公司股价的措施并自启动日起 2 个交易日内以书面形式向公司提交本次增持股票的具体增持计划，包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间，价格区间、实施期限等信息并公告。自公告次日起，本人即实施该次增持计划。该次增持实施完毕后，如再次出现公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后发生除权除息事项，每股净资产相应进行调整)，则本人将依据前述承诺继续履行增持义务。

如出现下述情形，本人可终止该次增持计划：

(1) 公司公告启动稳定股价的措施但尚未实施时，公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产，则公司可以不再继续实施稳定股价的措施；

(2) 本人实施该次增持计划将导致公司不符合上市条件。

本人如未按照上述承诺实施稳定股价措施，公司有权将其用于回购股票的等额资金从应付本人的现金分红中予以扣除，前述扣除的现金分红归公司所有。

(四) 不持有发行人股份不在发行人处领薪的董事盛波先生就稳定公司股价事宜的承诺：

公司首次公开发行股票并上市后 3 年内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后发生除权除息事项，每股净资产相应进行调整)，且公司控股股东未履行稳定公司股价措施或虽履行稳定股价措施但公司股票价格仍低于每股净资产，则触发本人增持公司股份的义务，本人在满足监管机构对于增持公司股份规定条件的前提下将通过证券交易认可的方式增持公司股份，累计增持资金金额不低于 5 万元人民币，增持价格不高于最近一期经审计的每股净资产的金额。该次增持实施完毕后，如再次出现公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后发生除权除息事项，每股净资产相应进行调整)，则本人将依据前述承诺继续履行增持义务。

本人将于前述 20 个交易日收盘后启动稳定公司股价的措施并自启动日起 2 个工作日内以书面形式向公司提交本次增持股票的具体增持计划，包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间，价格区间、实施期限等信息并公告。自公告次日起，本人即实施该次增持计划。该次增持实施完毕后，如再次出现公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后发生除权除息事项，每股净资产相应进行调整)，则本人将依据前述承诺继续履行增持义务。

如出现下述情形，本人可终止该次增持计划：

(1) 公司公告启动稳定股价的措施但尚未实施时, 公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产, 则公司可以不再继续实施稳定股价的措施;

(2) 本人实施该次增持计划将导致公司不符合上市条件。

本人如未按照上述承诺实施稳定股价措施, 公司有权将应付本人的薪酬及现金分红(如有)予以扣除, 直至本人履行相关义务。

(五) 发行人其他董事、高级管理人员王成森、沈欣欣、张祖蕾和沈卫群就稳定公司股价事宜的承诺:

公司首次公开发行股票并上市后 3 年内, 如公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后发生除权除息事项, 每股净资产相应进行调整), 且公司控股股东未履行稳定公司股价措施或虽履行稳定股价措施但公司股票价格仍低于每股净资产, 则触发本人增持公司股份的义务, 本人在满足监管机构对于增持公司股份规定条件的前提下将通过证券交易认可的方式增持公司股份, 累计增持资金金额不低于本人上一年度薪酬总额及发行人对本人现金股利分配总额之和的 50%, 增持价格不高于最近一期经审计的每股净资产的金额。该次增持实施完毕后, 如再次出现公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后发生除权除息事项, 每股净资产相应进行调整), 则本人将依据前述承诺继续履行增持义务。

本人将于前述 20 个交易日收盘后启动稳定公司股价的措施并自启动日起 2 个交易日内以书面形式向公司提交本次增持股票的具体增持计划, 包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间, 价格区间、实施期限等信息并公告。自公告次日起, 本人即实施该次增持计划。该次增持实施完毕后, 如再次出现公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后发生除权除息事项, 每股净资产相应进行调整), 则本人将依据前述承诺继续履行增持义务。

如出现下述情形, 本人可终止该次增持计划:

(1) 公司公告启动稳定股价的措施但尚未实施时, 公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产, 则公司可以不再继续实施稳定股价的措施;

(2) 本人实施该次增持计划将导致公司不符合上市条件。

本人如未按照上述承诺实施稳定股价措施, 公司有权将应付本人的薪酬及现金分红(如有)予以扣除, 直至本人履行相关义务。

(六) 独立董事许苏明、陈良和雷星晖就稳定公司股价事宜的承诺:

公司首次公开发行股票并上市后 3 年内, 如公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后发生除权除息事项, 每股净资产相应进行调整), 本人将积极督促公司控股股东、董事(独立董事除外)及高级管理人员依据其承诺及时履行稳定股价措施。如公司控股股东、董事(独立董事除外)及高级管理人员未依据其承诺履行增持计划或虽履行稳定股价措施但公司股票价格仍低于每股净资产, 公司董事会应于确认前述事项之日起 10 个工作日内公告回购股份的预案, 如公司董事会未在上述时间内提出公告回购股份的预案, 则公司有权扣除本人当年的全部独立董事津贴, 已发给本人的津贴由本人退还给公司。

三、股份回购及依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺

(一) 发行人承诺

本招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 在中国证监会对本公司作出行政处罚决定之日起一个月内, 本公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序, 本公司将通过深圳证券交易所发行价并加算银行同期活期存款利息回购首次公开发行的全部新股。回购价格以本公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日本公司股票交易均价的孰高者确定, 公司上市后发生除权除息事项的, 上述发行价格及回购股份数量应做相应调整。

如果本公司未能履行上述承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并自赔偿责任成立之日起三十日内,向因本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受损失的投资者依法赔偿损失。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本公司自愿无条件地遵从该等规定。

(二) 控股股东捷捷投资和实际控制人黄善兵承诺

本招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,控股股东捷捷投资和实际控制人黄善兵将利用控股股东及实际控制人地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后一个月内启动依法回购首次公开发行的全部新股工作,如首次公开发行时有老股发售的,控股股东捷捷投资在前述期限内启动依法购回本公司已转让的原限售股份工作,回购价格以本公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日本公司股票交易均价的孰高者确定,公司上市后发生除权除息事项的,上述发行价格及回购股份数量应做相应调整。在上述回购期间,控股股东持有的发行人股份将不得转让,若转让的,转让所得归发行人所有,直至控股股东按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。控股股东捷捷投资,自赔偿责任成立之日起三十日内,向因本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受损失的投资者依法赔偿损失。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对控股股东因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,控股股东捷捷投资自愿无条件地遵从该等规定。

(三) 发行人董事、监事、高级管理人员承诺

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将在该等违法事实被中国证监会认定后三十日内依法赔偿投资者损失。

如果董事、监事、高级管理人员未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处股东分红或领取薪酬及津贴，同时董事、监事、高级管理人员间接持有的公司股份将不得转让，若转让的，转让所得归公司所有，直至董事、监事、高级管理人员按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对董事、监事、高级管理人员因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，董事、监事、高级管理人员自愿无条件地遵从该等规定。

四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

(一) 为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司拟通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、提高募集资金使用效率、加强国内与国外市场开拓、加强技术创新等措施，从而提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。

1、加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用

公司已制定《募集资金管理和使用办法》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。

2、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益

本次募集资金投资项目主要为功率半导体器件生产线建设项目、半导体防护器件生产线建设项目和工程技术研究中心项目。根据项目可行性研究报告的测算结果，上述项目投产运营后，在 7 年的测算期内，可实现年均新增营业收入 30,106.86 万元，年均新增利润总额为 7,700.47 万元，每年新增营业收入均能够覆盖新增固定资产折旧及其他成本和费用支出，并且每年能够获得较为稳定的收益，年均可实现利润总额为 7,700.47 万元。

3、提高资金使用效率，节省财务成本

公司拟将本次募集资金中的 2.26 亿用于补充公司流动资金。公司将努力提高该部分资金的使用效率，设计更合理的资金使用方案，减少公司营运资金对银行贷款的依赖，节省公司的财务费用支出。

4、加强国内与国外市场开拓，实现公司收入提升

发行人准确定位于功率半导体分立器件设计和制造行业，目前和未来三年，在晶闸管器件和芯片以及半导体防护器件两个细分领域内成为我国行业内的领先企业，建立高端客户群，实现民族品牌国际化，在我国功率半导体分立器件市场上进一步替代进口同类产品，并以此为突破，打开国际市场的销售空间，优化公司盈利结构，提升公司盈利能力。

5、坚持技术创新，推进产品升级

功率半导体分立器件的技术具有无限精细化和拓展性的发展空间，针对公司现有成熟产品，公司仍将进一步精细化工艺技术，在工业生产、居民生活的用电中最大程度地减少电能的损耗，促进工业产业结构升级，节能降耗。

在深化现有产品技术的同时，公司推行技术领先战略，立足于公司目前的功率半导体分立器件技术及产品，以市场需求为准则，不断研发、生产市场需要的产品，积极创造条件涉足新的产品领域，因此，公司计划构建高端技术研发平台，加强自主创新能力建设，建立一条超快恢复功率二极管研发试验线、一条功率 MOSFET、IGBT 研发试验线、一个碳化硅器件研发试验线及一个产品性能检测和试验站，推动公司功率半导体分立器件产品和技术向更加新型化、全面化的方向发展。

6、优化投资回报机制

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司制定了《未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》的议案。该回报规划能够充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。另外，公司已在《<公司章程>（草案）》中逐条落实了《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的相关要求。

（二）相关承诺

本次首发股票完成后，公司即期收益存在被摊薄的风险，为保护中小投资者合法权益，公司及控股股东捷捷投资做出如下承诺：

1、公司承诺

在坚持每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20% 的现金分红政策的基础上，提高现金分红水平，在公司本次发行完成当年及发行后第一个会计年度和第二个会计年度，公司计划每股现金分红不低于发行前一年度水平。若本次发行后公司股票发生转增或者送股等除权事项的，每股现金股利水平相应进行调整。若上述承诺未能得到有效履行，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

2、控股股东捷捷投资承诺

发行人上市后三年内，净利润出现低于 2013 年净利润水平的年度，捷捷投资将不参与当年度实现的可供分配的利润分配，其应分红金额归发行人所有。若上述承诺未能得到有效履行，捷捷投资将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

五、利润分配政策的承诺

（一）本次发行后的利润分配政策

根据本次公开发行股票并上市后将生效的《公司章程（草案）》，公司上市后的有关股利分配政策的主要规定如下：

1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况。公司应该通过及时的信息披露及信息沟通等多种渠道充分听取独立董事以及中小股东等公众投资者的意见。

2、如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。当累计

未分配利润超过公司股本总数 100%时，公司可以采取股票股利的方式予以分配。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

3、公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或红股）的派发事项；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过，其中股东大会决议需要经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是中小股东等公众投资者）和独立董事的意见制定或调整股东回报计划。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

（二）利润分配的具体规划

为了明确首次公开发行股票并上市后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会制定江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划。

公司未来三年计划将为股东提供以下投资回报：①2014-2016年，公司将每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。②在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，并由股东大会审议通过。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。

公司全体股东均作出不可撤销之承诺，同意江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划，在公司上市后的股东大会根据《公司章程》的规定通过利润分配具体方案时，表示同意并投赞成票。

（三）控股股东及实际控制人关于公司上市后利润分配的具体承诺

发行人控股股东及实际控制人均作出了承诺：“未来公司股东大会根据公司章程的规定表决利润分配的具体方案时，本方表示同意并投赞成票。”

六、未能履行承诺的约束措施

发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：

若在实际执行过程中，其违反本次发行时已作出的公开承诺，则采取或接受如下约束措施：1、若违反的承诺存在继续履行必要的，其将继续履行该承诺；2、若有关监管机关要求期限内予以整改或对其进行处罚的，其将依法予以整改或接受处罚；3、若因违反相关承诺导致投资者直接损失的，其将依法进行赔偿；4、根据届时的有关规定可以采取的其他措施。

七、其他相关责任主体的重要承诺

（一）保荐机构承诺

如本保荐机构在江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行相关工作期间未勤勉尽责，导致本保荐机构所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，本保荐机构将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调

解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。本保荐机构保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担责任。

2、发行人律师承诺

本所为江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票事宜制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失，本所将依据《证券法》等法律法规的相关规定赔偿投资者损失。

3、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺

本所为江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票事宜制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失，本所将依据《证券法》等法律法规的相关规定赔偿投资者损失。

4、评估机构承诺

本公司为江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票事宜制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失，本公司将依据《证券法》等法律法规的相关规定赔偿投资者损失。

八、老股转让具体方案

公司首次公开发行股票，既包括公开发行新股，也可能包括符合条件的原股东公开发售股份（即老股转让）。

（一）公开发行新股与公司股东公开发售股份数量及调整机制

公开发行新股的具体数量将依据发行时的定价结果和募集资金需求量合理确定，如发行时证券监管部门对公开发行新股数量存在不同条件及要求，公司将

依据相关条件和要求相应调整公开发行新股数量。

根据询价结果，若预计新股发行募集资金净额（扣除对应的发行承销费用后）超过募投项目所需资金总额或发行时证监会对新股募集资金数额的规定，在符合法律、法规、规范性文件规定的前提下，公司将适当减少公开发行新股数量，同时增加公司首次公开发行时原股东公开发售股份的数量。根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告【2013】42号）等有关规定，将按以下规定公开发售股份，并确保同时符合以下条件：

1、公司首次公开发行股票数量不超过 **2,360** 万股，包括新股发行和股东公开发售股份。公司优先发行新股，本次新股发行数量不超过 **2,360** 万股。

2、公司根据实际的资金需求合理确定新股发行数量，若根据询价结果预计将出现募集资金净额（扣除对应的发行承销费用后）超过公司实际资金需求的，在符合法律、法规、规范性文件规定的前提下，公司将适当减少公开发行新股数量并有公司股东公开发售一定数量的股份，本次公司股东公开发售股份数量不超过 **1,000** 万股，且不得超过自愿设定 **12** 个月以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

3、公司股东公开发售股份时，由有转让意愿的、持股时间在 **36** 个月以上的股东自行协商其可转让数量，协商不成，上述股东按照本次发行前的持股数量的比例确定其公开发售股份数量。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

4、公司本次新股发行与公司股东公开发售股份的实际发行总量不超过本次公开发行股票数量上限，即 **2,360** 万股。本次发行新股数量与公司股东公开发售股份数量之和，不低于本次发行后总股本的 **25%**。

本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则的基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。

（二）发行承销费用的分摊原则

公司拟公开发行股票如实际发生股东公开发售股份的情形，发售股东将按其公开发售股份所得对价金额与公司实际发行新股募集资金总额的比例与公司分摊承销费，其他发行费用由公司承担。届时公司将按照内部治理制度的要求履行

相关程序后与相关股东签署费用分摊协议。

（三）股东公开发售股份事项对公司控制权、治理结构及生产经营等产生的影响

发行人本次发行前股本总额为 7,000 万股，控股股东捷捷投资持有 3,000 万股，占发行人股本总额的 42.87%；实际控制人黄善兵先生直接持有发行人 960 万股股份，并通过捷捷投资和蓉俊投资间接控制发行人 3,240 万股股份，合计控制发行人 60%的股份。按照本次发行后最大股本 9,360 万股计算，捷捷投资持有发行人股份的比例为 32.05%，实际控制人黄善兵先生控制的股份比例为 44.87%。公司控股股东、实际控制人不会因本次发行发生变更，本次发行不会对公司控制权、治理结构和生产经营产生实质影响。

九、发行前滚存利润的安排

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议，若公司本次公开发行股票并上市成功，则首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。

十、本公司特别提醒投资者关注以下风险提示

欲详细了解，请认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”。

（一）成长性风险

发行人为国内功率半导体分立器件的领先企业之一，具备芯片的设计、制造和研发能力，并配备后道封装和检测工序，具备功率半导体分立器件的完整研发制造体系，因此公司产品毛利率较高，报告期内公司各期毛利率均在 50%以上。半导体行业属于充分竞争的行业，国内外具有一定研发实力及生产、市场经验的知名半导体公司一直致力于新产品、新技术的研发、产业化及市场推广，竞争对手的技术也在不断成熟和创新，因此，发行人产品未来将面对较为激烈的市场竞争，公司存在毛利率下降、成长性放缓的风险。

（二）新产品开发风险

由于电力电子技术是多种学科技术的复合产品，技术复杂程度高，新技术从研发至产业化的过程较长，另外，由于国际大型半导体公司对行业新技术实行严格的封锁政策，国内半导体公司很难通过与国外公司技术合作的方式开发新产品，因此，发行人只能依靠自身的技术积累和不断探索创新开发新的功率半导体分立器件，虽然在过往的历史中公司技术开发都比较顺利，但如果技术研发失败，发行人成长性将放缓，为盈利能力带来负面影响。

（三）技术替代风险

功率半导体分立器件产品种类众多，工艺技术发展迅速，相对于国际大型半导体公司的综合技术实力，我国半导体分立器件行业的整体技术水平偏低，研发实力偏弱，如果发行人不能及时开发出新技术、新工艺并实现技术成果顺利转化为先进产品，公司将会面临自身技术被行业内其他优秀企业、特别是国外竞争对手超越和替代的风险，从而影响公司长期的成长性和持续盈利能力。

（四）产品结构单一风险

发行人主营产品为功率半导体分立器件，其中晶闸管系列产品在报告期内占发行人营业收入的比例在 75%以上，发行人存在对晶闸管产品依赖较大的风险。晶闸管仅为功率半导体分立器件众多类别之一，如果发行人未来不能够保持研发优势，无法及时提升现有产品的生产工艺，并逐步向全控型功率半导体分立器件领域延伸，现有单一晶闸管产品将面临市场份额下降和品牌知名度降低的风险，发行人经营业绩将受到较大影响。

（五）固定资产规模增加导致利润下滑的风险

公司本次募集资金拟投资功率半导体器件生产线建设项目、半导体防护器件生产线建设项目、工程技术研究中心项目、补充营运资金项目。募集资金新增固定资产投资 31,317.04 万元，募投项目新增固定资产增加年折旧和摊销费用 3,037.09 万元，虽然项目产生的利润完全可以消化每年新增折旧费用和摊销费用，安全边际较大，但新增折旧和摊销仍将给公司净利润增长带来一定的压力。

（六）市场竞争加剧风险

国际知名大型半导体公司占据了我国半导体市场 70%左右的份额，我国本土

功率半导体分立器件生产企业众多，但主要集中在封装产品代工层面，与国际技术水平有较大差距。公司具备功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售一体化的业务体系，主要竞争对手为国际知名大型半导体公司，随着公司销售规模的扩大，公司与国际大型半导体公司形成日益激烈的市场竞争关系，加剧了公司在市场上的竞争风险。

（七）宏观经济波动风险

功率半导体分立器件制造行业是半导体行业的子行业，半导体行业渗透于国民经济的各个领域，行业整体波动性与宏观经济形势具有一定的关联性。公司产品主要应用于家用电器、开关等民用领域，无功补偿装置、无触点交流开关、固态继电器等工业领域，及 IT 产品、汽车电子、网络通讯的防雷击防静电保护领域，如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，上述行业的整体盈利能力会受到不同程度的影响，半导体行业的景气度也将随之受到影响，下游行业的波动和低迷会导致公司客户对成本的考量更加趋于谨慎，发行人产品的销售价格和销售数量均会受到相应的不利因素影响而下降，毛利率也将随之降低，对公司盈利带来不利影响。

十一、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐人对发行人是否具备持续盈利能力的核查意见

影响发行人持续盈利的风险因素已在本招股说明书“第四节 风险因素”进行了披露。发行人不存在以下对持续盈利能力构成重大不利影响的情形：

（一）发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（二）发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（三）发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

（四）发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的

客户存在重大依赖；

（五）发行人最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

（六）其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

保荐机构经核查后认为，发行人已披露了其面临的风险因素，发行人不存在上述对持续盈利能力构成重大不利影响的情形，发行人具备持续盈利能力。

目录

发行人声明	1
发行概况	2
重大事项提示	3
一、股东关于股份锁定的承诺	3
二、关于公司首发上市后股价低于每股净资产时稳定股价预案的承诺	6
三、股份回购及依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	11
四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺	13
五、利润分配政策的承诺	15
六、未能履行承诺的约束措施	17
七、其他相关责任主体的重要承诺	17
八、老股转让具体方案	18
九、发行前滚存利润的安排	20
十、本公司特别提醒投资者关注以下风险提示	20
十一、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐人对发行人是否具备持续盈利能力的核查意见	22
第一节 释义	28
第二节 概览	33
一、发行人简介	33
二、发行人控股股东、实际控制人简介	34
三、发行人主要财务数据及财务指标	36
四、本次发行情况	37
五、本次募集资金投向	38
第三节 本次发行概况	40
一、本次发行基本情况	40
二、本次发行有关当事人	42
三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系	43
四、本次发行上市的重要日期	43
第四节 风险因素	45

一、成长性风险	45
二、技术风险	45
三、经营风险	46
四、财务风险	47
五、市场竞争加剧风险	48
六、宏观经济波动风险	48
七、管理风险	48
八、大股东控制的风险	49
九、高新技术企业税收政策的风险	49
十、股市风险	49
第五节 发行人基本情况	51
一、发行人基本情况	51
二、发行人设立及改制重组情况	51
三、发行人设立以来的重大资产重组情况	53
四、发行人的股权结构图	53
五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况	54
六、发行人股本情况	60
七、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况	64
八、发行人员工情况	65
九、相关责任主体的重要承诺	65
第六节 业务和技术	66
一、发行人主营业务的情况	66
二、发行人所处行业的情况	80
三、发行人销售及采购业务的具体情况	105
四、与发行人业务相关的主要固定资产及无形资产	110
五、发行人拥有的特许经营权	115
六、发行人核心技术情况	115
七、发行人在境外生产经营及资产情况	119
八、发行人当年和未来三年的发展规划及拟采取的措施	119

第七节 同业竞争与关联交易	124
一、同业竞争	124
二、关联方及关联关系	127
三、关联交易	129
四、关于规范关联交易的制度安排	129
五、报告期内关联交易履行的程序及独立董事意见	132
第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理	133
一、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介	133
二、公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况	139
三、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况	141
四、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从发行人及关联企业领取报酬情况	141
五、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的协议、承诺及其履行情况 ..	142
六、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况	142
七、公司治理	143
八、发行人对投资者权益保护的情况	149
第九节 财务会计信息与管理层分析	153
一、财务报表	153
二、审计意见	159
三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标	159
四、主要会计政策和会计估计	161
五、分部信息	181
六、最近一年收购兼并情况	183
七、非经常性损益情况	183
八、主要财务指标	185
九、财务状况分析	187

十、盈利能力分析.....	211
十一、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐人对发行人是否具备持续盈利能力的核查意见.....	235
十二、现金流量分析.....	236
十三、财务状况、盈利能力及现金流量的未来趋势分析.....	238
十四、期后事项、或有事项及其他重要事项.....	240
十五、股利分配政策.....	240
第十节 募集资金运用.....	246
一、本次发行筹集资金的总量及拟投资项目.....	246
二、募集资金投资项目与现有主营业务体系的关系.....	247
三、募集资金投资项目概况.....	249
四、固定资产变化与产能变动的匹配关系.....	257
五、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响.....	259
第十一节 其他重要事项.....	260
一、对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同情况.....	260
二、发行人对外担保的情况.....	262
三、发行人重大诉讼或仲裁事项.....	262
第十二节 有关声明.....	263
第十三节 附件.....	272
一、备查文件.....	272
二、备查时间、地点.....	272

第一节 释义

在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有以下特定意义：

一、一般名词释义		
捷捷微电、发行人、公司、本公司	指	江苏捷捷微电子股份有限公司
捷捷有限	指	发行人前身，启东市捷捷微电子有限公司
捷捷投资	指	发行人控股股东，江苏捷捷投资有限公司
中创投资	指	发行人主要股东，南通中创投资管理有限公司
正和世通	指	发行人主要股东，天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
蓉俊投资	指	南通蓉俊投资管理有限公司（原南京蓉俊投资管理有限公司）
上海虹菊	指	上海虹菊电子有限公司
中导电子	指	南通中导电子科技有限公司
深圳创新投	指	深圳市创新投资集团有限公司
红土创投	指	南通红土创新资本创业投资有限公司
保荐人、主承销商、保荐机构、西南证券	指	西南证券股份有限公司
发行人律师	指	北京德恒律师事务所
瑞华会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
利安达会计师事务所	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会、董事会、监事会	指	捷捷微电股东大会、董事会、监事会
本次发行	指	捷捷微电首次公开发行 A 股股票的行为
报告期、最近三年及一期		2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
元	指	人民币元
二、专业名词解释		
半导体分立器件	指	由单个半导体晶体管构成的具有独立、完整功能的器件，其本身在功能上不能再细分。例如：二极管、三极管、双极型功率晶体管（GTR）、晶闸管（可控硅）、场效应晶体管（结型场效应晶体管、MOSFET）、IGBT、IGCT、发光二极管、敏感器件等。
功率半导体分立器件	指	又称为电力电子器件，指能够耐受高电压或承受大电流的半导体分立器件，主要用于电能变换和控制。
电力电子技术	指	是指使用功率半导体分立器件对电能进行变换和控制的技术。电力电子技术所变换的“电力”功率可大到数百兆瓦甚至吉瓦，也可以小到数瓦甚至1瓦以下。
芯片	指	如无特殊说明，本文所述芯片专指功率半导体分立器件芯片，系通过在硅晶圆片上进行抛光、氧化、扩散、光刻等一系列的工艺加工后，在一个硅晶圆片上同时制成许多构造相同、功能相同的晶粒，再经过划片分立后便得到单独的晶粒，即为芯片。这个晶片虽已具有了半导体器件的全部功能，但还需要通过封装后才能使用。
封装	指	封装是指将半导体芯片按装在规定的外壳内，起到固定、密封、保护芯片、增强导电性能和导热性能、同时通过内部连线将芯片电极与外部电极相连接的作用。
晶闸管	指	晶体闸流管(thyristor)的简称，又可称作可控硅整流器，能在高电压、大电流条件下工作，且其工作过程可以控制和变换电能，被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。
MOSFET	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,

		金属氧化物半导体场效应晶体管。
IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Transistor, 绝缘栅双极型晶体管。
IGT	指	晶闸管门极触发电流, 即在规定的规定环境温度和晶闸管阳极与阴极之间为一定值电压的条件下, 使晶闸管从阻断状态转变为导通状态所需要的最小门极直流电流。
IGCT	指	Intergrated Gate Commutated Thyristors, 集成门极换流晶闸管。
FRD	指	Fast Recovery Diode, 超快恢复二极管。
单晶硅	指	单晶硅材料, 其硅原子以金刚石结构进行晶格排列, 具有基本完整的晶格结构的单晶体。不同的晶向具有不同的性质, 是一种良好的半导体材料。用于集成电路和半导体分立器件的生产制造。
RoHS	指	RoHS 是由欧盟立法制定的一项强制性标准, 它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准, 使之更加有利于人体健康及环境保护。
UL	指	(美国) 保险商试验所 (Underwriter Laboratories Inc.), 该实验室主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务。
整流	指	将交流电变换为直流电称为 AC/DC 变换, 这种变换的功率流向是由电源传向负载, 称之为整流。
逆变	指	与整流相对应, 将直流电变成交流电的过程。
DC-DC 变换	指	将固定的直流电压变换成可变的直流电压, 也称为直流斩波。
无功功率	指	一种在交流电路中由电源供给负载的电功率, 不对外做功, 而是转变为其他形式的能量, 用于电路内电场与磁场的交换, 并用来在电气设备中建立和维持磁场。凡是

		有电磁线圈的电气设备，要建立磁场，就要消耗无功功率。
无功补偿	指	即无功功率补偿，在电子供电系统中起提高电网的功率因数的作用，降低供电变压器及输送线路的损耗，提高供电效率，改善供电环境。无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的位置。合理的选择补偿装置，可以做到最大限度的减少网络的损耗，使电网质量提高。
无触点开关	指	依靠改变电路阻抗值，阶跃地改变负荷电流，而完成电路通断的一种电器。
测试	指	对半导体器件电性能参数进行检测和分档的过程。
抛光	指	利用机械、化学或电化学的作用，使晶圆表面粗糙度降低，以获得光亮、平整表面的加工方法。
氧化	指	气体成分、压力等固定的高温条件下(高温氧化炉内进行)，在晶片表面生长一定厚度的致密的 SiO_2 薄膜的过程。
光刻	指	通过一系列生产步骤将晶圆表面薄膜的特定部分除去的工艺。经过光刻之后，晶圆表面会留下带有微图形结构的薄膜。
离子注入	指	以高能离子束注入基材内的近表面区，以改变表面性能的过程。离子注入的优点是能精确控制杂质的总剂量、深度分布和面均匀性，而且是低温工艺（可防止原来杂质的再扩散等），同时可实现自对准技术（以减小电容效应）。
钝化	指	在半导体器件 PN 结表面覆盖保护介质膜,防止表面污染的工艺方法。
喷砂	指	利用高速砂流的冲击作用清理和粗化晶圆表面的过程。
锯片	指	晶圆片测试之后,单个芯片必须从晶片中分离出来，利用高速旋转的划片刀(金刚刀)或激光划切技术将晶片分

		离成单个芯片。
IDM	指	垂直整合制造商，即一家企业包含设计、工艺制造、封装等所有环节。
CAD 设计	指	即计算机辅助设计(Computer Aided Design)，利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作，在设计中通过计算机对不同方案进行计算、分析和比较，以决定最优方案。
溅射	指	被加速的正离子轰击阴极（靶）表面时，将自身的能量传给阴极表面的原子，原子离开阴极沉积在基体上。利用溅射实现沉积薄膜的技术称为溅射沉积技术。
多层金属化	指	应用物理或化学的方法在芯片上淀积多层导电金属的过程，通常分为粘附层、过渡层、导电层，能够与衬底材料形成很好的结合力并具有良好的焊接性能。
亚微米光刻	指	即线宽精度达到 0.8um~0.35um 的光刻技术。
VLSI	指	即 Very Large Scale integrated circuits ，超大规模集成电路，采用专门的设计技术和特殊的集成工艺，把构成半导体电路的 MOSFET、二极管、电阻、电容等基本元器件，制作在一块半导体芯片(如硅、砷化镓)或绝缘基片上，能完成特定功能或系统功能的电路集合。
坚强智能电网	指	是以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，具有信息化、自动化、互动化特征，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合。

本招股说明书除特别说明外,所有数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人简介

（一）发行人设立情况

江苏捷捷微电子股份有限公司系由启东市捷捷微电子有限公司整体变更设立的股份公司。2011年8月25日，捷捷微电召开创立大会暨第一次股东大会，全体22名股东作为发起人，以经利安达会计师事务所审计的公司2011年7月31日净资产181,449,719.79元，按1:0.3692的折股比例折合为6,700万股，其余114,449,719.79元计入公司资本公积，整体变更设立为股份有限公司。

股份公司设立业经利安达会计师事务所出具了利安达验字[2011]第1070号《验资报告》验证，2011年8月25日，公司在江苏省南通工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为320681000081558的企业法人营业执照，注册资本为6,700万元。

（二）发行人主营业务概述

发行人是国家高新技术企业和江苏省创新型企业，自1995年成立以来，专业从事功率半导体分立器件的研发、设计、生产和销售。公司主要产品是功率半导体芯片和封装器件，针对不同的下游应用领域，有200多种不同的规格和型号，主要应用于家用电器、漏电断路器等民用领域，无功补偿装置、电力模块等工业领域，及通讯网络、IT产品、汽车电子的防雷击和防静电保护领域。公司各种产品均包含公司多项核心技术，满足我国经济发展节能降耗的需要，提高居民生活舒适性和安全性，并成为汽车电子、电子通讯网络及IT产品等新兴市场相关产品品质保证的要素之一。

功率半导体分立器件作为电能转换和控制的核心部件，可以依照电器设备工作中的各项要求变换电源的电压与频率等，高效地控制电器设备的功能，精确实现电能到电器设备功能的转换，可将各种能源高效率地变换成为高质量的电

能，将电子信息技术和传统产业相融合的有效技术途径，是实现节能环保和提高人民生活质量的重要技术手段，在执行当前国家节能减排、发展新能源、实现低碳经济的基本国策中起着重要的作用，广泛应用于国民经济各个工业部门和社会生活的各个方面，其发展对国民经济和国家安全领域具有重要影响。

受益于电子技术的发展和电子产品的更新换代，功率半导体防护器件正发展成为一个品类繁多的新兴功率半导体分立器件领域。当前，电子产品的功能和集成度越来越强，工作电压越来越低，其抗过电流/过电压的能力需要满足新的保护要求；消费类电子产品一般以电池组件作为电源，在电池组件和电池充电器中都需要配置防护器件；随着汽车工业的发展，汽车电子系统日趋复杂，电子设备的工作条件更为苛刻，一般需要同时安装过电流和过电压防护器件；网络通讯电子产品都需要防止雷击及电源线与电话线的交扰，以保证正常通信和用户人身安全，因此，电子产品对可靠性和安全性的要求日益提高，功率半导体防护器件为保护电子产品中昂贵、复杂的系统发挥了重要的作用。

发行人 2010 年获国家发改委和工信部的电子信息产业振兴和技术改造项目中央预算内资金投资支持，2011 年被评选为江苏省民营科技企业，2012 年被中国电器工业协会评选为中国电器工业最具影响力品牌。发行人“新型门极灵敏触发单向可控硅芯片”、“新型半导体高压器件芯片”、“JST16A-800 型内绝缘型塑封半导体器件”、“低结电容过压保护晶闸管器件芯片”、“具有高换向能力和高结温的双向晶闸管”、“Super247 外形的晶闸管器件”、“内引线采用 CLIP 结构的晶闸管器件”、“门极灵敏触发单向晶闸管”、“边门极结构的高压大电流单向晶闸管器件芯片”、“新型台面工艺功率晶体管芯片”、“TG-C 型可控硅模块”、“台面工艺结构可控硅芯片”、“新型门极灵敏触发单向晶闸管芯片”、“门极灵敏触发单向可控硅器件”、“新型双台面结构晶闸管芯片”、“具有 150℃ 高结温性能双向晶闸管芯片”、“TO-220A、TO-P3 型内绝缘塑封晶闸管器件”先后被江苏省科技厅认定为高新技术产品。发行人产品符合 UL 电气绝缘性要求、ROHS 环保要求、REACH 化学品注册、评估、许可和限制要求、无卤化要求等。

二、发行人控股股东、实际控制人简介

（一）发行人控股股东简介

捷捷投资持有发行人3,000万股股份，占发行人股本总额的42.87%，是发行人的控股股东。捷捷投资的基本情况如下：

公司名称：江苏捷捷投资有限公司

成立时间：2010年10月25日

注册资本：1,000万元

实收资本：1,000万元

法定代表人：黄善兵

注册地址：江苏省启东市汇龙镇江海北路1188号

公司类型：有限公司

经营范围：投资项目管理，企业项目策划，财务管理，机械设备租赁

捷捷投资各出资人具体出资情况如下：

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例
1	黄善兵	700.00	70%
2	黄健	300.00	30%
合计		1,000.00	100%

根据瑞华会计师事务所出具的瑞华审字[2014]48370004号《审计报告》，捷捷投资最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2014年6月30日/2014年1-6月	2013年12月31日/2013年度
总资产	7,868.34	7,834.04
净资产	7,324.48	5,800.18
净利润	1,524.30	1,255.18

（二）发行人实际控制人简介

黄善兵先生直接持有发行人960万股股份，并通过捷捷投资和蓉俊投资间接控制发行人3,240万股股份，合计控制发行人60%的股份，为发行人实际控制人，现任公司董事长和总经理。

黄善兵先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1956年生，高中，高级经济师，身份证号：32062619561016XXXX。黄善兵先生的其他情况详见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心人员简介”。

三、发行人主要财务数据及财务指标

发行人报告期内的财务报告均经瑞华会计师事务所《审计报告》（瑞华审字[2014]48370003号）审计，以下财务数据均摘自业经审计的财务报告或据此计算得来：

（一）资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014/6/30	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
资产总额	36,732.63	36,354.47	32,392.79	30,418.97
负债总额	3,554.34	3,358.87	3,080.90	7,278.99
归属于母公司所有者的权益	33,178.29	32,995.60	29,311.88	23,139.98
股东权益合计	33,178.29	32,995.60	29,311.88	23,139.98

（二）利润表主要数据

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	10,722.27	19,453.78	17,249.74	17,031.74
营业利润	4,092.87	7,366.63	6,670.94	7,143.30
利润总额	4,338.20	7,725.95	7,206.37	7,139.56
净利润	3,682.69	6,623.72	6,171.90	6,030.83
归属于母公司股东的净利润	3,682.69	6,623.72	6,171.90	6,030.83
非经常性损益	208.53	375.65	456.40	-3.66
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3,474.16	6,248.07	5,715.51	6,034.49

（三）现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	3,758.72	6,367.96	8,181.64	5,242.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,043.39	-1,803.91	-4,025.63	-7,127.70
筹资活动产生的现金流量净额	-3,256.34	-2,950.32	-2,998.20	4,772.33
现金及现金等价物净增加额	-541.01	1,613.73	1,157.81	2,886.79

(四) 主要财务指标

财务指标	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
流动比率(倍)	8.15	8.88	9.01	2.84
速动比率(倍)	6.59	7.31	7.10	2.27
资产负债率	9.68%	9.24%	9.51%	23.93%
应收账款周转率(次/年)	1.92	4.33	4.79	5.50
存货周转率(次/年)	1.16	2.32	2.12	2.75
息税折旧摊销前利润(万元)	5,600.81	9,883.70	9,175.48	8,626.17
利息保障倍数(倍)	-	-	3,814.64	191.98
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.54	0.91	1.17	0.75
每股净现金流量(元)	-0.08	0.23	0.17	0.41
无形资产(扣除土地使用权)占净资产比率(%)	-	-	-	-
归属于发行人股东的净利润	3,682.69	6,623.72	6,171.90	6,030.83
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润	3,474.16	6,248.07	5,715.51	6,034.49
归属于发行人股东的每股净资产	4.74	4.71	4.19	3.31

四、本次发行情况

(一) 股票种类：人民币普通股（A股）

(二) 股票面值：人民币 1.00 元/股

(三) 发行股数：本次发行股票数量不超过 2,360 万股，其中公开发行新股的数量不超过 2,360 万股，公司相关股东公开发售股份数量不超过 1,000 万股，公开发行新股的数量与股东公开发售的股份数量合计不超过本次公开发行股票的上限，即 2,360 万股，公司优先发行新股；最终发行数量以中国证监会核准的额度为准。本次发行新股数量与公司股东公开发售股份数量之和，不低于本次发行后总股本的 25%。

(四) 每股发行价格：【 】元/股

(五) 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式

(六) 发行对象：在深圳证券交易所开户的自然人、法人等符合《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》的申购对象（国家法律、法规禁止购买者除外）

五、本次募集资金投向

根据发行人2014年第一次临时股东大会决议，本次拟申请公开发行人民币普通股（A股）2,360万股，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，按轻重缓急顺序投资以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	项目履行的审批、核准或备案程序	项目环评
功率半导体器件生产线建设项目	18,696.00	备案号：启东市备2014156	启环表【2014】0519号
半导体防护器件生产线建设项目	15,774.30	备案号：启东市备2014155	启环表【2014】0518号
工程技术研究中心项目	4,500.00	备案号：启东市备2014154	启环表【2014】0520号
补充营运资金项目	22,600.00	—	—

合计	61,570.30	—	—
----	-----------	---	---

若本次募集资金不能满足上述项目需求，公司将通过申请银行贷款等途径自筹解决资金缺口。在募集资金到位前，股东大会授权公司董事会根据实际情况决定是否使用自筹资金进行前期投入，前期投入资金在募集资金到位后予以置换。

公司将严格按照相关规定管理和使用募集资金，将募集资金纳入募集资金专户管理。在使用募集资金时，公司将严格按照募集资金管理制度的要求使用。

第三节 本次发行概况

一、本次发行基本情况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	本次发行股票数量不超过 2,360 万股，其中公开发行新股的数量不超过 2,360 万股，公司相关股东公开发售股份数量不超过 1,000 万股，公开发行新股的数量与股东公开发售的股份数量合计不超过本次公开发行股票的上限，即 2,360 万股，公司优先发行新股；最终发行数量以中国证监会核准的额度为准。本次发行新股数量与公司股东公开发售股份数量之和，不低于本次发行后总股本的 25%。
每股发行价格	【 】元/股
市盈率	【 】倍（每股收益按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
每股净资产	发行前4.74元/股（按照2014年6月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）
	发行后【 】元/股（按照 2014 年 6 月 30 日经审计的净资产除以本次发行后总股本计算）
市净率	【 】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且

	符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》、《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》规定的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	【 】万元
预计募集资金净额	【 】万元
发行费用概算	【 】万元
其中：承销费用及保荐费用	【 】万元
审计费用	【 】万元
律师费用	【 】万元
发行手续费用	【 】万元

1、公司首次公开发行股票数量不超过 2,360 万股，包括新股发行和股东公开发售股份。公司优先发行新股，本次新股发行数量不超过 2,360 万股。

2、公司根据实际的资金需求合理确定新股发行数量，若根据询价结果预计将出现募集资金净额（扣除对应的发行承销费用后）超过公司实际资金需求的，在符合法律、法规、规范性文件规定的前提下，公司将适当减少公开发行新股数量并有公司股东公开发售一定数量的股份，本次公司股东公开发售股份数量不超过 1,000 万股，且不得超过自愿设定 12 个月以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

3、公司股东公开发售股份时，由有转让意愿的、持股时间在 36 个月以上的股东自行协商其可转让数量，协商不成，上述股东按照本次发行前的持股数量的比例确定其公开发售股份数量。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

4、公司本次新股发行与公司股东公开发售股份的实际发行总量不超过本次公开发行股票数量上限，即 2,360 万股。本次发行新股数量与公司股东公开发售股份数量之和，不低于本次发行后总股本的 25%。

本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则的基础

上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。

公司拟公开发行股票如实际发生股东公开发售股份的情形，发售股东将按其公开发售股份所得对价金额与公司实际发行新股募集资金总额的比例与公司分摊承销费，其他发行费用由公司承担。届时公司将按照内部治理制度的要求履行相关程序后与相关股东签署费用分摊协议。

二、本次发行有关当事人

（一）保荐人（主承销商） 西南证券股份有限公司

法定代表人：余维佳
住所：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
联系电话：0755-83288685
传真：0755-83288321
保荐代表人：武胜、杨锦雄
项目协办人：付新雄
项目组成员：王晓红、李晓东

（二）律师事务所 北京德恒律师事务所

负责人：王丽
住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
联系电话：0755-88286488
传真：0755-88286499
经办律师：苏启云、刘爽、官昌罗

（三）会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：顾仁荣
住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
联系电话：010-85866870
传真：010-85866877
经办注册会计师：林万强、杨运辉

（四）资产评估机构 沃克森（北京）国际资产评估有限公司

法定代表人：郑文洋

住所：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座
二层

联系电话：010—88018766

传真：010—88019300

经办注册资产评估师：黄运荣、邓士丹

（五）股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：0755—25938000

传真：0755—25988122

（六）上市证券交易所 深圳证券交易所

住所：深圳市深南东路 5045 号

联系电话：0755—82083333

传真：0755—82083164

（六）主承销商收款银行：

户名：西南证券股份有限公司

账号：3100021819200055529

开户行：中国工商银行重庆解放碑支行

联系电话：023-63705123

传真：023-63786515

三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系

发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、本次发行上市的重要日期

刊登发行公告日期	【 】年【 】月【 】日
开始询价推介日期	【 】年【 】月【 】日

刊登定价公告日期	【 】年【 】月【 】日
申购日期和缴款日期	【 】年【 】月【 】日
股票上市日期	【 】年【 】月【 】日

第四节 风险因素

投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真考虑以下各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素依次发生。

一、成长性风险

发行人为国内功率半导体分立器件的领先企业之一，具备芯片的设计、制造和研发能力，并配备后道封装和检测工序，具备功率半导体分立器件的完整研发制造体系，因此公司产品毛利率较高，报告期内公司各期毛利率均在 50%以上。半导体行业属于充分竞争的行业，国内外具备一定研发实力及生产、市场经验的知名半导体公司一直致力于新产品、新技术的研发、产业化及市场推广，竞争对手的技术也在不断成熟和创新，因此，发行人产品未来将面对较为激烈的市场竞争，公司存在毛利率下降、成长性放缓的风险。

二、技术风险

（一）新产品开发风险

由于电力电子技术是多种学科技术的复合产品，技术复杂程度高，新技术从研发至产业化的过程较长，另外，由于国际大型半导体公司对行业新技术实行严格的封锁政策，国内半导体公司很难通过与国外公司技术合作的方式开发新产品，因此，发行人只能依靠自身的技术积累和不断探索创新开发新的功率半导体分立器件，虽然在过往的历史中公司技术开发都比较顺利，但如果技术研发失败，发行人成长性将放缓，为盈利能力带来负面影响。

（二）技术替代风险

功率半导体分立器件产品种类繁多，工艺技术发展迅速，相对于国际大型半导体公司的综合技术实力，我国半导体分立器件行业的整体技术水平偏低，研发实力偏弱，如果发行人不能及时开发出新技术、新工艺并实现技术成果顺利转化为先进产品，公司将会面临自身技术被行业内其他优秀企业、特别是国外竞争对

手超越和替代的风险，从而影响公司长期的成长性和持续盈利能力。

（三）产品研发周期风险

由于发行人的持续盈利能力对公司技术水平和技术成果转化率的依赖性较强，如果发行人研发工作的管理和导向出现失误，工艺技术研发和新产品开发的效率将相应下降，新技术开发及推广应用的周期随之延长，将导致发行人产品技术逐步落后，无法保持行业领先水平，失去市场先机，公司盈利能力将会减弱。

（四）核心技术人员流失及技术泄密风险

功率半导体分立器件行业是技术密集型行业，公司的产品性能、创新能力、新产品开发均依赖于稳定的技术团队以及自主创新能力，如果公司核心技术人员流失或核心技术泄密的情况发生，就很有可能会消弱公司的市场竞争能力，影响公司在行业内的领先地位。

三、经营风险

（一）产品结构单一风险

发行人主营产品为功率半导体分立器件，其中晶闸管系列产品在报告期内占发行人营业收入的比例在 75%以上，发行人存在对晶闸管产品依赖较大的风险。晶闸管仅为功率半导体分立器件众多类别之一，如果发行人未来不能够保持研发优势，无法及时提升现有产品的生产工艺，并逐步向全控型功率半导体分立器件领域延伸，现有单一晶闸管产品将面临市场份额下降和品牌知名度降低的风险，发行人经营业绩将受到较大影响。

（二）行业利润水平变动风险

各行业的发展均存在一定的周期性，我国本土功率半导体分立器件行业在少数具有芯片设计制造技术的企业的推动下，利润水平近年来表现出较高的成长性，但随着行业内企业技术的不断成熟，行业整体成长性将逐渐放缓，利润水平长期将呈现下降趋势，因此，从较长时期来看，公司未来盈利将趋近于成熟行业的平均利润水平。

（三）产品生命周期风险

发行人主营高端晶闸管产品，不断与下游行业的知名企业和国外大型公司建立稳定的销售关系，晶闸管系列产品正处于生命周期的上升阶段。但是，由于国际大型半导体公司综合技术实力、研发实力均优于我国本土企业，在功率半导体分立器件行业内的技术发展远远早于我国功率半导体分立器件技术的发展，如果未来国际大型半导体公司研发出具有功率、频率、开关速度等全部参数优势的器件，发行人现有产品的市场需求将会萎缩，成长性和持续盈利能力将会下降。

四、财务风险

（一）固定资产规模增加导致利润下滑的风险

公司本次募集资金拟投资功率半导体器件生产线建设项目、半导体防护器件生产线建设项目、工程技术研究中心项目、补充营运资金项目。募集资金新增固定资产投资 31,317.04 万元，募投项目新增固定资产增加年折旧与摊销费用 3,037.09 万元，虽然项目产生的利润完全可以消化每年新增折旧费用和摊销费用，安全边际较大，但新增折旧和摊销仍将给公司净利润增长带来一定的压力。

（二）资金不足导致产能无法满足市场需求的风险

发行人主营功率半导体芯片及器件的研发、设计、生产和销售，行业及公司主营业务的特点决定了公司属于技术密集型和资本密集型企业。技术创新能力、研发成果转化能力和先进制造力决定了公司的盈利能力，上述特征体现了公司资金需求大、固定资产比重高、设备更新速度快和建设周期长等特点。

尽管公司为保持未来发展中核心竞争力，提前部署生产能力建设，努力拓宽融资渠道，但是根据目前的情况，未来两三年之后产能又将成为公司发展中的主要矛盾，如公司不能及时筹集发展所需的资金，提前做好建设准备，生产能力将成为公司发展的主要瓶颈，公司产能将无法满足市场需求，导致失去进一步扩大市场份额机遇的风险。

（三）净资产收益率下降的风险

报告期内，发行人加权平均净资产收益率分别为 35.12%、21.79%、19.44% 和 10.32%。若公司本次股票成功发行，净资产将大幅增加，由于募集资金投资

项目存在一定的建设期，不能在短期内产生经济效益，因此预计公司发行后的净资产收益率将会有一定幅度的下降。

五、市场竞争加剧风险

国际知名大型半导体公司占据了我国半导体市场 70%左右的份额，我国本土功率半导体分立器件生产企业众多，但主要集中在封装产品代工层面，与国际技术水平有较大差距。公司具备功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售一体化的业务体系，主要竞争对手为国际知名大型半导体公司，随着公司销售规模的扩大，公司与国际大型半导体公司形成日益激烈的市场竞争关系，加剧了公司在市场上的竞争风险。

六、宏观经济波动风险

功率半导体分立器件制造行业是半导体行业的子行业，半导体行业渗透于国民经济的各个领域，行业整体波动性与宏观经济形势具有一定的关联性。公司产品主要应用于家用电器、开关等民用领域，无功补偿装置、无触点交流开关、固态继电器等工业领域，及 IT 产品、汽车电子、网络通讯的防雷击防静电保护领域，如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，上述行业的整体盈利能力会受到不同程度的影响，半导体行业的景气度也将随之受到影响，下游行业的波动和低迷会导致公司客户对成本的考量更加趋于谨慎，发行人产品的销售价格和销售数量均会受到相应的不利因素影响而下降，毛利率也将随之降低，对公司盈利带来不利影响。

七、管理风险

（一）产能迅速扩张带来的系统管理风险

本次募集资金投资项目拟扩大公司主营业务功率半导体芯片和封装的生产能力，在项目建成完全达产后，公司产能将有一定幅度的增长，给公司现行的研发、采购、生产、销售、售后服务等各个环节的组织架构、管理水平和人员素质等方面带来全方位的考验，系统风险增加。如果研发系统不能提供持续有效的技术支撑，采购、生产系统不能有效降低成本、实现集约化管理，销售系统不能及

时增强销售能力，将可能带来产能扩大导致的管理风险。

（二）募集资金管理能力的风险

公司的董事会和临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》和《信息披露管理办法》，规范公司募集资金使用情况，加强信息披露的及时性、准确性和透明性，为募集资金的有效运用提供了制度保证，但在募集资金到位后，公司资产规模将大幅上升，资金管理的工作难度及复杂性也随之大幅提高，仍有可能存在募集资金管理能力的风险。

八、大股东控制的风险

公司实际控制人黄善兵在本次发行前合计控制公司 60%的股份，本次发行后预计仍将控制公司 44.87%的股份，持股比例仍然较高。公司实际控制人如果利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，有可能损害本公司及中小股东的利益。

九、高新技术企业税收政策的风险

公司于 2011 年 8 月 2 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准取得国家高新技术企业证书。有效期 3 年，3 年之内公司可以根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，享受 15%的优惠税率。最近三年及一期，公司所得税税收优惠为 785.82 万元、700.02 万元、732.23 万元和 435.72 万元，占当期净利润比例为 13.03%、11.34%、11.05%和 11.83%。

如果由于各种原因发行人未来未被认定为高新技术企业，企业所得税税率将提升至 25%，并将对公司的税后利润产生一定影响。此外，如果未来国家对上述所得税的税收优惠政策作出调整，也将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

十、股市风险

公司拟在深圳证券交易所创业板上市，由于创业板是新兴市场，投资者还不成熟，并且创业板整体具有经营风险高、业绩不稳定的特征，因此投资者将会面

临较大的市场不确定性，在投资本公司的股票时可能会面临较高的投资风险。公司将按照相关法律法规的要求，加强信息披露，保护公众投资者的利益。

第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称:	江苏捷捷微电子股份有限公司
英文名称:	Jiangsu Jiejie Microelectronics Co., Ltd
注册资本:	7,000 万元
法定代表人:	黄善兵
有限公司成立日期:	1995 年 3 月 29 日
股份公司变更设立日期:	2011 年 8 月 25 日
注册地址:	江苏省启东科技园兴龙路 8 号
邮政编码:	226200
电话号码:	0513-83228813
传真号码:	0513-83220081
互联网网址:	http://www.jjwdz.com/
电子信箱:	jj@jjwdz.com
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人和电话号码:	证券投资部 董事会秘书: 沈欣欣 0513-83228813

二、发行人设立及改制重组情况

(一) 股份公司的设立情况

江苏捷捷微电子股份有限公司系由启东市捷捷微电子有限公司整体变更、发起设立的股份公司。2011 年 8 月 25 日,捷捷微电召开创立大会暨第一次股东大会,全体 22 名股东作为发起人,以经利安达会计师事务所审计的公司 2011 年 7 月 31 日净资产 181,449,719.79 元,按 1:0.3692 的折股比例折合为 6,700 万股,其余 114,449,719.79 元计入公司资本公积,整体变更设立为股份有限公司。

利安达会计师事务所为公司设立出具了利安达验字[2011]第 1070 号《验资报告》,确认各发起人投入捷捷微电的出资已经到位。2011 年 8 月 25 日,公司在江苏省南通工商行政管理局完成工商变更登记手续,并领取了注册号为

320681000081558 的企业法人营业执照，注册资本为 6,700 万元。

公司设立时的发起人为捷捷投资、黄善兵、中创投资、张祖蕾、王成森等 22 名，发起人在公司设立时的持股情况如下表：

序号	股东	股份（万股）	出资比例
1	捷捷投资	3,000.00	44.78%
2	黄善兵	960.00	14.33%
3	中创投资	680.00	10.15%
4	王成森	480.00	7.17%
5	张祖蕾	400.00	5.97%
6	正和世通	400.00	5.97%
7	沈欣欣	300.00	4.48%
8	蓉俊投资	240.00	3.58%
9	朱瑛	45.00	0.67%
10	薛治祥	45.00	0.67%
11	王琳	45.00	0.67%
12	张玉平	15.00	0.22%
13	黎重林	15.00	0.22%
14	颜呈祥	15.00	0.22%
15	徐洋	12.00	0.18%
16	陈德洲	10.00	0.15%
17	吴家健	8.00	0.12%
18	周榕榕	6.00	0.09%
19	钱清友	6.00	0.09%
20	沈怡东	6.00	0.09%
21	沈广宇	6.00	0.09%
22	严巧成	6.00	0.09%
合计		6,700	100%

（二）有限责任公司的设立情况

发行人系由启东市捷捷微电子有限公司整体变更、发起设立的股份公司。启东市捷捷电子有限责任公司(后更名为启东市捷捷微电子有限公司)成立于1995年3月29日,由黄善兵、张祖蕾以货币及实物出资设立,注册资本50万元,其中黄善兵货币出资6.5万元、实物出资23.5万元,张祖蕾实物出资20万元。

单位:元

股东姓名	出资金额	出资比例
黄善兵	300,000.00	60.00%
张祖蕾	200,000.00	40.00%
合计	500,000.00	100.00%

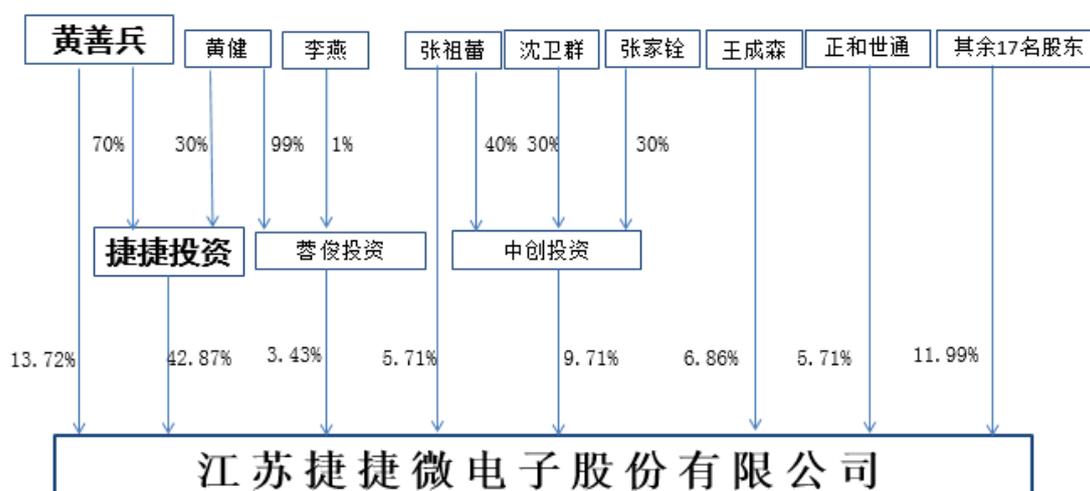
上述出资业经启东县审计事务所通审所验字第095号企业注册资金验资证明书验证。

三、发行人设立以来的重大资产重组情况

发行人是2011年8月25日由捷捷有限整体变更设立的股份公司,设立以来未发生重大资产重组。最近一年及一期,发行人无收购兼并其他企业资产(或股权)的情形。

四、发行人的股权结构图

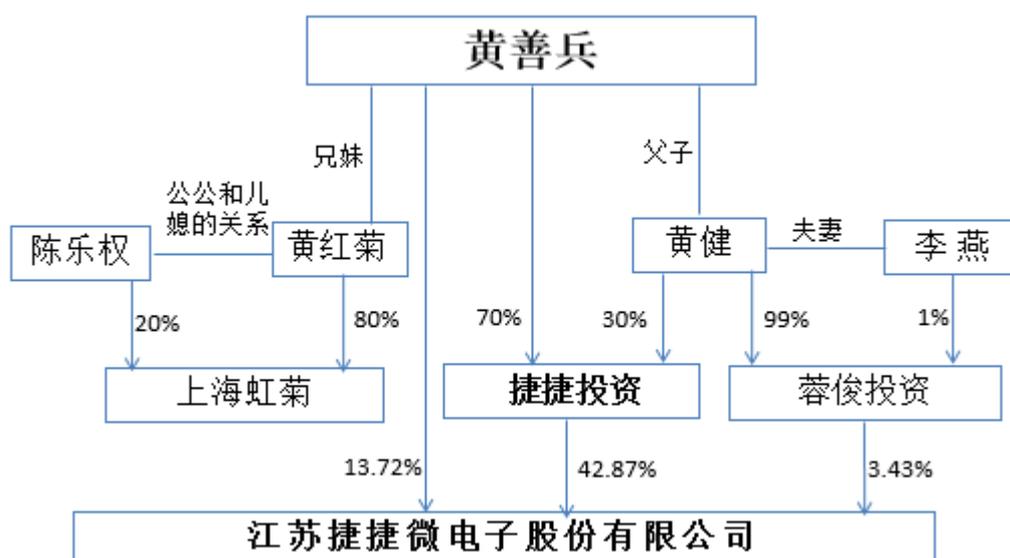
(一) 发行人股权结构图



报告期内，发行人无控股子公司、分公司及参股公司。

（二）发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东捷捷投资、实际控制人黄善兵控制的其他企业如下：



注：黄健为黄善兵之子，李燕为黄善兵之儿媳，黄红菊为黄善兵之妹，陈乐权为黄红菊配偶之父。

五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况

1、持有发行人 5%以上股份的股东情况

持有发行人 5%以上股份的股东为捷捷投资、黄善兵、中创投资、王成森、张祖蕾和正和世通。

（1）江苏捷捷投资有限公司

捷捷投资持有发行人 3,000 万股股份，占发行人股本总额的 42.87%，是发行人的控股股东。捷捷投资基本情况、最近一年及一期末的总资产、净资产和最

近一年及一期的净利润参见本招股说明书“第二节 概览”之“二、发行人控股股东、实际控制人简介”。捷捷投资为投资型公司，与发行人主营业务无相关关系。

(2) 黄善兵

黄善兵先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：32062619561016XXXX。黄善兵先生直接持有发行人 960 万股股份，并通过捷捷投资和蓉俊投资间接控制发行人 3,240 万股股份，合计控制发行人 60% 的股权，为发行人实际控制人。黄善兵先生的其他情况详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员与公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心人员简介”。

(3) 南通中创投资管理有限公司

中创投资持有发行人 680 万股股份，占发行人总股本的 9.71%。中创投资基本情况如下：

成立时间：2010 年 11 月 25 日

法定代表人：沈卫群

注册资本：200 万元

实收资本：200 万元

注册地址：启东市汇龙镇香格花园长江中路 60 号

公司类型：有限公司

经营范围：投资项目管理、企业项目策划、信息管理咨询、厂房机器设备租赁服务

中创投资各出资人具体出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	张祖蕾	80.00	40%
2	沈卫群	60.00	30%
3	张家铨	60.00	30%

合计	200.00	100%
----	--------	------

中创投资为投资型公司，与发行人主营业务无相关关系。

(4) 王成森

王成森先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：37072219611114XXXX。王成森先生持有发行人 480 万股，占发行人总股本的 6.86%。王成森先生的其他情况详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”之“一、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”。

(5) 张祖蕾

张祖蕾先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：32062619610607XXXX，直接持有发行人 400 万股，并通过中创投资间接持有发行人 680 万股，合计持有发行人 15.42% 的股权。张祖蕾先生的其他情况详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员与公司治理”之“一、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”。

(6) 天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）

正和世通持有发行人 400 万股，占发行人股本总额的 5.71%。正和世通基本情况如下：

成立时间：2010 年 12 月 8 日

认缴出资额：41,000 万元

实缴出资额：41,000 万元

主要经营场所：天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 203-022

执行事务合伙人：江苏正和方达投资有限公司（委派代表：蒋忠永）

合伙企业类型：有限合伙企业

经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（法律、行政法规和国务院决定禁止经营的项目不得经营；一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营）

截至本招股说明书签署日，正和世通合伙人构成如下：

单位：万元

合伙人姓名/名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
蒋忠永	4,000.00	4,000.00	9.76%
江苏正和方达投资有限公司	240.00	240.00	0.59%
朱雷	2,000.00	2,000.00	4.88%
江苏汇鸿创业投资有限公司	8,000.00	8,000.00	19.51%
上海瑞沅股权投资合伙企业（有限合伙）	3,200.00	3,200.00	7.80%
江苏高投创新科技创业投资合伙企业(有限合伙)	7,748.00	7,748.00	18.90%
朱晖	15,812.00	15,812.00	38.57%
合计	41,000.00	41,000.00	100.00%

正和世通主要从事股权投资，主营业务与发行人主营业务无相关关系。正和世通实际控制人为朱雷。

2、实际控制人简介

黄善兵先生直接持有发行人 960 万股股份，并通过捷捷投资和蓉俊投资间接控制发行人 3,240 万股股份，合计控制发行人 60%的股权，为发行人实际控制人。黄善兵先生的其他情况详见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员与其他核心人员与公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心人员简介”。

（二）发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业情况

1、发行人控股股东控制的其他企业

截至本招股说明书签署日，公司控股股东捷捷投资除投资本公司外，未投资其他企业。

2、发行人实际控制人控制的其他企业情况

截至本招股说明书签署日，发行人实际控制人黄善兵先生控制的其他企业情况如下：

(1) 江苏捷捷投资有限公司

捷捷投资持有发行人 3,000 万股股份，占发行人股本总额的 42.87%，是发行人控股股东。捷捷投资的基本情况请参见本招股说明书“第二节 概览”之“二、发行人控股股东、实际控制人简介”。

(2) 南通蓉俊投资管理有限公司

公司名称：南通蓉俊投资管理有限公司

成立时间：2010 年 12 月 8 日

法定代表人：李燕

注册资本：100 万元

实收资本：100 万元

注册地址：启东汇龙镇江海北路 1182 号门面

公司类型：有限公司

经营范围：投资管理咨询；经济信息咨询

蓉俊投资为投资型公司，与发行人主营业务不存在相关关系。蓉俊投资目前持有发行人 240 万股股份，占发行人股本总额的 3.43%。蓉俊投资最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2014年6月30日/2014年1-6月	2013年12月31日/2013年度
总资产	509.21	507.17
净资产	308.76	90.71
净利润	217.91	-2.40

注：以上数据未经审计

(3) 上海虹菊电子有限公司

公司名称：上海虹菊电子有限公司

成立时间：2001年7月25日

法定代表人：黄红菊

注册资本：200万元

实收资本：200万元

注册地址：上海宝山区锦乐路947号1幢1206室

公司类型：有限责任公司

经营范围：金属材料、五金交电、橡塑制品、装潢材料、日用百货批兼零；计算机软硬件及相关产品的销售、维修、通讯设备的销售及维修。

上海虹菊自2011年起未从事经营业务，目前处于停业状态。报告期内，上海虹菊与发行人主营业务不存在相关关系。上海虹菊最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日/2014年1-6月	2013年12月31日/2013年度
总资产	3,898.50	3,905.65
净资产	3,885.92	3,892.58
净利润	-6.66	-10.70

注：以上数据未经审计

3、报告期内，发行人实际控制人曾控制的其他企业情况

报告期内，发行人实际控制人黄善兵先生控制的南通中导电子科技有限公司和南通明昊电子科技有限公司已经于2011年注销，启东金环工贸有限责任公司已经于2013年转让。上述公司基本情况如下：

公司	成立时间	注销/转让	注册资本（注销/	实收资本（注销/转	注册地	报告期主营业务	目前

名称		时间	转让前) (万元)	让前) (万元)		(注销/转让前)	状态
中导电子	2010年5月18日	2011年4月13日	200	200	启东科技创业园兴龙路1号	未开展经营	注销 完毕
明昊电子	2005年4月8日	2011年8月4日	3,515.02	3,515.02	江苏省启东经济开发区城北工业园台角一路8号	未开展经营	注销 完毕
金环工贸	1996年7月23日	2013年8月8日	152	152	启东市城北工业园台角一路8号	未开展经营	转让 完毕

(三) 发行人控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人股份的质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日, 发行人控股股东捷捷投资持有公司 3,000 万股股份。占发行人股本总额的 42.87%; 实际控制人黄善兵先生直接持有发行人 960 万股股份, 并通过捷捷投资和蓉俊投资间接控制发行人 3,240 万股股份, 合计控制发行人 60% 的股权。以上股份不存在质押或其他有争议的情况。

六、 发行人股本情况

(一) 本次发行前后股本情况

发行人本次发行前总股本 7,000 万股, 按照本次公开发行新股上限 2,360 万股计算, 本次发行后, 本次发行的新股占发行后总股本的 25.21%。本次发行前后发行人股本结构如下:

序号	股东姓名/名称	发行前股本结构		发行后股本结构	
		股数 (万股)	比例	股数 (万股)	比例
1	捷捷投资	3,000.00	42.87%	3,000.00	32.05%
2	黄善兵	960.00	13.72%	960.00	10.26%
3	中创投资	680.00	9.71%	680.00	7.26%
4	王成森	480.00	6.86%	480.00	5.13%
5	张祖蕾	400.00	5.71%	400.00	4.27%
6	正和世通	400.00	5.71%	400.00	4.27%
7	沈欣欣	300.00	4.29%	300.00	3.21%

8	蓉俊投资	240.00	3.43%	240.00	2.56%
9	深圳创新投	150.00	2.14%	150.00	1.60%
10	红土创投	150.00	2.14%	150.00	1.60%
11	朱瑛	45.00	0.64%	45.00	0.48%
12	薛治祥	45.00	0.64%	45.00	0.48%
13	王琳	45.00	0.64%	45.00	0.48%
14	张玉平	15.00	0.21%	15.00	0.16%
15	黎重林	15.00	0.21%	15.00	0.16%
16	颜呈祥	15.00	0.21%	15.00	0.16%
17	徐洋	12.00	0.17%	12.00	0.13%
18	陈德洲	10.00	0.14%	10.00	0.11%
19	吴家健	8.00	0.11%	8.00	0.09%
20	周榕榕	6.00	0.09%	6.00	0.06%
21	钱清友	6.00	0.09%	6.00	0.06%
22	沈怡东	6.00	0.09%	6.00	0.06%
23	沈广宇	6.00	0.09%	6.00	0.06%
24	严巧成	6.00	0.09%	6.00	0.06%
本次发行的股份		-	-	2,360.00	25.21%
合计		7,000.00	100.00%	9,360.00	100.00%

发行人上述股份中无国有股份，无外资股份。

（二）发行人前十名股东持股情况

截至本招股说明书签署日，发行人前十名股东的持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
1	捷捷投资	3,000.00	42.87%
2	黄善兵	960.00	13.72%
3	中创投资	680.00	9.71%
4	王成森	480.00	6.86%

5	张祖蕾	400.00	5.71%
6	正和世通	400.00	5.71%
7	沈欣欣	300.00	4.29%
8	睿俊投资	240.00	3.43%
9	深圳创新投	150.00	2.14%
10	红土创投	150.00	2.14%
合计		6,760.00	96.58%

（三）发行人前十名自然人股东在发行人处担任职务的情况

截至本招股说明书签署日，发行人前十名自然人股东在发行人处任职情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例	担任职务
1	黄善兵	960.00	13.72%	董事长、总经理
2	王成森	480.00	6.86%	董事、副总经理、工程技术研究中心主任
3	张祖蕾	400.00	5.71%	副总经理
4	沈欣欣	300.00	4.29%	董事、财务总监、董事会秘书
5	朱 瑛	45.00	0.64%	财务部部长
6	薛治祥	45.00	0.64%	监事、动力设备部部长
7	王 琳	45.00	0.64%	—
8	张玉平	15.00	0.21%	监事会主席
9	黎重林	15.00	0.21%	防护器件项目部部长
10	颜呈祥	15.00	0.21%	市场营销部部长
合计		2,320.00	33.13%	-

（四）最近一年发行人新增股东的情况

发行人最近一年无新增股东。

（五）发行前股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前，发行人股东间的关联关系及持股比例如下：

关联股东	持有发行人股权的比例	关联关系
黄善兵	13.72%	黄善兵持有捷捷投资70%股权、黄善兵之子黄健持有捷捷投资30%股权；黄善兵之子黄健、儿媳李燕分别持有蓉俊投资99%和1%的股权。
捷捷投资	42.87%	
蓉俊投资	3.43%	
张祖蕾	5.71%	张祖蕾和妻子沈卫群、儿子张家铨分别持有中创投资40%、30%和30%的股权。
中创投资	9.71%	
红土创投	2.14%	深圳创新投持有红土创投 25%股权；发行人董事盛波担任红土创投董事总经理，担任深圳创新投高级投资经理。
深圳创新投	2.14%	

除上述情形外，发行人股东间不存在未披露的关联关系。

（六）新股发行和股东公开发售股份的安排及其影响情况

1、新股发行和股东公开发售股份的相关安排

（1）公司首次公开发行股票数量不超过 2,360 万股，包括新股发行和股东公开发售股份。公司优先发行新股，本次新股发行数量不超过 2,360 万股。

（2）公司根据实际的资金需求合理确定新股发行数量，若根据询价结果预计将出现募集资金净额(扣除对应的发行承销费用后)超过公司实际资金需求的，在符合法律、法规、规范性文件规定的前提下，公司将适当减少公开发行新股数量并有公司股东公开发售一定数量的股份，本次公司股东公开发售股份数量不超过 1,000 万股，且不得超过自愿设定 12 个月以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

（3）公司股东公开发售股份时，由有转让意愿的、持股时间在 36 个月以上的股东自行协商其可转让数量，协商不成，上述股东按照本次发行前的持股数量的比例确定其公开发售股份数量。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

（4）公司本次新股发行与公司股东公开发售股份的实际发行总量不超过本次公开发行股票数量上限，即 2,360 万股。本次发行新股数量与公司股东公开发售股份数量之和，不低于本次发行后总股本的 25%。

本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则的基础

上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。

公司拟公开发行股票如实际发生股东公开发售股份的情形，发售股东将按其公开发售股份所得对价金额与公司实际发行新股募集资金总额的比例与公司分摊承销费，其他发行费用由公司承担。届时公司将按照内部治理制度的要求履行相关程序后与相关股东签署费用分摊协议。

2、股东公开发售对发行人的影响

发行人目前的股本为 7,000 万股，本次拟公开发行 2,360 万股（其中，股东公开发售不超过 1,000 万股）。

公司优先发行新股，公司根据实际的资金需求合理确定新股发行数量，若根据询价结果预计将出现募集资金净额（扣除对应的发行承销费用后）超过公司实际资金需求的，在符合法律、法规、规范性文件规定的前提下，公司才适当减少公开发行新股数量并由公司股东公开发售一定数量的股份。股东公开发售股份是在募集资金满足了发行人实际的资金需求的前提下才发生的，因此，股东公开发售不影响发行人的生产经营。

本次发行前，实际控制人黄善兵先生控制发行人 60%的表决权，在出现只有实际控制人及控股股东按上限公开发售 1,000 万股的情况下，黄善兵先生在本次发行后仍能够控制发行人 38.28%的表决权，发行人实际控制人的控制地位不因股东公开发售股份而改变。

综上所述，发行人优先发行新股，新股发行募集资金净额在满足发行人实际资金需求的前提下才触发股东公开发售股份，发行人的实际控制人的控制地位不因股东公开发售股份而改变，股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营不具有重大影响。敬请投资者关注因发行人股东公开发售股份对发行人控制权、治理结构及生产经营的相关影响。

七、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况

截至本招股说明书签署日，发行人无正在执行的对其董事、监事、高级管理

人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况。

八、发行人员工情况

2011年末、2012年末和2013年末，发行人员工总数分别为342人、389人和389人。截至2013年12月31日，发行人员工专业结构如下

岗位	人数	占比
生产人员	295	75.84%
技术人员	43	11.05%
营销人员	19	4.88%
管理人员	23	5.91%
财务人员	7	1.80%
其他人员	2	0.52%
合计	389	100.00%

九、相关责任主体的重要承诺

发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施见本招股说明书“重大事项提示”。

发行人控股股东捷捷投资、实际控制人黄善兵先生关于同业竞争的承诺见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。

第六节 业务和技术

一、发行人主营业务的情况

（一）发行人主营业务的基本情况

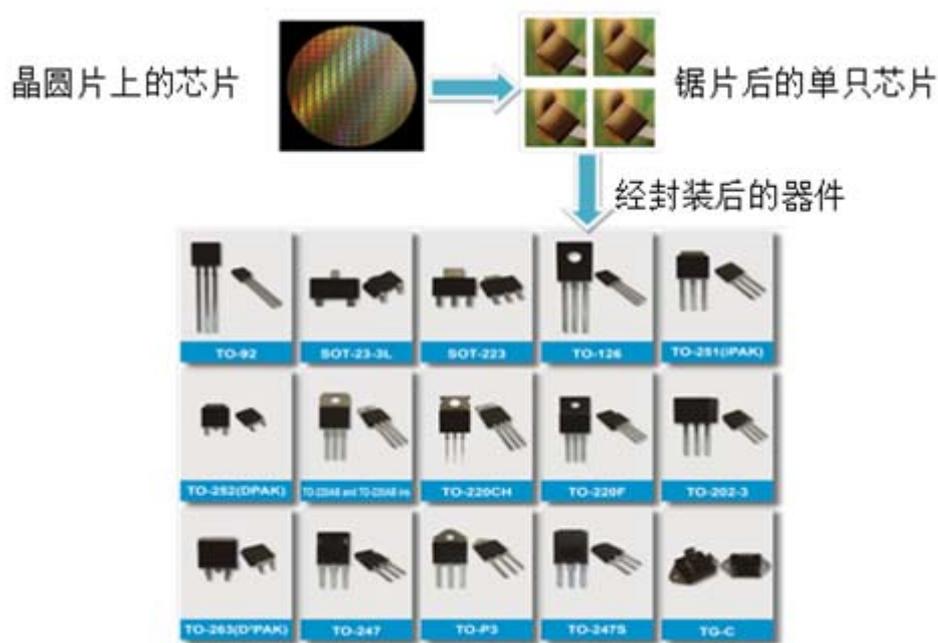
捷捷微电专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，依托自主创新能力，开发并生产种类齐全、应用广泛的功率半导体分立器件，形成了以芯片设计制造为核心竞争力的业务体系。公司目前拥有 200 多个品种的功率半导体芯片和器件产品，主要应用于家用电器、漏电断路器等民用领域，无功补偿装置、电力模块等工业领域，及通讯网络、IT 产品、汽车电子的防雷击和防静电保护领域，保证工业发展和居民生活中电能使用及转换的有效性、稳定性和可控性，并在汽车电子、网络通讯等新兴电子产品中保护昂贵电路，提高产品的安全性，成为新兴市场电子产品品质保证的要素之一。

功率半导体分立器件是电力电子技术中用来进行高效电能形态变换、功率控制与处理，以及实现能量调节的核心器件，几乎进入国民经济各个工业部门和社会生活的各个方面。不同的应用领域对功率半导体分立器件的功能有不同的要求，下游客户根据其产业和行业的特点，向公司采购标准规格产品或提出特别性能参数要求，公司根据客户定制产品的要求，设计芯片功能，依照设计方案进行生产，并最终销售给客户使用。公司突出的芯片设计能力提高了产品在其应用中的针对性，充分发挥电能转换核心器件的作用，降低电能转换和利用过程中的能量损耗，增强应用的稳定性和可靠性，合理控制应用产品的电压和电流，有效防止雷击、工业浪涌电压和静电感应对主电路的损害，为公司创造了较高的毛利率。

（二）发行人的主要产品

1、根据产品构造划分的主要产品

从产品构造划分，公司主要产品是功率半导体芯片和封装器件。功率半导体芯片是决定功率半导体分立器件性能的核心，在经过后道工序封装后，成为功率半导体分立器件成品。



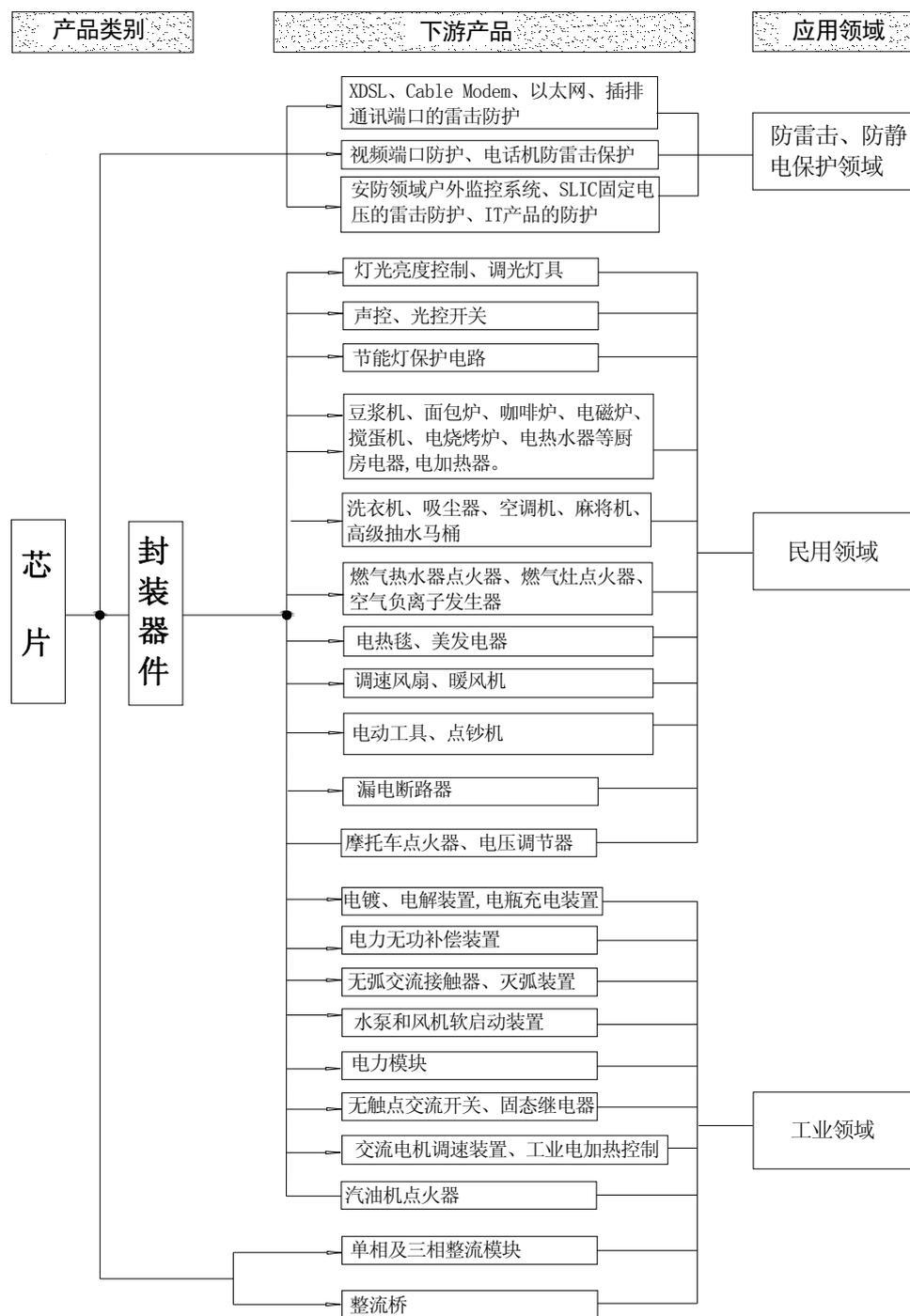
2、根据产品类别和下游应用领域划分公司产品

从产品类别和下游应用领域划分，目前公司产品主要集中在晶闸管系列产品。考虑到公司的长期可持续发展，在技术复用性和大量市场需求的基础上，公司开始逐步介入并扩大半导体防护器件的研发和制造，丰富了公司的产品线，同时拓宽了公司的业务领域。

晶闸管主要用于电力变换与控制，可以用微小的信号功率对大功率的电流进行控制和变换，具有体积小、重量轻、耐压高、容量大、效率高、控制灵敏、使用寿命长等优点。晶闸管的功用不仅是整流，还可以用作无触点开关以快速接通或切断电流，实现将直流电变成交流电的逆变，将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电等等作用。晶闸管的出现，使半导体技术从弱电领域进入了强电领域，成为工业、交通运输、军事科研以至商业、民用电器等广泛采用的电子元器件。

半导体防护类器件种类则较多，主要有半导体放电管（TSS）、瞬态抑制二极管（TVS）、静电防护元件（ESD）、高压触发二极管（SIDAC）等，可应用于汽车电子、手机、户外安防、电脑主机等各类需要防浪涌冲击、防静电的电子产品内部，防护内部昂贵的电子电路。由于使用场合广泛，市场需求量较大，半导体防护器件市场规模较为稳定。

截至本招股说明书签署日，公司产品类别、下游产品、应用领域如下图：



3、未来产品发展趋势

发行人未来产品结构将遵循丰富现有产品种类、延伸主营产品覆盖全产业链的发展战略。

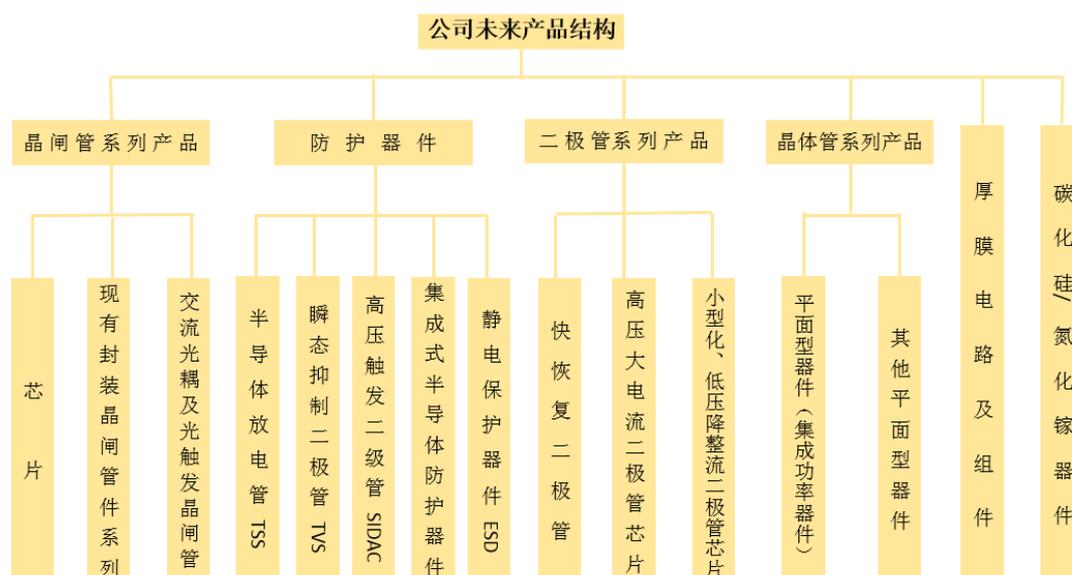
(1) 丰富现有产品种类

由于功率半导体分立器件多代产品并存，每代产品技术均有自身独特的性能优势，因此每代产品的各项技术均有继续深入发展的巨大空间。发行人将在现有产品的业务平台上，继续进行技术创新，促进产品向小型化、轻型化方向发展，性能更加安全可靠，更加节能，充分发挥功率半导体分立器件在传统产业的控制和转化电能的作用。

（2）延伸主营产品覆盖全产业链

近年来，随着信息产业的崛起，网络通讯、消费类电子及汽车电子等新兴市场迅速涌现，电子信息产业已经是当代经济发展热点，与之配套的防护器件市场需求旺盛。公司的防护器件产品已经具有多年技术研发和制造的基础，成为公司目前重点发展的产品，也是公司盈利增长点之一。

同时，公司将建立工程技术研究中心，项目研发方向围绕公司主营业务，面向新型功率半导体器件市场所需要的关键技术，面向公司近期、中期、远期重点新产品，使公司产品线覆盖了从目前的晶闸管、半导体防护器件，到近期主推的快速恢复二极管，以及中期功率 MOSFET、IGBT，并跟踪研究功率半导体分立器件发展的热点碳化硅器件，充分利用公司在功率半导体分立器件领域的技术、渠道、品牌优势，使公司产品系列形成互补。



（三）发行人主营业务收入的主要构成

报告期内，发行人的主要产品为功率半导体芯片和功率半导体器件，其收入构成如下：

单位：万元

类别	功率半导体芯片		功率半导体器件		其他		合计
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
2014年1-6月	3,974.40	37.07%	6,743.90	62.90%	3.97	0.04%	10,722.27
2013年度	6,470.66	33.26%	12,930.53	66.47%	52.58	0.27%	19,453.78
2012年度	6,932.49	40.19%	10,295.29	59.68%	21.96	0.13%	17,249.74
2011年度	7,530.74	44.22%	9,462.44	55.56%	38.56	0.23%	17,031.74

发行人营业收入按产品类别分类的构成情况如下：

单位：万元

项目	晶闸管系列		防护器件系列		其他		合计
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	
2014年1-6月	8,446.81	78.78%	1,990.31	18.56%	285.15	2.66%	10,722.27
2013年度	16,986.79	87.32%	2,172.90	11.17%	294.09	1.51%	19,453.78
2012年度	15,696.16	90.99%	1,063.76	6.17%	489.82	2.84%	17,249.74
2011年度	15,448.17	90.70%	618.02	3.63%	965.55	5.67%	17,031.74

（四）发行人主要经营模式和采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素以及经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

1、发行人主要经营模式

（1）采购模式

发行人物资管理部负责公司的原材料、辅助生产材料的采购，具体采购程序如下：

①根据采购计划对采购产品进行分类

②采购信息的编制和确定

物资管理部根据《采购计划单》编制《采购合同》，主要原材料采购文件应包括拟采购产品必要的信息。如有必要，物资采购部应请相关技术、品质管理部参与采购要求和规范的制定，或与供方共同制定采购要求和规范，以便利用供方专业知识使公司获益。

③采购的执行

物资管理部根据经批准的《采购合同》，在《合格供方名录》的供方范围内进行采购。采购通常以与供方签订供货合同的方式进行，以明确采购产品的价格、交货期限，技术标准、验收条件、质量要求、违约责任等相关内容；

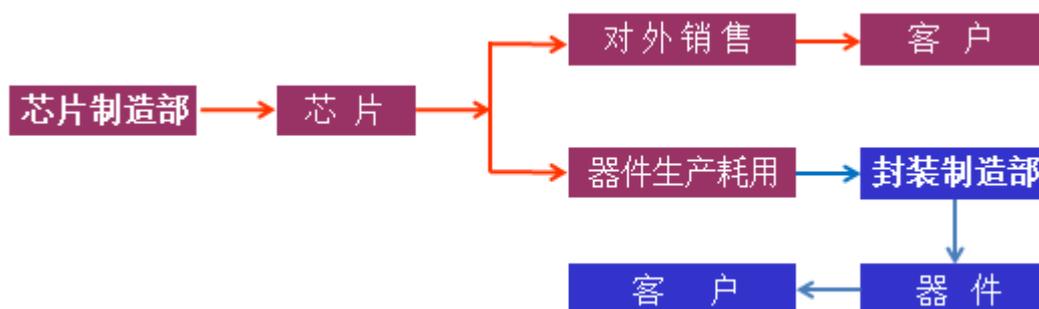
对于长年供货的供方，物资管理部在以合同的方式向供方明确采购产品的技术标准、验收条件、质量要求、违约责任等相关内容后，可以采用传真购货或口头通知的方式进行具体的采购；物资管理部应及时跟踪采购进度，反馈给相关部门。

④采购产品的验证

物资管理部应协调采购产品的验证活动；当公司或公司客户提出在供方的现场实施验证时，物资管理部应在采购信息中对需要在供应商现场开展验证的安排作出规定；采购产品到达公司后，材料仓库进行登记并存放于待检区，报相关技术、品质管理部进行检验；与供应商签订的技术协议应交品质管理部进行审核，品质管理部负责技术协议文件的管理和发放，确保公司使用的技术协议使现行有效的。

(2) 生产模式

发行人根据销售订单要求，制定生产计划，由技术管理部制定工艺卡、作业指导书和检验规程，交给生产人员生产在生产中参照执行。发行人生产部门分为芯片制造部和封装制造部，生产模式如下：



①生产计划和任务单

芯片制造部/封装制造部根据产品要求评审的结果，考虑库存情况，并结合公司的生产能力，制定《生产计划单》；芯片制造部/封装制造部根据《生产计划单》，组织下达《随工单》安排生产；

②动力设备部负责按《设备管理控制程序》的规定做好生产设备的管理、维护和保养工作。

③生产过程控制

A. 技术管理部负责编制适宜让生产员工清楚理解的工艺卡、作业指导书和检验规程；

B. 芯片制造部/封装制造部组织和监督操作者严格依据文件的要求进行操作，做好自检、互检和要求的记录；

C. 品质管理部根据《产品的监视和测量控制程序》的要求进行产品检验，按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》的要求对异常现场进行整改和预防。

(3) 营销模式

①营销理念

发行人的营销理念为：建立售前、售中、售后一体的的市场营销团队，发展知名品牌客户和优质渠道商，与客户形成战略合作，树立公司国际品牌形象，提高市场占有率。

②营销方式

发行人产品应用的市场领域较多，产品规格多，且对产品性能要求各异。发行人既销售公司通用规格的产品，也可以根据客户的诉求为其设计、生产定制化产品，并可对客户 provide 全方位的技术服务。具体销售流程如下：

A. 公司销售人员与客户进行初步沟通，了解客户的产品用途、需求、用量、付款条件等信息，及已有产品不足之处或预期产品需要达到的最佳效果，为客户提供选型服务或建议，与客户建立初步合作关系；

B. 如客户有特殊要求，销售人员应与应用工程师或其他部门工程师共同评估公司产品是否满足客户的要求，并选择合适的产品型号；

C. 销售人员和区域销售经理评估客户信誉状况，选择合作模式，后续按照此模式逐步推进合作；

D. 销售人员提供给客户相应产品的规格书，向客户介绍公司产品特点、性能指标，帮助客户认识、了解公司的产品及性能，并听取客户进一步的意见

E. 根据进度安排，销售人员准备好选型的样品提供给客户，及时跟进客户的试验情况，与客户沟通解决试验中遇到的问题，最终达到客户要求的理想效果；

F. 针对有特殊要求的客户，如其用量较大或其应用具有领域代表性，公司可为其设计、生产定制化产品，定制化产品销售流程如下：

a. 销售人员了解客户的产品特殊要求、产品应用领域、时间进度表、需求量、目标价格、付款条件等信息，填写《定制产品需求单》，交由区域经理或市场营销部正/副部长审核评估；

b. 市场营销部将《定制产品需求单》送交相关技术部门和品质管理部，品质管理部组织各部门对定制产品的市场潜力、产品性能以及公司的生产能力、物料物资、资金情况等进行评估，将评估结果向总经理汇报，由总经理作出最终批示；

c. 根据总经理同意生产定制产品的批示，市场营销部与客户签订定制产品加工合同；各部门按照分工开始生产样品，样品完成后，由相关技术部门完成产品的考核和试验；

d. 样品达到预期的性能指标后将该样品的试验结果和样品提供给客户进行产品试验，及时跟进客户的试验情况，改善产品性能并重新送样，最终满足客户要求的理想效果；

e. 根据客户定制产品的试验、生产情况，公司各部门对定制产品进行总结，确定是否将定制产品纳入公司标准产品的量产计划中。

（4）盈利模式

功率半导体芯片的设计制造能力是公司的核心竞争力，是公司可持续盈利及发展的基础。公司30余项功率半导体芯片和封装器件的先进技术不仅保证公司生产工艺领先、标准产品质量可靠，还能够按照客户提出的个性化需求设计、调整功率半导体芯片和封装器件的生产工艺，生产定制产品，及时满足终端产品在电能转换与控制、保护高端电子产品昂贵电路等方面的技术升级。同时，发行人参与到客户的生产经营中，通过分析整理客户在产品结构调整、品质提升过程中的技术瓶颈，有针对性地研发新技术，改进生产工艺，并根据下游行业的发展趋势调整自身产品结构，经公司技术、市场、生产、财务、管理各部门共同严格论证后，将确定未来有广泛市场需求的定制产品转化为公司常规产品生产，最大程度地确公司产品响应客户和行业发展的需要。

发行人为客户定制产品不仅体现了公司研发创新的技术实力，也表现出公司与客户实现双赢的市场营销能力，因此，发行人产品深受下游客户认可，品牌知名度和美誉度不断提升，客户结构正向大型化、国际化方向发展，同时，产品市场结构不断延伸，在保持传统家电市场、工业类市场优势地位的同时，正逐步进入航天、汽车电子、IT产品等新兴市场。

（5）管理模式

在长期经营发展中，公司建立了符合公司自身经营特点和发展方式的管理模式，设置合理的职能部门，在公司董事会制定的经营路线下，坚持公开、透明地执行各项公司制度和计划，协调各部门之间有效配合，形成了较高的管理效率。

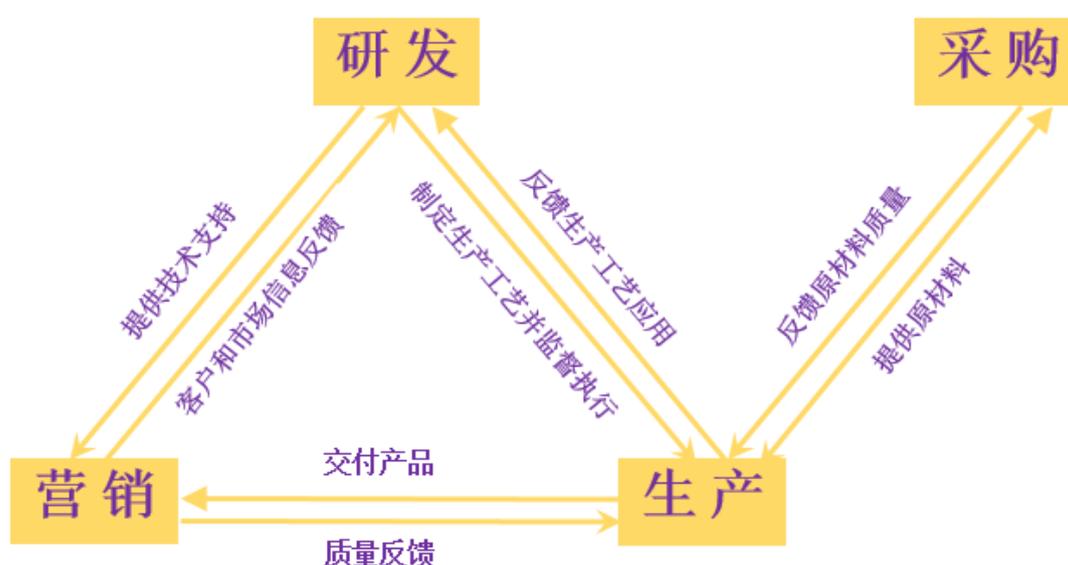
半导体行业是技术密集型行业，公司重视研发管理，根据公司现有和未来产

品系列分别设立研发部门，有针对性地研发新产品和新技术，最大程度地保证公司的研发效率和研发成果转化率，不断提高市场竞争力和盈利能力。同时，公司不断吸收引进先进人才，通过激励措施和实践培养，为公司未来发展储备技术、营销、采购各方面的管理人才。

2、发行人采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素以及经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

公司下游行业终端产品为满足节能环保、技术进步、结构升级、大众消费标准提升等各种新标准和新规定，不断调整自身产品种类，提高产品质量，因此，公司以技术创新为基础，通过掌握客户需求和下游行业的发展趋势，灵活调整生产工艺，形成了储备、销售常规产品和定制产品相结合的经营模式。

公司经营模式简图



公司的经营模式能够保证客户信息和市场信息及时反馈给公司管理层，通过管理层、营销、研发、生产、采购、财务各部门共同的分析探讨，及时调整产品结构，研发、储备符合市场需求的产品，严格落实研发成果在生产环节的应用，保证常规产品和定制产品的品质，提高资金利用效率，促进公司业务良性发展。

公司各部门的配合和协调是影响公司经营模式有效性的主要因素。营销部门和研发部门的配合能够及时调研客户需求，跟踪市场动向；生产部门和研发部门

的配合能够在生产过程中切实有效地执行公司先进工艺技术，控制产品质量；营销部门、生产部门和采购部门的配合能够保证公司原材料质量和原材料供给的及时性。

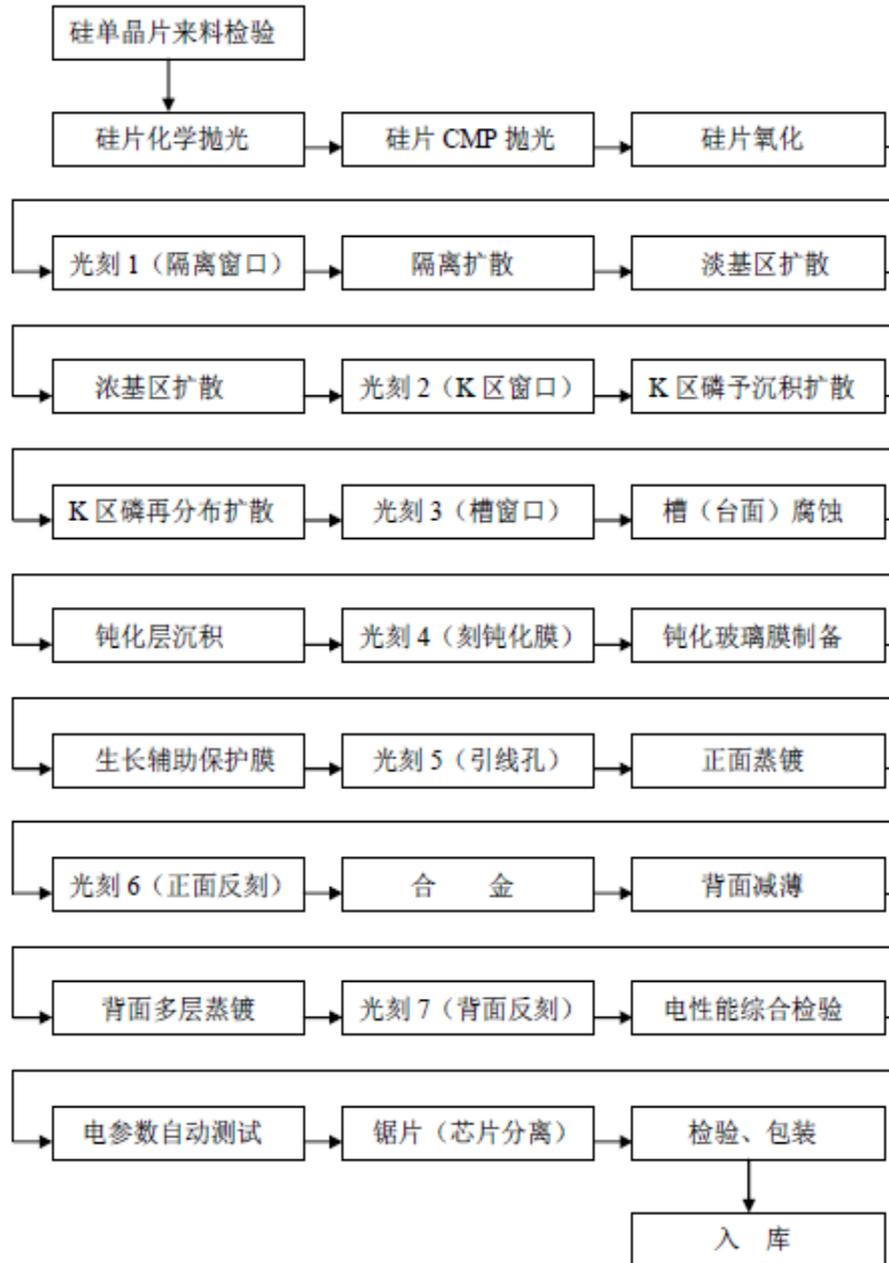
公司的经营模式和影响因素在报告期内未发生变化。公司注重人才的吸引和激励，重点培养优秀员工的业务能力和管理能力，保证公司经营模式适应产品线拓宽、市场发展和业务规模扩大等方面长期发展的需要，提高可持续盈利能力。

（五）发行人设立以来主营业务、主要产品及主要经营模式的演变情况

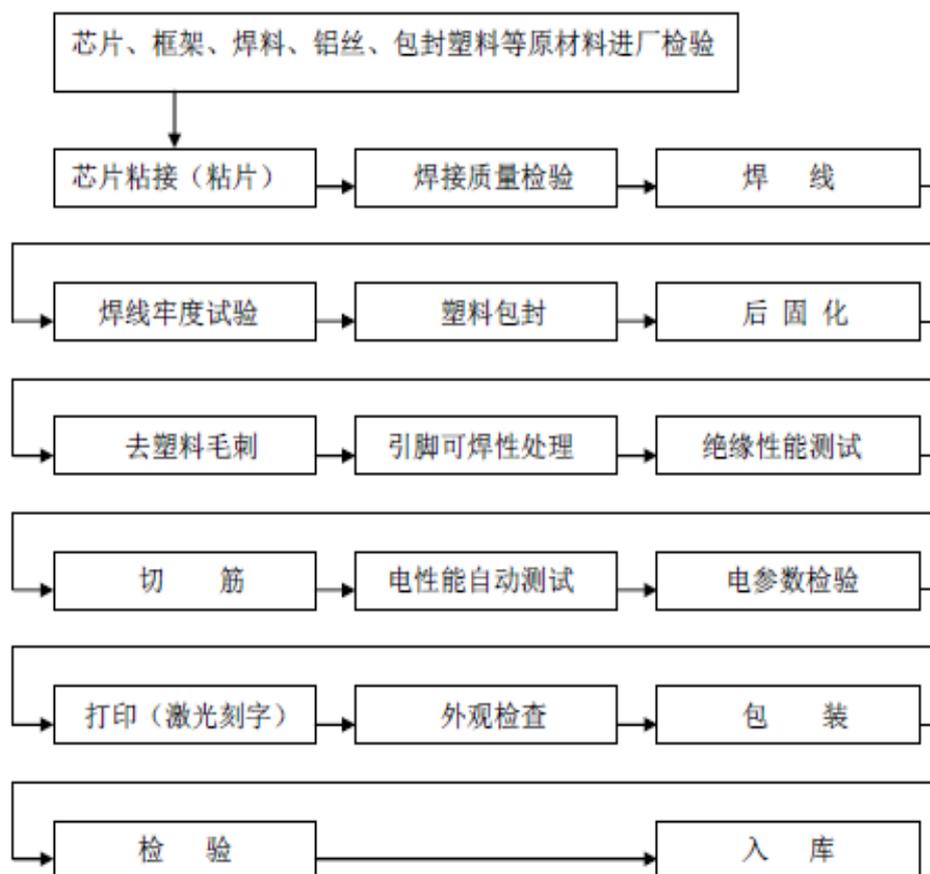
捷捷微电自设立以来从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，主营业务、主要产品和主要经营模式没有发生变化。

（六）发行人主要产品生产工艺流程图

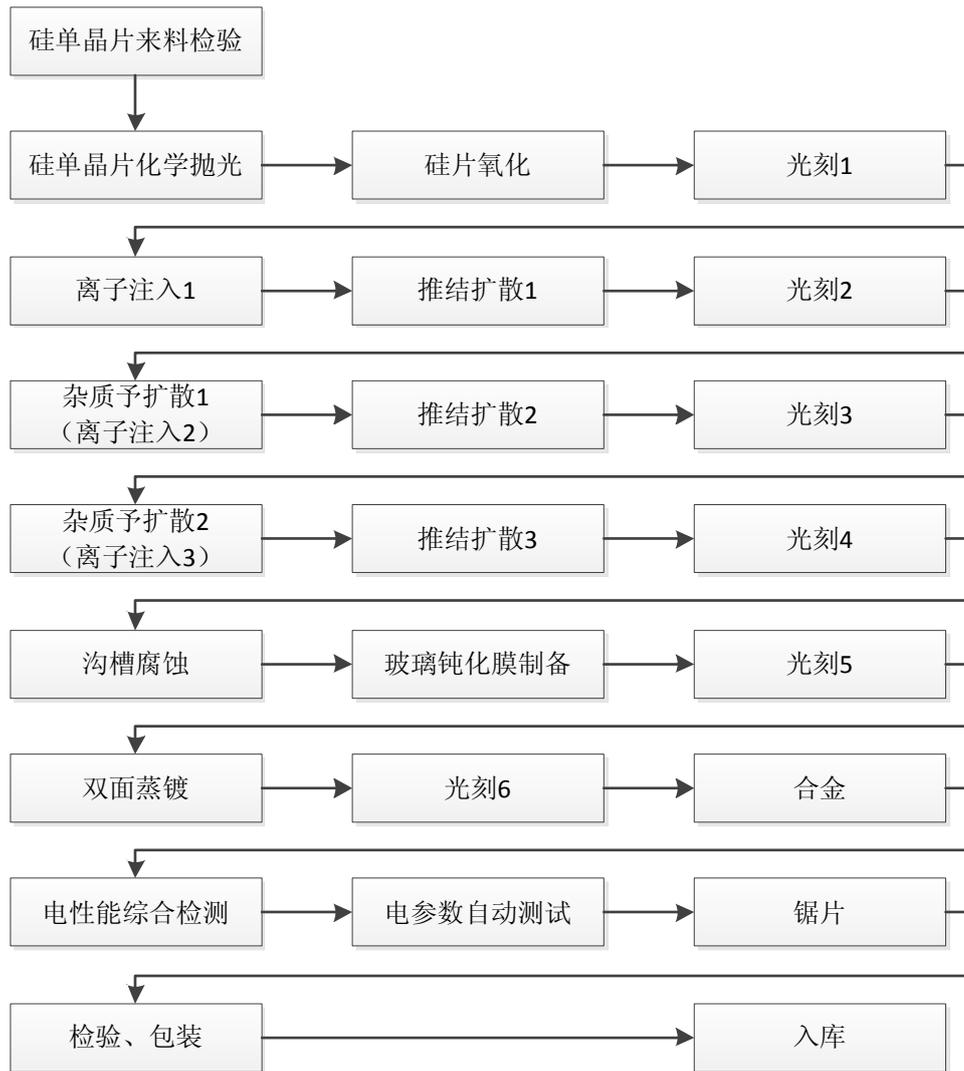
1、晶闸管芯片工艺流程图



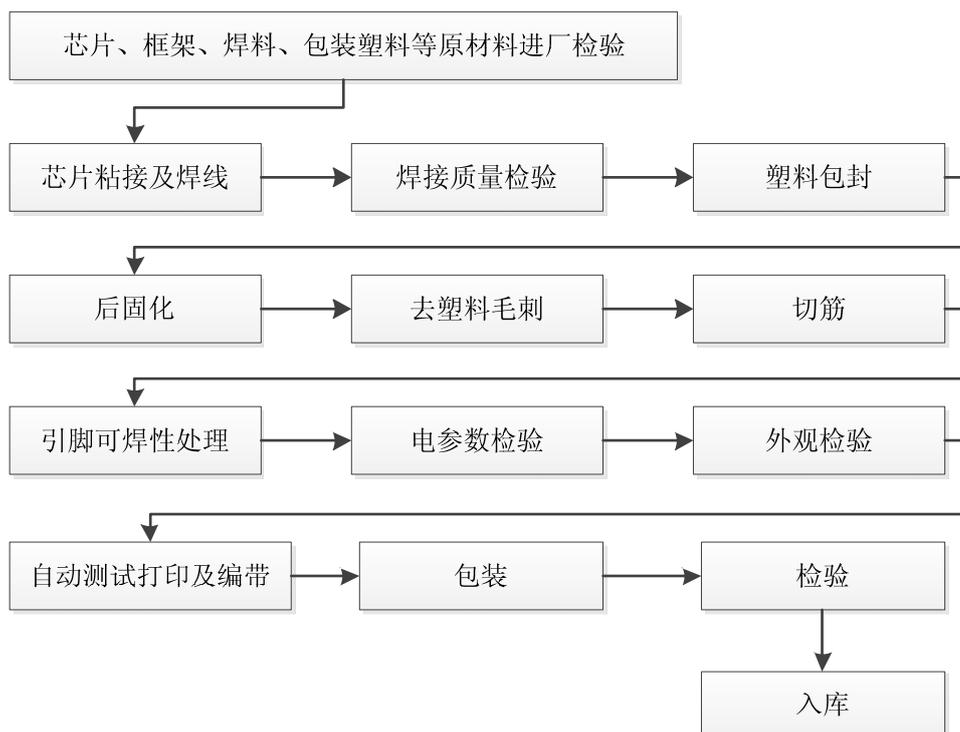
2、发行人晶闸管封装器件工艺流程图



3、半导体防护器件芯片工艺流程图



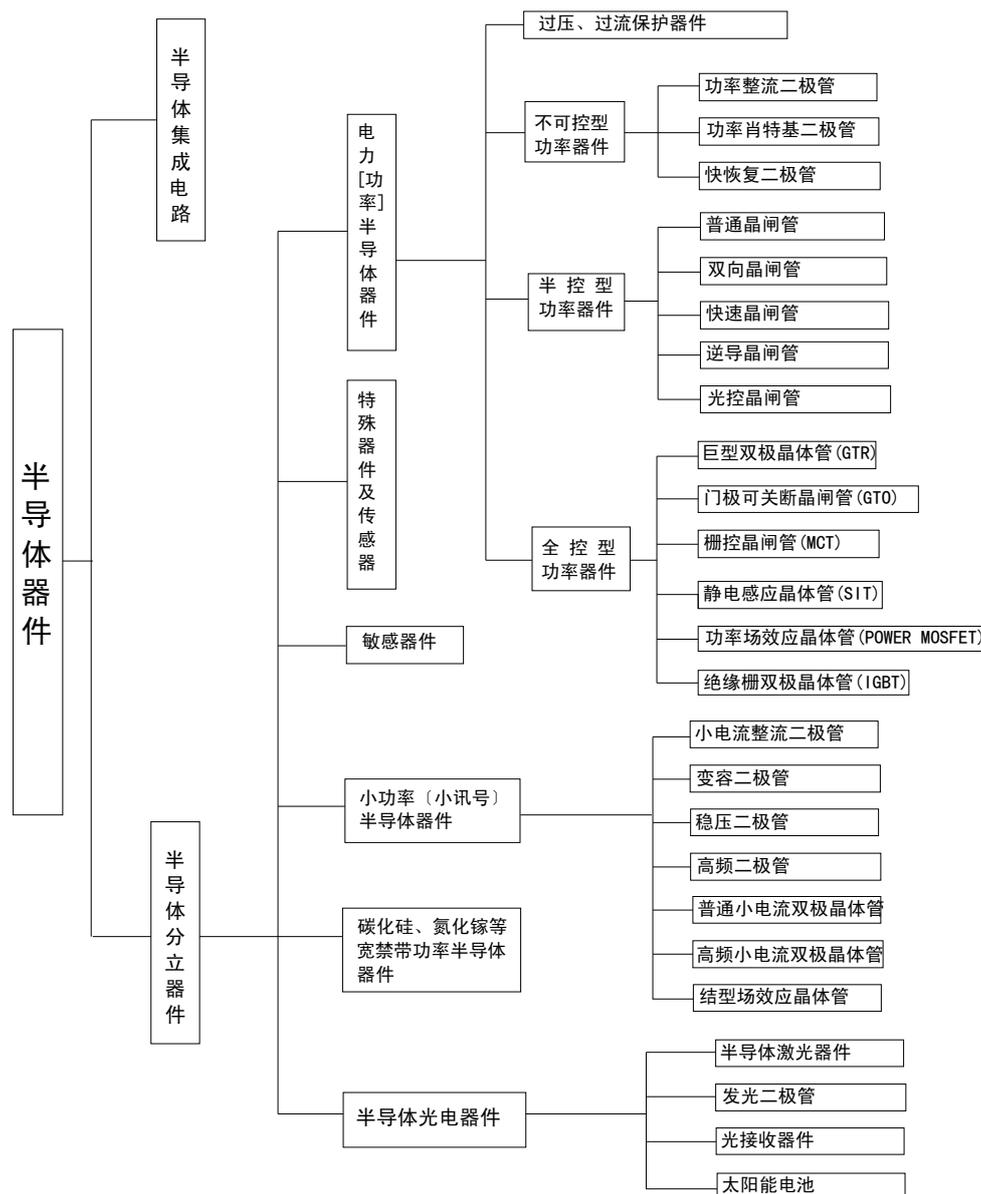
4、半导体防护器件封装工艺流程图



二、发行人所处行业的情况

(一) 发行人所属行业及其行业主管部门、监管体系、主要法律法规及政策，以及对发行人经营发展的影响

捷捷微电为专业研发、设计、生产和销售功率半导体分立器件的企业，拥有以芯片制造和器件封装构成的完整业务体系。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局国民经济分类标准，发行人属于“C3962 半导体分立器件制造”。作为半导体行业的主要组成部分，功率半导体分立器件是发电、输电、变配电、用电、储能、家用电器、IT产品、网络通讯等领域的基础核心部件。



1、行业主管部门、自律组织及监管体制

工业和信息化部是半导体分立器件制造行业的主管部门，其主要职责包括：提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业等。

中国半导体行业协会是半导体分立器件制造行业的自律性组织，成立于

1990年11月17日，下设5个分支机构：集成电路分会、半导体分立器件分会、半导体封装分会、集成电路设计分会和半导体支撑业分会。半导体行业协会主要任务包括：贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；做好政策导向、信息导向、市场导向工作；广泛开展经济技术交流和学术交流活动；开展半导体产业的国际交流与合作；协助政府制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准。推动标准的贯彻执行等。

2、行业主要法律法规和政策

功率半导体分立器件也被称为电力电子器件，是电力电子技术的基础和核心。电力电子技术的突破和发展都是围绕新型功率半导体分立器件的诞生和完善进行的，其应用已深入到工业生产和社会生活的各个方面，对高效利用能源发挥至关重要的作用，因此，功率半导体分立器件已被国家产业政策放在高端的关注位置，中央政府、地方政府及各部委陆续出台各种支持政策，鼓励我国功率半导体分立器件生产企业自主创新，实现关键技术的关键突破。

2006年，工业和信息化部发布了《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》，将新型元器件技术列入未来5-15年发展的15个重点领域之一。新型元器件技术重点围绕功率半导体、片式电子元器件等技术，建立以新型元器件研发为核心的元器件研发中心和以元器件性能检测、质量与可靠性检测、分析为核心的元器件评测和服务中心，逐步形成新型元器件从研制、生产到检测、评价较为完整的技术体系。

2007年，国家发改委下发了《关于组织实施新型电力电子器件产业化专项有关问题的通知》（发改办高技[2007]2484号），该《通知》以提高新型电力电子器件技术和工艺水平，促进产业发展，满足市场需求，以技术进步和产业升级推进节能降耗为目的，突破核心基础器件发展的关键技术，完善功率半导体产业链，促进具有自主知识产权的芯片和技术的推广应用，增强企业自主创新能力，支持功率半导体芯片、模块、应用装置、专用工艺设备和测试仪器四大类产品的产业化发展。

2008年，根据《信息产业“十一五”规划》中“加快元器件产业结构升级和提

高电子专用材料配套能力”的总体要求，信息产业部编制了《电子基础材料和关键元器件“十一五”专项规划》，大力发展新型半导体分立器件，紧紧抓住传统产业改造和电力系统改造的机遇，进一步加大科技投入，重点发展功率半导体分立器件，包括纵向双扩散型场效应管 VDMOS，绝缘栅双极型晶体管 IGBT，静电感应晶体管系列 SIT、BSIT、SITH，栅控晶闸管 MCT，巨型双极晶体管 GTR 等。

2009 年国务院办公厅出台《电子信息产业调整和振兴规划》，要求加快电子元器件产品升级，提高片式元器件、新型电力电子器件等产品的研发生产能力，加快发展无污染、环保型基础元器件和关键材料，提高产品性能和可靠性，提高电子元器件和基础材料的回收利用水平。

2010 年，为大力推进新型功率半导体分立器件产业发展，发展掌握自主知识产权的芯片和器件的设计、制造技术，以市场带动产业，尽快形成芯片和器件的规模化生产能力和产业配套能力，拓展电力电子技术在国民经济各领域的应用，国家发改委《关于组织实施 2010 年新型电力电子器件产业化专项的通知》（发改办高技[2010]614 号），确立了功率半导体分立器件产业化专项重点，支持金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）、集成门极换流晶闸管（IGCT）、绝缘栅双极晶体管（IGBT）、超快恢复二极管（FRD）等量大面广的新型电力电子芯片和器件的产业化，重点解决芯片设计、制造和封装技术，包括结构设计、可靠性设计，以及光刻、刻蚀、表面钝化、背面研磨、背面金属化、测试等工艺技术，提高产品档次。

2011 年全国人大通过了《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，提出依托于国家重点工程发展重大技术装备政策，提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平。在此基础上，国家发改委在《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中明确将“继电保护技术、电网运行安全监控信息技术开发与应用”、“输变电节能、环保技术推广应用”、“降低输、变、配电损耗技术开发与应用”列入鼓励类项目。随后，工业和信息化部印发了《产业关键共性技术发展指南（2011 年）》，把能够在多个行业或领域广泛应用，并对整个产业或多个产业产生影响和瓶颈制约的技术定义为产业关键共性技术，由于关键共性技术的研

究难度大、周期长，特别是在基础材料、关键工艺、核心元部件、系统集成等方面的关键共性技术，已经成为制约我国产业持续健康发展的核心问题；产业关键共性技术的研究开发是工业和通信业发展的基础，也是我国构建现代产业体系，加快转变发展方式，培育和发展战略性新兴产业，促进产业结构优化升级，增强自主创新能力和核心竞争力的关键环节。

3、行业相关政策对发行人经营发展的影响

在产业政策支持和国民经济发展的推动作用下，我国功率半导体分立器件行业整体的技术水平、生产工艺、自主创新能力和技术成果转化率有了较大的提升。发行人收益于国家政策的技术导向，依靠自身的技术积累和探索，已经形成了以芯片设计制造能力为导向的核心竞争力。功率半导体芯片的应用范围可以延伸到计算机、电子、电力、通讯、交通、信息安全、电器制造等生产生活的各个领域，是电能控制和转换的指挥中心，因此，功率半导体芯片是发展电力电子技术和高新技术产业的基础零部件，也是核心零部件。发行人芯片设计制造能力的提升是公司长期可持续发展的关键。

国家半导体产业政策的技术导向和扶持对公司经营形成了良好的发展环境，鼓励本土企业在拥有自主知识产权的基础上，与国际产品形成良性竞争，降低我国对进口功率半导体分立器件的依赖性。

由于国际大型半导体公司对技术的严密封锁，我国半导体技术很难通过合作开发方式快速发展，必须依靠自主创新突破技术瓶颈，产品国产化进程是一个长期的过程。晶闸管是我国技术成熟的功率半导体分立器件，发行人生产的高端晶闸管系列产品在生产工艺和产品性能上已经达到国际同类产品的标准，因此也成为我国半导体产品国产化的突破口，降低下游产品的成本，为下游产品的电能控制和转换系统提供更加安全、高效、稳定的核心器件，率先以性能先进、质量可靠、性价比高等优势替代进口同类产品。同时，发行人晶闸管系列产品的出口规模也稳步扩大，体现出我国半导体产业发展的必然趋势。

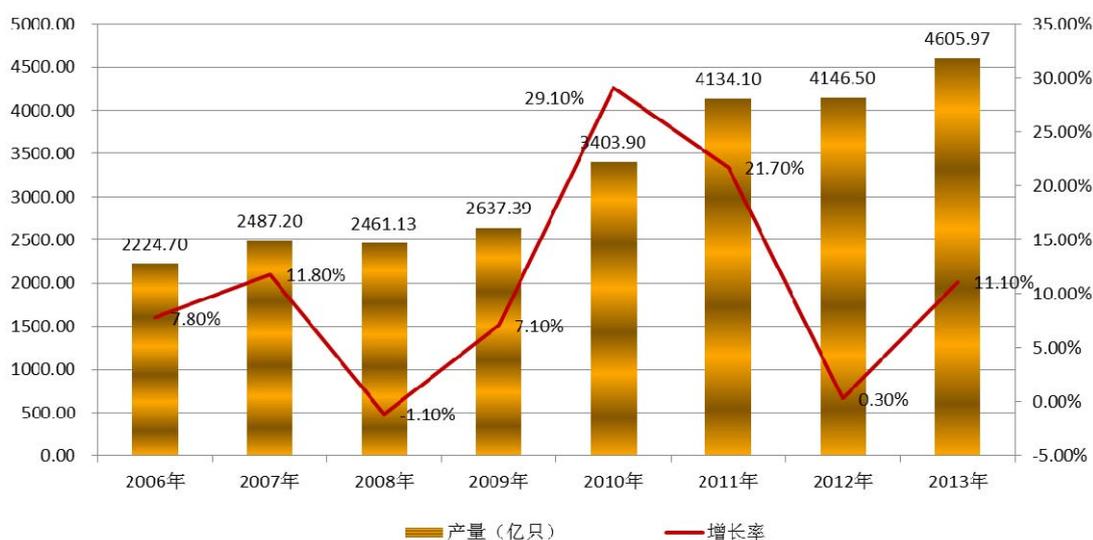
（二）发行人所处行业的整体情况

1、半导体分立器件行业的概况

半导体产业的发展始于分立器件，半导体分立器件作为半导体产业的两大分支之一，具有广泛的应用范围和不可替代性。半导体分立器件种类繁多，包括功率半导体分立器件，特殊器件及传感器，敏感器件，小功率半导体分立器件，碳化硅、氮化镓等宽禁带功率半导体分立器件和半导体光电器件六大类别。电力电子技术用于电能分配、转换和控制，通过高效率地变换电能，将“粗电”变为“精电”，使电子产品和电力设备更加精准地达到使用目标，如通过变频进行调速，使变频空调在节能 70%的同时更安静，令人感觉更舒适；豆浆机、电磁炉、电烤箱等小家电在人们生活中的普及率越来越高，功率半导体分立器件在小家电中的应用，增加了人们使用小家电时的方便性和安全性，生活质量得到提升；手机的功能越来越多，同时更加轻巧，很大程度上得益于功率半导体研发和超大规模集成电路的发展的进步；同时，人们希望一次充电后有更长的使用时间，在电池技术没有革命性进步以前，需要更高性能的功率半导体分立器件进行高效的电源管理。

电能是人类消耗的最重要能源，无论是水电、核电、火电还是风电，甚至各种电池提供的化学电能，大部分均无法直接使用，目前，发达国家电能的 75% 需要经过功率半导体分立器件变换或控制后使用。功率半导体分立器件通过降低电子产品、电力设备的电能损耗，实现节能环保，是电能控制系统节能减排的基础技术和核心技术。

我国半导体分立器件产业产量增长状况



数据来源：中国半导体行业协会《中国半导体产业发展状况报告（2014年版）》

2013年我国功率半导体分立器件产业产量为4,605.97亿只，与2012年相比增长了11.10%，销售收入为1,535.95亿元，较2012年同比增长了10.50%。随着国内节能环保、新能源、新能源汽车等下游应用产业的快速发展，以及国家产业政策对下游新兴产业的大力支持和对传统行业的升级改造，我国功率半导体分立器件市场的销售将随之稳步增长。

我国功率半导体分立器件产业销售额增长状况及发展预测



数据来源：中国半导体行业协会《中国半导体产业发展状况报告（2014年版）》

2、功率半导体分立器件下游行业情况

功率半导体分立器件受益于下游行业应用广阔，一直在人民生活和工业生产用电中发挥电能转换和控制的作用，市场需求将持续增加。在传统应用领域，功率半导体分立器件引领工业发展方式向节能型转变，实现家电工业转型升级，优化产业结构，提高生活质量。功率半导体分立器件也是电子信息产业的基础，其发展影响着整个信息产业的进程。随着物联网、云计算、新能源、节能环保等一系列“十二五”规划的陆续出台，电子信息产业已经是当代经济发展热点，新兴领域成为支撑功率半导体分立器件保持较好发展势头的重要市场。

(1) 传统下游行业的基本情况

①输变电行业的基本情况

A. 输变电行业的总体运行情况

我国人均用电量水平远低于美、英、日等发达国家，电力行业及其配套设施未来增长空间巨大。由于我国能源资源与消费需求分布很不平衡，常规能源和可再生能源主要在西部和北部地区，70%以上的能源需求集中在东中部地区，能源基地与负荷中心相距 1000 公里到 3000 公里，为配合用电需求，我国“十二五”期间将投建 14 条特高直流输电项目，“十三五”将规划投建 15 条直流工程。国家电网预计，2015 年全国装机容量将达到 14.7 亿千瓦，“十二五”期间年均增长 8.9%；“十三五”年均增长 4.6%，装机容量在 2020 年将超过 18 亿千瓦；到 2030 年，我国装机容量将进一步提高至 24.7 亿千瓦。

为满足我国电力需求的增长和用电节能化的趋势，《国家电网智能化规划总报告》确定电网智能化建设的三个阶段，2009 年—2010 年规划试点阶段，2011 年—2015 年全面建设阶段和 2016 年—2020 年引领提升阶段。目前，我国当前处于电网建设的第二阶段，输变电是电力系统的重要环节，其建设规模也将随坚强智能电网建设而稳步扩大。随着坚强智能电网输变电建设的推进，柔性输电技术得到全面推广应用，输配电网线损也将成下降趋势。按照坚强智能电网比传统电网线损率下降 0.1%测算，预计 2020 年因坚强智能电网的发展将减少线损电量约 72 亿 kWh。

B. 无功补偿装置提高电能利用效率、降低能源损耗，发展前景良好

无功补偿装置在电子供电系统中起提高电网的功率因数的作用，降低供电变压器及输送线路的损耗，提高供电效率，改善供电环境。

直流输电工程的发展离不开交流网络的建设，新能源发电并网需求也在迅速增加，但其不稳定特性威胁着电网的安全，柔性输电系统成为保障电网安全运行的有效手段。动态无功补偿装置是柔性输电系统的核心，能快速有效调节电网的无功功率，抑制电压波动和闪变，使整个电网负荷的潮流分配更趋合理，改善电网质量

在国家陆续出台实施电力系统技术标准、发展规划的同时，高端无功补偿装置在智能电网的建设中的普及率快速上升。“十二五”期间，国家电网公司将结合

大规模可再生能源基地建设时序和规模，在送电通道重要的枢纽变电站、电压薄弱节点、振荡中心、大容量风电场汇集接入点应用推广静止无功补偿器(SVC)、静止同步补偿器(STATCOM)。无功补偿装置是发行人产品的重要应用领域之一，受益于未来输配电市场规模持续扩大，未来动态无功补偿装置市场前景广阔。

②家用电器行业的基本情况

家用电器是我国居民生活中重要的消费品，家电工业在轻工业中居于支柱地位，是我国具有较强国际竞争力的产业之一。目前我国正处在消费结构快速变动和升级的时期，居民消费正由以衣、食为主的生存型、温饱型，向以住、行为代表的小康型、享受型转变，家电行业在城市消费升级和农村消费普及的大环境中得到良好的发展。《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》对家电工业在“十二五”时期的主要目标、质量指标、节能环保指标均做了明确的规定，要求主要家电产品能效水平平均提高 15%，产品返修率降低 20%，主要家电产品抽查合格率达到 95%以上；积极推广与开发小家电产品，小家电产品的安全、性能和可靠性进一步改进。

家用电器均由电能驱动，因此，电能控制和转换的能力决定了家电运行的稳定性，并直接影响人们使用家用电器的舒适度和安全性。功率半导体分立器件是家用电器的关键零部件，是家用电器性能和品质的决定性因素之一，性能优异的功率半导体分立器件将提升家电整机产品的可靠性、方便性、节能性和安全性，在我国家用电器整体升级、市场扩展的大背景下，功率半导体分立器件的市场空间将随着家电行业的发展而具有稳定的市场空间。

(2) 下游新兴行业市场的基本情况

功率半导体分立器件作为电子信息产业的基础，其发展影响着整个信息产业的进程。4G 通信、IT 产品及汽车电子等新兴市场的迅速崛起，使电子信息产业成为当代经济发展热点，并已渗透到现代科技和国民经济的各个重要领域。通讯网络、IT 产品和汽车电子的内部电路结构复杂、成本较高，外界的雷击、静电等情况产生的过电流、过电压会超过上述产品内部电路的承载范围，导致电路直接损坏。功率半导体防护器件能够及时阻断过载电流或防止雷击、工业浪涌电压和静电感应，保护新兴电子产品的昂贵电路，提高电子产品的品质，也增加使用

者的安全性，因此，汽车电子、手机、电脑、户外安防等新兴领域的快速发展成为功率半导体分立器件的强劲需求来源。

3、功率半导体分立器件细分行业的具体情况

(1) 细分行业---晶闸管系列产品

晶闸管是基础型功率半导体分立器件，尽管后期全控型、高频率、集成化、模块化功率半导体分立器件逐步产生并迅速发展，晶闸管仍然是迄今为止能承受的电压和电流容量相对较高的功率半导体分立器件。

晶闸管是一种三端四层的晶体管，自问世以来，在普通晶闸管的基础上派生出许多不同性能的新型晶闸管，主要包括单向晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管、逆导晶闸管、可关断晶闸管、快速晶闸管、高频晶闸管等，每个类别按照不同的参数可继续划分为不同规格型号，晶闸管技术和器件是一个广义的概念，形成功率半导体分立器件的细分行业。晶闸管技术至今仍在继续突破和完善，生产工艺不断优化，产品性能随之提升，由于其技术成熟、工作可靠性高、性价比优势明显等特点，在发电、输电、变电、配电、用电的各个应用场合占有重要地位，具有应用广泛性和不可替代性的特点：

①晶闸管的器件特点和应用特点

A. 可靠性高

一个功率半导体分立器件的可靠性缺陷会导致整个电能控制系统发生故障，由此产生的经济损失远远超过一个分立器件本身的价值，因此，功率半导体分立器件的可靠性决定了下游产品运行和使用的稳定性和安全性。晶闸管系列产品技术成熟、可靠性高，具有如下特点：

a. 晶闸管没有介于导通和关断之间的放大区，因此通态内阻最小，发热最少，承受过电流能力极强，可以达到 10-15 倍的额定电流。

b. 单管电流大，不需要多器件并联。目前大功率晶闸管可以做到额定电流 6000A 以上，避免了在大电流应用时必须并联，从而产生不均流导致器件损坏问题的发生。

c. 控制触发简单，只需要很窄的脉冲，易于采用变压器或光电耦合器实现强弱电的隔离，使弱电控制免受强电干扰，大大提高了控制装置的可靠性。

B. 容量大

晶闸管具有耐高压、大电流、控制方便等优点，可以直接用于控制交流电，应用具有不可替代性。作为晶闸管在工业领域的主要应用之一，典型的静止无功补偿装置为晶闸管控制电抗器（TCR）和晶闸管投切电容器（TSC），晶闸管电子开关充分利用了电压过零触发、电流过零切除、开关无触点、响应速度快等晶闸管特性，在超高压输电系统中提高电网的功率因数，降低供电变压器及输电线路的损耗，提高供电效率，改善供电环境，增强电力系统运行的稳定性和安全性，是电力传输过程中不可缺少的重要装置。在低压供配电系统中，静止无功补偿装置用于电压调整，改善电压水平，减少电压波动，改善功率因数，抑制电压闪变，平衡不对称负荷及配套滤波器能吸收谐波和减小谐波干扰。

②我国晶闸管市场的情况

A. 晶闸管是我国功率半导体分立器件中技术成熟的细分产品

我国半导体行业起步较晚，在国际大型半导体公司实行严格技术封锁的环境下，完全依靠自主创新和技术积累逐步发展起来。现阶段，相对于行业中的全控型功率半导体分立器件，晶闸管是我国半导体分立器件行业中技术比较成熟的细分产品，并在普通晶闸管的基础上，派生出单向晶闸管、双向晶闸管、逆导晶闸管、可关断晶闸管、快速晶闸管、高频晶闸管等新型晶闸管器件，在性能上弥补了普通晶闸管的不足之处，如高频晶闸管提高了普通晶闸管的开关频率、双向晶闸管具有正反两个方向都能控制导通的特性、逆导晶闸管具有反向导通的功能、可关断晶闸管具备自关断能力，为下游行业提供了更多种类、更为经济的功率半导体分立器件系列。

新型晶闸管产品类别丰富的同时，生产工艺的技术瓶颈也实现重大突破。材料的改进和工艺技术的优化促使晶闸管技术向精细化方向发展，全方位提升晶闸管器件的可靠性、稳定性和一致性。行业内的优秀企业通过持续的研发投入和探索创新，掌握了晶闸管领域的核心技术，拥有自主知识产权。

B. 晶闸管国产化打破了国内功率半导体分立器件市场受制于国外技术的局面

国外大型半导体公司在我国半导体市场上长期处于优势地位，约占我国半导体市场份额的 70%，晶闸管系列产品是国外公司的主流产品之一，长期以来占据广泛的市场空间。随着我国晶闸管系列产品技术深入性和外延性的双向快速发展，本土晶闸管产品的质量优势和价格优势已经逐渐体现，并获得市场认可，技术已经达到国际先进水平，晶闸管国产化打破了国内功率半导体分立器件市场受制于国外技术制约的局面，并通过对外出口打开高端晶闸管的国际市场空间。

国内下游行业的知名企业和大型企业过去主要采用国外功率半导体分立器件，从而确保自身产品质量的可靠性。近年来，国产晶闸管产品系列丰富，性能优势明显，达到国际同类产品标准，行业内的优质产品通过越来越多知名企业的考核和认证，并开始大量采购应用，下游产品的缺陷率和产品退返率也因晶闸管性能的提高而呈现下降趋势。国产化晶闸管的市场份额开始扩展到原外国产品占领的市场空间，市场前景广阔。

国内高端晶闸管产品性能优势也引起了国际大型半导体公司和下游行业知名企业的关注。这些跨国公司在前期严格考核产品性能、生产工艺等技术标准后，向我国具有高端晶闸管芯片研发能力和制造能力的半导体公司采购晶闸管器件，并逐年加大采购数量。作为我国技术成熟的功率半导体分立器件，高端晶闸管在国内市场替代进口的同时，市场空间也延伸至国际市场，实现对外出口，在细分产品市场内与国际同类产品的高端领域展开竞争。

C. 晶闸管是当前市场上性价比优势突出的功率半导体分立器件

功率半导体分立器件种类繁多，多代产品并存，产品间不可替代性突出。晶闸管系列产品经过多年发展，与 MOSFET 和 IGBT 相比具有自身独特的竞争优势。下游客户在选择功率半导体分立器件时，综合每种器件的实用性、经济性、可靠性、技术成熟性等复合因素做出最终购买决定。在功率半导体分立器件市场上，晶闸管的价格明显低于 MOSFET、IGBT 产品，其可靠性优势能够保证客户在使用过程中提高终端产品的良品率，减少维修费用，因此，在晶闸管和 MOSFET、IGBT 并存的市场上，高品质晶闸管以其突出的性价比优势称为众多

客户的首选。

我国高端晶闸管的性价比优势更加突出。在产品性能方面，我国高端晶闸管性能已完全具备与国际同类产品竞争的實力；在生产成本方面，我国高端晶闸管生产企业拥有有效的技术成果转化机制，配合新材料应用、生产工艺优化、先进设备投入、人员操作技能提高等多种积极因素的影响，生产成本得到有效控制，单位芯片和器件的成本降低，销售价格也相对偏低，与国际同类晶闸管产品相比，在国内和国际市场上具有更加突出的性价比优势。

（2）细分行业---半导体防护器件系列产品

半导体防护类器件种类较多，主要有半导体放电管（TSS）、瞬态抑制二极管（TVS）、静电防护元件（ESD）、高压触发二极管（SIDAC）等，可应用于汽车电子系统、楼宇监控及安防系统、通讯设备及通讯终端、电脑各种接口保护、电子消费品、便携式电子产品、仪器仪表、家用电器和工业电器控制等各类需要防浪涌冲击、防静电的电子产品内部，用以对昂贵的电路提供防护，以免受到突发的过高电压或过大电流损害。半导体防护器件可使电子产品具有抗雷电浪涌（SURGE）、静电放电（ESD）、电瞬变（EFT）电感负载切换以及交流电源波动的能力，使得产品更加耐用可靠，从而可以降低产品的修理、维护及更新的费用。

由于使用场合广泛，半导体防护器件市场规模较大，并不断外延。随着节能环保和智能化时代的到来，家用电器和电子产品向着高端方向演进，高效节能、绿色环保、智能化、一体化等高新技术引领行业发展。在此背景下，一方面是下游产品的技术进步和功能增加使得总体数量上需要更多的半导体防护器件，另一方面智能化和高端化的下游产品更加精致和昂贵，更加需要高性能、高可靠性的防护器件进行雷击防护和静电防护。此外，在注重用户体验的营销战略下，基于用户体验和产品安全的考虑，高性能、高可靠性的防护器件也将受到更多下游生产商的重视，需求将进一步扩大。

手机产业是半导体防护器件的主要应用领域，对半导体防护器件行业带动较大。随着移动互联网的发展和手机普及率的进一步提升，全球手机市场将保持持续增长的趋势，带动半导体防护器件的市场需求大幅增长。同时，智能手机产量

增长以及向轻薄化、高端化的发展趋势，使得片式化、高性价比的半导体防护器件需求趋于旺盛。

从近年汽车市场发展看，电动动力系统、智能化汽车开始引领市场潮流。电动汽车系列高端产品诞生使得汽车产业的整体走势日趋明朗，高端汽车智能化快速发展。随着国内消费水平的提高以及充电桩的布局完善，电动汽车市场将迎来新一轮结构快速升级和产品大批量更新，这将有利于促进国内汽车市场规模增长。电动汽车高端化的整体发展脉络日渐清晰，使得高端半导体防护器件产品具有较大发展潜力。

（三）发行人产品的市场地位、技术水平及特点、经营模式、竞争优势与劣势，以及近三年的变化及未来发展趋势

1、发行人产品的市场地位

（1）行业竞争格局、市场化程度和行业内主要企业情况

由于半导体分立器件是电能转换和控制的核心部件，而国民经济发展和居民生活都离不开用电，因此半导体分立器件具有广阔的市场空间。相较于国际半导体行业集中度较高、技术创新能力强等特点，我国半导体分立器件制造行业起步晚，并受制于国际半导体公司严密的技术封锁，只能依靠自主创新，逐步提升行业的国产化程度。国际大型半导体公司如意法半导体公司、瑞萨电子株式会社、艾塞思公司、恩智浦半导体公司等在我国市场上处于优势地位，构成我国半导体分立器件市场竞争中的第一梯队。

通过长期技术积累，少数国内半导体公司已经突破了部分半导体分立器件芯片技术的瓶颈，芯片的研发设计制造能力不断提高，品牌知名度和市场影响力日益凸显，盈利能力也明显增强，形成我国半导体分立器件市场竞争中的第二梯队。

我国功率半导体分立器件制造行业的第三梯队主要由大量的器件封装企业组成，由于缺乏芯片设计制造能力，第三梯队在我国半导体分立器件市场上的利润空间低，竞争比较激烈。

①国际大型半导体公司占据我国功率半导体分立器件市场的优势地位

我国已经成为全球功率半导体产业的重要市场，但我国功率半导体分立器件的设计制造能力还有待提高，国内功率半导体企业的生产条件和工艺技术大多仍处在国外上世纪 90 年代的水平，关键技术仍掌握在少数国外公司手中。欧美和日韩企业凭借着产品质量好、技术领先，在我国功率半导体市场中占据绝对优势地位，而我国半导体企业技术水平相对落后，优势产品种类相对单一，和国际一流半导体公司在全控型功率半导体分立器件市场上的竞争能力上有明显差距。目前，国内国内市场所需的功率半导体分立器件主要依赖进口产品，国际大型半导体公司产品在我国市场的优势地位突出。

近年来，我国对功率半导体分立器件旺盛的市场需求吸引国际大型半导体公司在我国境内不断扩张业务规模，并在产品价格、种类、技术创新、新产品开发、成本、供货及时性等各个方面加强实力，计划在我国扩大生产规模，建立研发中心，获取更多优势，与行业内优秀的本土企业展开竞争。

②市场化程度高，少数具有综合实力的国内优质企业竞争优势相对突出

我国从事功率半导体分立器件行业集中度低，规模以上的功率半导体分立器件公司约有 2000 家，只有少数本土公司具备芯片研发、设计、制造全方位的综合竞争实力，通过长期的技术积累和持续的自主创新能力，生产出附加值较高的产品，满足客户严苛的产品认证标准，市场知名度和盈利能力稳步提升，在国内竞争主体众多的环境中处于领先地位。

（2）行业内主要企业情况

捷捷微电是功率半导体分立器件行业内专业从事芯片设计、研发、制造和成品封装的主流企业，芯片设计制造能力突出，竞争对手主要为国内外具有芯片设计制造能力的功率半导体分立器件企业，如意法半导体公司（STMicroelectronics）、瑞萨电子株式会社（Renesas Electronics Corporation）、艾赛思公司（IXYS Corporation）和恩智浦半导体公司（NXP），以及国内半导体行业的主要上市公司。

①意法半导体公司（ST Microelectronics）创立于 1987 年，是全球最大的半导体公司之一，纽约证券交易所和泛欧证券交易所上市公司，在分立器件、手

机相机模块和车用集成电路领域居世界前列。意法半导体公司是业内半导体产品线最广的厂商之一，从分立二极管与晶体管到复杂的片上系统（SoC）器件，其主要产品类型有 3000 多种，是各工业领域的主要供应商。

②瑞萨电子株式会社（Renesas Electronics Corporation）于 2003 年 4 月 1 日由日立制作所半导体部门和三菱电机半导体部门合并成立，东京证券交易所上市公司。RENESAS 结合了日立与三菱在半导体领域方面的先进技术和丰富经验，是无线网络、汽车、消费与工业市场设计制造嵌入式半导体的全球领先供应商。

③艾赛思公司（IXYS Corporation）成立于 1983 年，纳斯达克证券交易所上市公司，是全球能源管理半导体供应商，提供完整系列的功率产品和技术，从高端功率半导体产品到微控制单元，公司产品覆盖能源市场系列产品 90%以上。

④恩智浦半导体公司（NXP）由飞利浦公司创立，纳斯达克证券交易所上市公司，拥有 25,000 多项专利，全球超过 24 个研发中心，是行业内最丰富的多重市场半导体产品供应商之一，产品包含从基础器件到可提升媒体处理、无线连接与宽带通信等功能复杂的芯片等。

⑤湖北台基半导体股份有限公司（证券代码为“300046”，以下简称“台基股份”）成立于 2004 年，注册资本 14,208 万元。经营范围为功率晶闸管、整流管、电力半导体模块等大功率半导体元器件及其功率组件，汽车电子，电力半导体用散热器，各种电力电子装置的研制、生产、销售。

⑥扬州扬杰电子科技股份有限公司（证券代码为“300373”，以下简称“扬杰科技”）成立于 2006 年，公司主营业务为分立器件芯片、功率二极管及整流桥等半导体分立器件产品的研发、制造与销售。主营产品为半导体分立器件芯片、光伏二极管、全系列二极管、整流桥等。

⑦杭州士兰微电子股份有限公司（证券代码为“600460”，以下简称“士兰微”）成立于 1997 年，注册资本 43,408 万元。士兰微目前的产品和研发投入主要集中在以下三个领域：应用于消费类数字音视频系统的集成电路产品；基于士兰微电子集成电路芯片生产线的双极、BiCMOS 和 BCD 工艺为基础的模拟、数字混

集成电路产品；基于士兰微电子芯片生产线的半导体分立器件。

⑧吉林华微电子股份有限公司（证券代码为“600360”，以下简称“华微电子”）成立于 1999 年，是集功率半导体分立器件设计研发、芯片加工、封装测试及产品营销为一体的高新技术企业，拥有多条功率半导体分立器件及 IC 芯片生产线，主要生产功率半导体分立器件及 IC，应用于消费电子、节能照明、计算机、PC、汽车电子、通讯保护与工业控制等领域。

（3）发行人产品在行业中的市场地位

功率半导体分立器件行业市场容量巨大，行业内企业众多，市场集中度很低，呈现出结构性竞争的特点。发行人具有功率半导体芯片研发、设计、制造和封装测试的综合竞争优势，专注于高端晶闸管细分行业，以高品质、低成本的优势稳步替代进口同类产品在我国的市场空间，形成了较强的盈利能力。

晶闸管是功率半导体分立器件中技术成熟的产品，在所有功率半导体分立器件中，晶闸管耐压容量最高（可达 12KV 以上）、电流容量最大（可到 6000A 以上）。正是由于其高电压、大电流特性、导通损耗极低的特性，在高压直流输电（HVDC）、静止无功补偿（SVC）、大功率直流电源及超大功率和高压变频调速应用方面占有十分重要的地位。另一方面，相对于其他功率半导体分立器件，晶闸管制造成本较低、体积小、重量轻、相应配套电路结构简单的特点，保证了晶闸管的广泛应用空间。

发行人凭借长期的技术积累和自主创新，生产的高端晶闸管产品逐渐受到国际知名半导体公司和下游知名企业的重视和认可，通过了复杂的产品技术、生产工艺等前期质量认定程序，原来只采用国际晶闸管产品的下游客户以及国际知名半导体公司逐步与发行人达成供货意向或签署了供货协议，实现国产高端产品替代进口同类产品，降低我国对国际大型半导体公司的依赖，并不断增加高端晶闸管产品的出口量，在国际市场上以优良的性价比优势与国际产品展开良性竞争。

2、发行人的技术水平及特点

（1）半导体分立器件制造行业的技术水平

半导体分立器件的技术包含了电气工程中的多种领域，不同领域知识的结合

促进行业交叉边缘新技术的不断发展，并带来广阔的发展前景。电力电子技术是弱电控制与强电运行之间，信息技术与先进制造技术之间，传统产业实现自动化、智能化、节能化、机电一体化之间的桥梁，是国民经济的重要基础技术。

随着终端产品的整体技术水平要求越来越高，功率半导体分立器件技术也在市场的推动下不断向前发展，CAD 设计、离子注入、溅射、多层金属化、亚微米光刻等先进工艺技术已应用到分立器件生产中，行业内产品的技术含量日益提高、制造难度也相应增大。目前日本和美国等发达国家的功率器件领域，很多 VDMOS、IGBT 产品已采用 VLSI 的微细加工工艺进行制作，生产线已大量采用 8 英寸、0.18 微米工艺技术，大大提高了功率半导体分立器件的性能。

产品性能提高的同时，半导体分立器件的产品链也在不断延伸和拓宽。现代功率半导体分立器件向大功率、易驱动和高频化方向发展。晶闸管、MOSFET 和 IGBT 在其各自领域实现技术和性能的不断突破，每类产品系列的规格、型号和种类愈加丰富。同时，新型产品如结合晶体管和晶闸管优点的集成门极换流晶闸管 IGCT 及碳化硅、氮化镓等宽禁带功率半导体分立器件陆续被研发面世，并开始产业化应用，应用领域也渗透到能源技术、激光技术等前沿领域。

我国功率半导体分立器件行业的整体技术水平落后于日本、韩国、美国和欧洲，国内产品种类单一，以硅基二极管、三极管和晶闸管为主，MOSFET 产品、IGBT 产品近年才有所发展。由于高性能功率半导体分立器件技术含量高和制造难度大，目前国内的生产技术与国外先进水平存在较大差距，产品性能也需要市场经过大批量、长时间检验后才能确认。

与我国功率半导体分立器件行业整体技术水平落后相比，细分领域晶闸管系列产品的技术在我国得到长足的发展，行业内的优秀企业通过长期技术积累、生产工艺的改进和自主创新，形成具有自主知识产权的技术体系，生产工艺的先进性确保产品的可靠性、一致性达到国际水平，满足我国市场对高端晶闸管替代进口的需求。

（2）行业的技术特点

功率半导体分立器件的下游行业覆盖面广，终端产品发展迅速，技术要求不

断提高，节能环保标准日趋严格，带动功率半导体分立器件新技术和新产品的研发速度、技术成果转化速度、产品普及速度大幅提升。

电力电子技术自 20 世纪 50 年代开始发展起来，至今形成以晶闸管、MOSFET、IGBT、碳化硅宽禁带功率半导体分立器件为代表的多代产品，每代产品也在实践中不断突破原有技术瓶颈，派生出众多规格和型号，适应不同下游产品。新技术、新产品的诞生拓宽了原有产品和技术的应用范围，适应更多终端产品的需求，但是，每代产品在频率、功率、开关速度等参数上均具有不可替代的优势，一代新产品、新技术的产生并不能替代原有产品和技术，市场上形成多代功率半导体分立器件产品并存的格局。

（3）发行人的技术优势

发行人拥有 30 余项核心技术，能够根据客户需求生产定制化产品，较国际大型半导体公司主要生产规格化产品具有更大的经营灵活性，附加值更高。发行人通过优化生产工艺，开发新技术，应用新材料，不断提高生产效率，降低生产成本，生产的多种类、多规格分立器件在可靠性、一致性等方面已经达到了国际同类产品的质量水平，具有较强的定价自主权，与国际大型半导体公司和国内优秀企业相比，都具有较强的市场竞争优势，其市场空间已延伸至国际半导体公司原有市场，保证公司的营业收入和净利润稳定增长。

发行人较强的技术研发和工艺优化实力，保证产品性能指标处于行业领先水平，时刻以下游市场需求为技术发展方向，丰富现有产品规格型号，更好地满足多行业、多类别客户的需求，减小单一行业波动对公司带来的不利影响。同时，发行人积极进行技术储备，研发全控型功率半导体分立器件和新材料半导体分立器件，未来公司产品将向全产业链延伸，市场空间更加广阔，以高质量、低成本的产品实现更多功率半导体分立器件产品本土化，并扩大出口份额，增强公司持续盈利能力，保证公司成长性。

3、发行人的经营模式

（1）行业的经营模式

半导体分立器件的性能由其内部芯片决定，而芯片的设计参数必须通过严谨

精湛的生产工艺得以体现，因此，器件的设计与工艺制造密切相关。按照半导体分立器件的生产环节完整性，行业的经营模式分为垂直整合式和代工式。垂直整合式经营模式包含芯片设计、制造及成品封装和销售等所有环节，其中核心竞争力在于强大的芯片设计能力和精湛的生产工艺，产品附加值高，高盈利性主要体现在芯片设计和制造环节。以代工为经营模式的企业主要为有芯片设计、制造能力的企业提供后道封装工序代工业务，竞争激烈，利润空间较小。

（2）发行人的经营模式

发行人通过多年的技术积累和持续创新，形成自主知识产权，拥有研发、设计、生产制造、封装测试、销售一体化的完整业务体系，走垂直整合式的经营之路，不但能够生产种类齐全的常规功率半导体芯片和器件，也可以根据客户要求为其设计制造个性化产品，技术研发能力和生产工艺优化能力的双重强化确保企业经营模式的持续性和稳定性。

4、发行人的竞争优势与劣势

（1）竞争优势

①技术优势

A. 芯片研发优势

突出的芯片研发能力是公司最主要的核心竞争力之一，也是公司可持续发展的源动力。公司 30 余项功率半导体芯片和器件的核心技术不仅保证公司产品性能优良、工艺领先、质量稳定可靠、性价比高，还可及时根据客户需求设计、生产定制产品，不断推出新产品。由于公司下游客户分布行业广泛，客户对产品性能的要求各异，定制产品具有很大的市场需求空间，其附加值也相应较高。公司为客户定制产品，需要结合生产工艺的调整和关键技术的协调匹配，是公司芯片研发能力的重要体现，也是公司差异化发展的重要标志。国外大型半导体公司以销售标准化产品为主，较少为客户生产定制产品，并且在为客户定制产品时，开发周期相对较长。国内大多数半导体分立器件制造商不具备芯片设计制造能力，仅从事半导体分立器件的封装制造。公司立足于我国市场的实际情况，根据终端产品需求多样化和升级换代快的特点，依托于芯片研发设计技术优势，目前已经

研发并生产 200 多种型号和规格的标准产品，并通过对客户需求的评估生产个性化产品。

公司目前形成了以芯片研发和制造为核心、器件封装为配套的完整的生产链，不断提升公司芯片的研发与创新能力，促进新产品、新技术、新材料应用、新工艺的研发成果产业化，突出芯片研发和制造水平，走差异化发展道路。

B. 先进制造力优势

公司的先进制造力综合反映在将多项专利技术和专有技术全面融入生产工艺，形成完善的制造管理体系，不仅提高了产品的各项性能指标，也能够按照客户需求调整生产工艺，拓宽产品种类。

功率半导体分立器件制造对工艺设计和工艺过程控制的要求非常高，制造工艺涵盖多道工序，生产过程采用流水制造方式，制造流程较长，公司先进的工艺技术全面应用到芯片设计和制造、成品封装及品质监控及检测的生产过程中，大大提高了产品的性能。公司完善的管理体系严格监控每一生产步骤，保障产品的可靠性、稳定性和一致性处于行业领先水平。由于功率半导体分立器件制造行业属于技术密集型行业，公司先进制造力优势和充足的技术储备有助于公司实现以技术带动发展、以品质占领市场的可持续发展目标。

②替代进口优势

长期以来，我国功率半导体分立器件行业整体技术水平较国际先进技术水平有较大差距，因此我国功率半导体分立器件下游行业的知名企业长期购买和使用国际大型半导体公司的分立器件产品，以确保其产品性能先进、质量稳定。

晶闸管是我国技术成熟的功率半导体分立器件，行业内少数优秀企业已经具有较为先进的晶闸管芯片的研发制造能力。公司经过十几年的技术累积，现已形成成熟的自主知识产权体系和研发机制，晶闸管系列产品的技术水平和性能指标已经达到了国际大型半导体公司同类产品的水平，公司产品已经具备替代进口同类产品的实力。

2012年3月11日，北京电力电子学会、全国输配电用电电力电子器件标准委员会、清华大学、北京大学上海微电子研究院、北京工业大学、东南大学和南

京理工大学的行业专家对公司产品进行了技术鉴定,认为公司门极灵敏触发单向晶闸管、TO-220A和TO-3P型内绝缘塑封晶闸管器件及低结电容过压保护晶闸管器件“技术创新性强”、“性能优良、质量稳定”,“技术指标处于国内领先水平”,其中,公司门极灵敏触发单向晶闸管“技术指标达到同类产品的国际先进水平”。

公司通过技术创新提高产品的附加值,为客户设计生产定制化产品,提高了产品的性价比。公司在维持老客户稳定发展的同时,逐步打开高端客户的市场空间,境内市场份额迅速提高。知名企业对公司产品质量的充分认可是公司稳步拓展市场空间的基础,公司产品正在逐步实现以国产替代进口,降低我国晶闸管市场对进口的依赖。同时,公司产品也得到了国外知名厂商的认可,公司产品现已出口至韩国、日本、西班牙和台湾等半导体分立器件技术较为发达的国家或地区,并且对外出口数额逐年提高。公司生产的中高端产品实现替代进口及对外出口上升的趋势,打破了中国功率半导体分立器件细分领域晶闸管市场受限于国外技术制约的局面。

③品牌知名度优势

公司突出的芯片研发能力和产品质量持续提升公司品牌在行业内的美誉度和认可度。公司现有国内外知名客户如西班牙法格电子公司、浙江德力西电器股份有限公司、无锡罗姆半导体科技有限公司、苏州爱普电器有限公司、苏州莱克电气股份有限公司、常州云杰电器有限公司等在前期使用小批量试用公司产品后,不断增加对公司产品的采购数量,现已成为公司重要客户。与此同时,更多国内外知名半导体分立器件制造商或下游行业的知名企业正在与公司开展技术、生产和质量等方面的全面接触,对公司产品进行考核、认定、现场审核或小批量试用阶段等不同阶段,公司客户结构向大型化、国际化方向发展,品牌知名度和市场影响力日益增强。

公司产品获得越来越多的国内外知名企业的认可和使用,客户结构向大型化、国际化转变,以自身优势产品逐步扭转国内市场上进口半导体分立器件产品的绝对优势地位,成为国内外大型知名企业的供应商,推动公司品牌知名度迅速提升,市场影响力也逐步扩大。由于功率半导体分立器件下游行业的客户选择供应商的首要考量依据为该供应商已有客户级别,知名企业对公司产品的信任和使

用将持续深化公司的品牌优势，增强公司的市场竞争能力。

④自主定价优势

公司主营产品为具有自主知识产权的新型晶闸管系列产品，其产品性能处于国内领先水平，部分产品甚至达到了国际先进水平，具有较强的自主定价能力。公司在出口结算中，坚持以人民币为基础定价，有效避免了汇率波动对公司业绩的影响。公司通过自主定价，不仅能够保持合理的利润水平，而且逐渐形成与国际知名品牌产品相抗衡的格局。

⑤人才优势

公司以黄善兵、王成森等为核心的技术团队长期从事电力电子技术的研发工作，不断进行产品技术和生产工艺的创新，在产品生产工艺优化、产品规格开发上具有丰富的经验，为公司自有知识产权的主要研发人员。目前公司研发团队在横向丰富现有产品种类、精化生产工艺的同时，依托丰富技术经验，开发快恢复功率二极管（FRD）、MOSFET、IGBT、碳化硅（SiC）器件等功率半导体分立器件，促进公司未来产品范围全面化发展。

（2）发行人主要竞争劣势

①融资渠道单一

公司在发展过程中所需资金主要来自于股东投入和自身盈利积累，而功率半导体分立器件行业研发投入大、研发周期长，公司在现有成熟技术和产品的基础上，加强其他类型的功率半导体分立器件的研发力度，从研发、设计、试生产到最终正式投产，是一个长期、持续且不断优化的过程，需要大量资金投入才能保证研发工作顺利进行。公司以往主要靠自有资金的发展模式将面临考验，需要进一步扩充融资渠道，增强公司的研发能力。

②规模较小，抗风险能力偏弱

从全球半导体行业的发展现状看，半导体行业集中度较高，国际上的半导体公司均为大型化综合性公司，不但有利于技术创新，也能够提升企业在经济周期中的抗风险能力。尽管公司在我国半导体行业中技术领先，盈利能力较强，但公

公司规模仍然较小，抗风险能力相对偏低。

5、近三年情况及未来变化趋势

最近三年，捷捷微电产品的市场地位、技术水平及特点、经营模式、竞争优势与劣势未发生重大变化。随着公司技术创新能力不断增强，产品性能和品牌知名度不断提高，客户向大型化、知名化方向拓展，公司的市场地位逐步提升。公司未来将持续丰富现有产品的种类，根据市场需求导向精细化现有产品的性能，并通过拓宽产品线，依托现有成熟技术和发展战略，实现近期着重发展防护器件，远期培育并研发制造 MOSFET、碳化硅宽禁带功率半导体分立器件等产品，进入更为广阔的功率半导体分立器件市场空间，以替代进口产品为目标，最大化公司的盈利能力。

（四）影响发行人发展的有利和不利因素

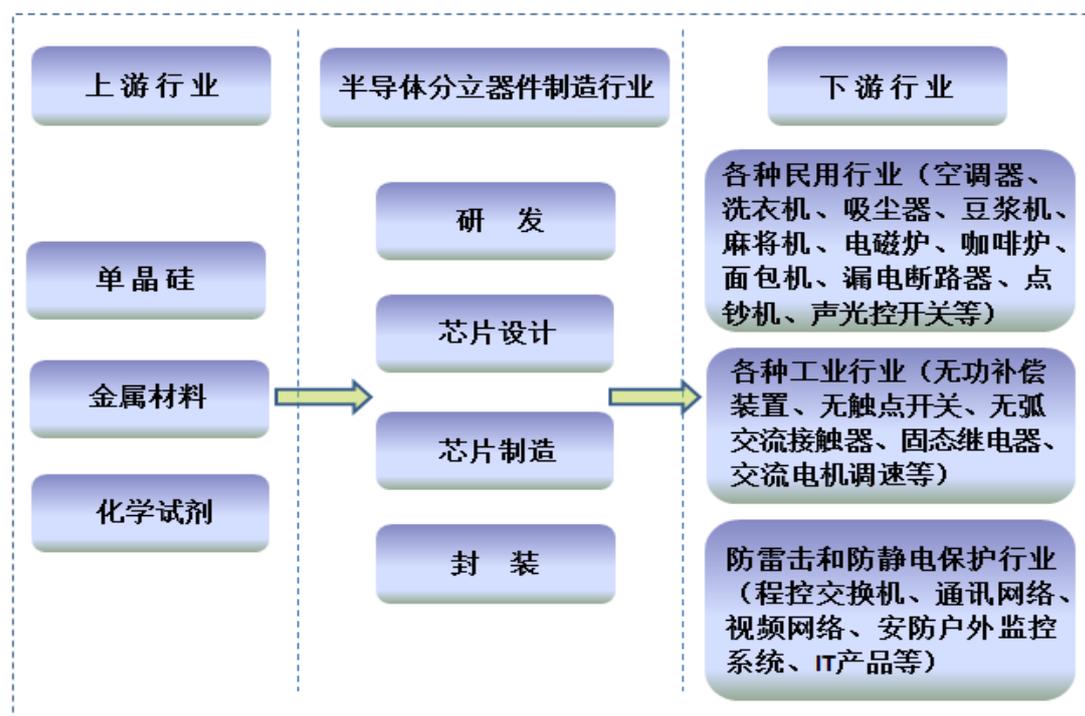
1、有利因素

（1）国家政策支持

功率半导体分立器件行业是我国重点鼓励和支持的产业之一，为推动节能降耗，促进电力电子技术和产业的发展，国家发改委等有关部门陆续出台资金补贴计划，支持新型电力电子器件产业化。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出依托于国家重点工程发展重大技术装备政策，将基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平放在了重点关注和发展的位置，未来国家产业政策的支持将会不断推动功率半导体分立器件行业的技术进步，形成先进技术的自有知识产权，优化国产功率半导体分立器件的产品结构。

（2）上游行业供给稳定，下游行业市场需求持续增长

发行人所处半导体分立器件制造业的上游行业主要为单晶硅、金属材料、化学试剂行业，下游行业主要为家用电器、漏电断路器等民用领域，无功补偿装置、电力模块等工业领域，及通讯网络、IT 产品等的防雷击和防静电保护领域。由于电力电子技术的广泛渗透性，在绝大多数的用电场合，都可能应用电力电子技术进行电能控制和优化。



①上游行业的简要情况

上游行业单晶硅的价格对半导体分立器件制造行业的生产成本有直接影响。目前国际和国内 3 英寸—6 英寸单晶硅片市场趋于饱和，供需基本平衡；框架等金属材料和硼源等化学试剂的市场供应充足，价格比较稳定。

②下游行业的简要情况

功率半导体分立器件的下游行业分布面极为广阔，终端产品的更新换代及科技进步引导的新产品面世，都为功率半导体分立器件带来不断增长的市场空间。功率半导体分立器件是连接弱电和强电的桥梁，无处不在，为了合理高效地利用电能，现在发达国家电能的 75% 需要经过功率半导体分立器件变换或控制后使用。目前我国经过变换或控制后使用的电能仅占 30%，70% 电能仍采用传统的传输方式，远远达不到应用电力电子技术才能实现的效果。随着我国在民用和工业各个领域对能源节约政策的深入落实，新技术、新工艺、新产品将陆续被研发和推广应用，满足市场需求的扩展和转变。

(3) 替换进口产品的市场机遇

瑞萨、意法、安森美、恩智浦等国际一流半导体制造企业是我国功率半导体

分立器件市场的主要占有者，其产品稳定性好，但价格较高。晶闸管作为我国技术成熟的功率半导体分立器件，行业内优秀企业的产品和技术已经达到国际一流半导体公司的水平，具备大面积替代国际同类产品的条件。

另外，由于功率半导体分立器件在实现电能高效利用、节能降耗、建设资源节约型社会方面发挥着不可替代的作用，未来，随着国内企业逐步突破行业内高端产品的核心技术，我国功率半导体分立器件对进口的依赖将会减弱，替代进口的市场机遇也会越来越多。

(4) 国民经济增长为行业奠定盈利基础

功率半导体分立器件是国民经济中各行业发展的基础元器件，其技术进步和应用领域的拓宽既能够促进工业的产业结构升级，也为居民生活带来更多便利和舒适。我国经济总水平稳步上升，产业结构调整有序开展，居民对生活质量的要求也越来越高，为行业创造了巨大的盈利空间。行业内优秀企业依托自主创新能力提高产品附加值，在国民经济持续发展这一稳固的基础上不断提升盈利水平。

2、不利因素

国内功率半导体分立器件市场长期被欧、美、日系大型半导体公司所垄断，由于国外半导体公司对其掌握的先进技术实行严格的技术封锁，本土企业很难直接从大型半导体公司学习先进技术，必须依靠自主研发实现技术突破，在一定程度上延缓了我国功率半导体分立器件的发展速度。

三、发行人销售及采购业务的具体情况

(一) 发行人销售业务的具体情况

1、报告期内发行人主要产品产能、产量、销量情况

报告期内，发行人的产量、产量及产销率情况如下：

产品	项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
芯片	年产能(万片)	35.00	56.00	56.00	54.00
	产量(万片)	33.01	50.58	50.64	54.80
	器件生产耗用量	11.35	20.40	18.00	16.51

	(万片)				
	销量(万片)	20.02	31.58	31.48	32.38
	销售收入(万元)	3,974.40	6,470.66	6,886.72	7,530.74
	产能利用率(%)	94.31%	90.32%	90.43%	101.48%
	产销率(%)	92.43%	104.65%	96.43%	84.56%
器件	年产能(亿只)	2.10	3.36	3.36	2.2
	产量(亿只)	1.75	3.17	2.52	2.28
	销量(亿只)	1.68	3.15	2.55	2.27
	销售收入(万元)	6,743.90	12,918.94	10,235.22	9,446.29
	产能利用率(%)	83.33%	94.35%	75.00%	103.64%
	产销率(%)	96.00%	99.27%	101.37%	99.37%

注：发行人现有的产能为 2011 年下半年投产使用的 70 万片 4 英寸芯片及其配套 4.2 亿只自封装器件项目，2013 年的产能约为设计产能的 80%，随着发行人后续投入，预计 2014 年将达到设计产能，2014 年 1-6 月产能为设计产能的 1/2。

2、发行人主要产品的销售收入

报告期内，公司按照产品构造分类的销售收入情况如下：

单位：万元

类别		功率半导体芯片	功率半导体器件	其他	合计
2014 年 1-6 月	收入	3,974.40	6,743.90	3.97	10,722.27
	比例	37.07%	62.90%	0.04%	100.00%
2013 年度	收入	6,470.66	12,930.53	52.58	19,453.78
	比例	33.26%	66.47%	0.27%	100.00%
2012 年度	收入	6,932.49	10,295.29	21.96	17,249.74
	比例	40.19%	59.68%	0.13%	100.00%
2011 年度	收入	7,530.74	9,462.44	38.56	17,031.74
	比例	44.22%	55.56%	0.23%	100.00%

报告期内，发行人按照产品类别分类的销售收入情况如下：

单位：万元

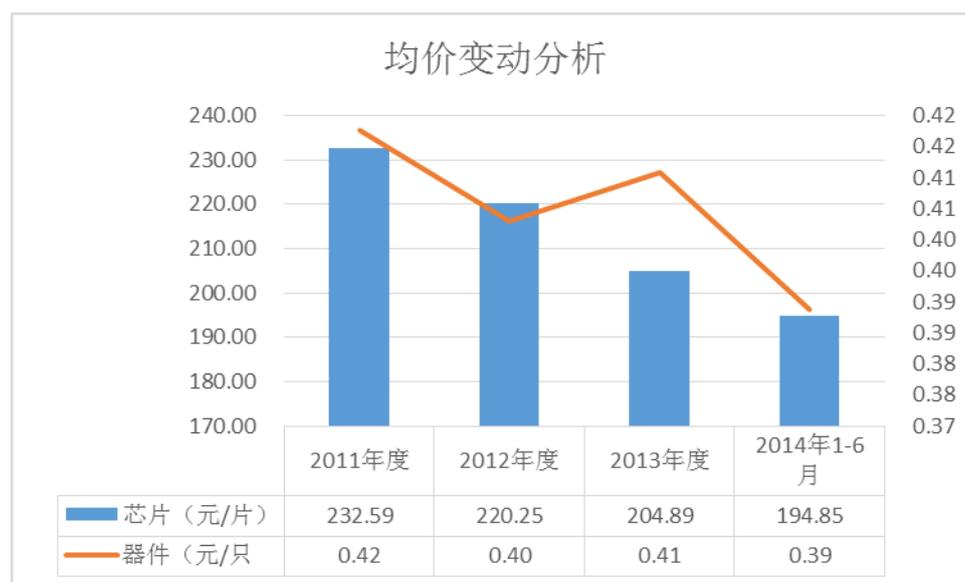
项目	晶闸管系列		防护器件系列		其他		合计
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	
2014年1-6月	8,446.81	78.78%	1,990.31	18.56%	285.15	2.66%	10,722.27
2013年度	16,986.79	87.32%	2,172.90	11.17%	294.09	1.51%	19,453.78
2012年度	15,696.16	90.99%	1,063.76	6.17%	489.82	2.84%	17,249.74
2011年度	15,448.17	90.70%	618.02	3.63%	965.55	5.67%	17,031.74

3、发行人产品的主要消费群体

公司生产的功率半导体分立器件在工业生产和居民生活用电过程中发挥电能高效转换和控制的作用，确保各行各业用电的安全性、稳定性、可靠性、一致性，其先进的技术有效地降低电能转换过程中的损耗程度，优化了我国工业产业能源耗用状况，并为居民生活提供了更加经济、舒适的生活方式。公司下游客户群体分布广泛，主要来自于家用电器、漏电断路器等民用领域，无功补偿装置、电力模块等工业领域，及通讯网络、IT产品等的防雷击和防静电保护领域。

4、发行人产品价格的变动情况

报告期内，发行人产品平均单价变动情况如下：



5、直销及经销规模及占比

单位：万元

销售方式	2014年1-6月		2013年度		2012年度		2011年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
经销	2,680.78	25.00%	4,988.89	25.64%	4,634.78	26.87%	3,151.27	18.50%
直销	8,041.49	75.00%	14,464.89	74.36%	12,614.97	73.13%	13,880.46	81.50%
合计	10,722.27	100.00%	19,453.78	100.00%	17,249.74	100.00%	17,031.74	100.00%

6、报告期内发行人对主要客户的销售情况

2011年、2012年、2013年和2014年1-6月，发行人对前五名客户的销售额占当期营业收入的比例分别为27.46%、29.85%、23.76%和23.55%。报告期内，发行人前五名客户中的新增客户的基本情况如下：

2012年前五大客户中的新增客户为杭州腾雁电子有限公司、深圳市滨城电子有限公司，对其销售金额占当年营业收入的比例分别为5.44%和3.25%；2013年前五大客户中的新增客户为深圳市国王科技有限公司、成都永铭科技有限公司，对其销售金额占当年营业收入的比例分别为4.18%和3.14%；2014年1-6月前五大客户中的新增客户为浙江正泰电器股份有限公司，对其销售金额占当年营业收入的比例分别为5.22%。

报告期内，发行人不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情形。报告期内前五大客户与发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、股东及其他核心人员之间均不存在关联关系。

（二）发行人采购业务的具体情况

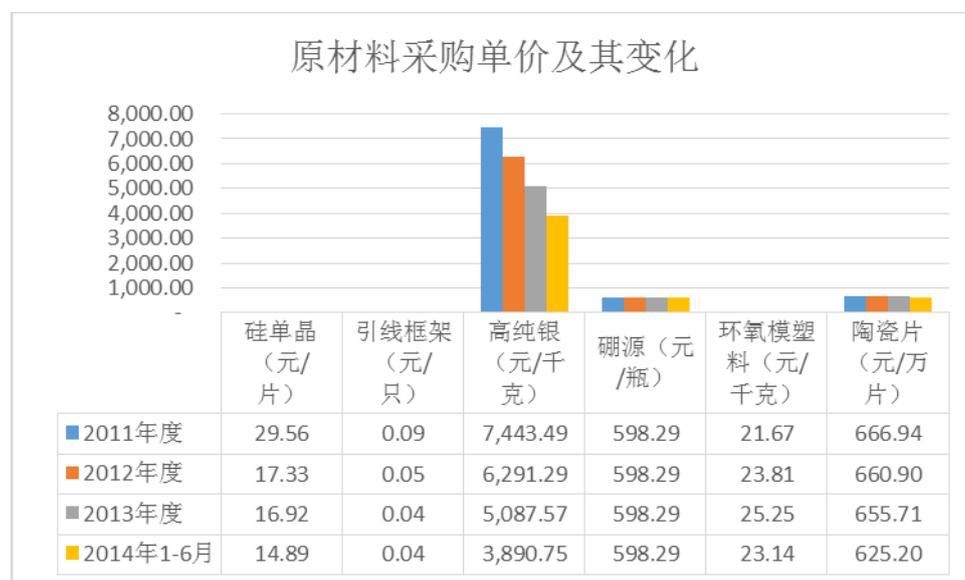
1、主要产品的原材料和能源供应情况及价格变动趋势

（1）发行人主要原材料供应及价格变动情况

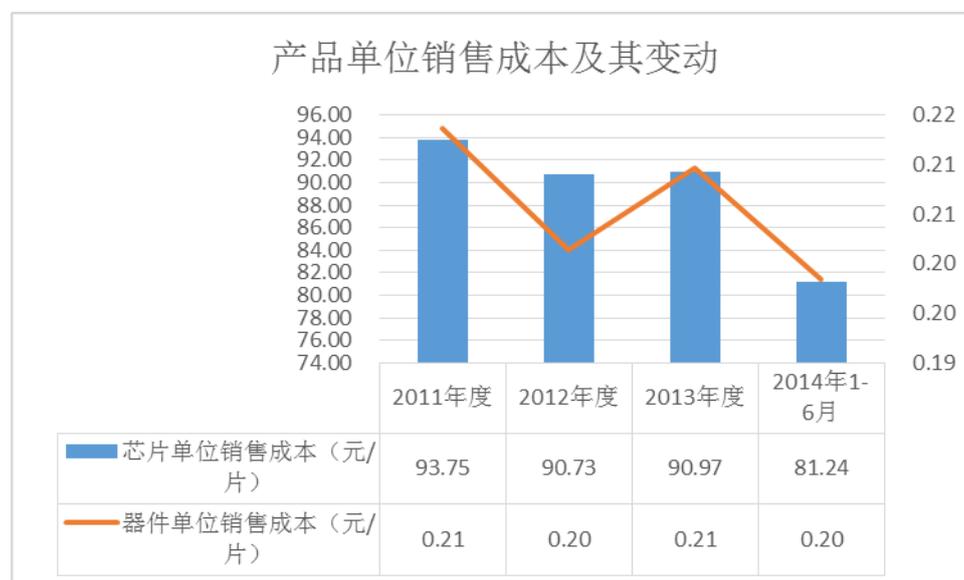
发行人主要原材料为单晶硅、金属材料和化学试剂等。发行人建立了完善的采购制度，与供应商形成长期合作关系，确保原材料采购渠道稳定，供应及时，质量可靠。

报告期内，发行人的主要原材料包括硅单晶、引线框架、高纯银、硼源、环

氧模塑料、陶瓷片，其占发行人总采购的50%左右，报告期内主要原材料采购均价及变化如下：



报告期内，硼源、环氧模塑料、陶瓷片单价变动较小，硅单晶和引线框架价格下降幅度较为明显。发行人的主要原材料占采购总额的60%左右，在产量稳定的情况下，主要材料采购价格下降将形成公司的单位销售成本下降。报告期内，发行人产品单位成本变动情况如下：



2012年发行人单位销售成本明显下降，其后价格下降幅度收窄，与主要原材料的采购均价变化趋势相当。

(2) 主要能源供应及价格变动情况

报告期内，发行人主要耗用的能源为水和电，具体情况如下：

项目		2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
电	数量（万度）	574.78	1,105.19	935.11	882.78
	金额（万元）	392.84	760.11	657.03	596.19
	平均单价（元/度）	0.68	0.69	0.70	0.68
水	数量（万吨）	9.68	16.67	13.66	13.84
	金额（万元）	47.89	82.51	67.62	69.02
	平均单价（元/吨）	4.95	4.95	4.95	4.99

报告期内，水、电的均价及耗用量较为稳定，对发行人销售成本的影响较小。

2、报告期内发行人向主要供应商的采购情况

（1）报告期内发行人向前五大供应商采购的情况

报告期，发行人向前五名供应商的合计采购额占比分别为**56.87%**、**48.80%**、**47.63%**和**50.50%**。前五名供应商中新增的供应商情况如下：

2012年前五名供应商中新增的供应商为乐清市美开电气有限公司、宁波康强电子股份有限公司，对其采购金额占当年采购总金额的比例为**5.32%**、**5.09%**；2013年前五名供应商中新增的供应商为中国电子科技集团公司第四十六研究所，对其采购金额占当年采购总金额的比例为**10.79%**；2014年1-6月前五名供应商中无新增供应商。

报告期内，发行人不存在向单一供应商采购比例超过总额**50%**或严重依赖于少数供应商的情形。报告期内发行人前五大供应商与发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、股东及其他核心人员之间均不存在关联关系。

四、与发行人业务相关的主要固定资产及无形资产

（一）发行人主要固定资产

发行人主要固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等。截至**2014年6月30日**，发行人固定账面净值为**9,924.90**万元，具体情况如下：

单位：万元

项 目	资产原值	累计折旧	资产净值	成新率
房屋及建筑物	2,393.22	471.40	1,921.81	80.30%
机器设备	15,764.67	8,170.60	7,594.06	48.17%
运输工具	278.13	141.56	136.56	49.10%
办公设备及其他	584.15	311.69	272.46	46.64%
合 计	19,020.17	9,095.26	9,924.90	52.18%

成新率=固定资产账面净值/固定资产账面原值×100%

1、房屋及建筑物

(1) 发行人自有房产情况

发行人房产均为自建所得。截至本招股说明书签署日，发行人的房屋建筑物所有权情况如下：

产权证号	地址	建筑面积(m ²)	取得时间	权属
启东房权证字第00132073号	启东科技创业园兴龙路8号	18,345.00	2011年9月26日	捷捷微电
启东房权证字第00132074号	启东科技创业园兴龙路8号	7,111.00	2004年1月17日	捷捷微电

公司因买卖合同纠纷起诉深圳市大族激光科技股份有限公司，申请对大族激光的财产进行保全措施而将部分厂房房屋产权作为担保物抵押在法院。截止2014年6月30日，该部分固定资产账面价值为2,114,734.62元(原值3,728,779.39元)。

2、主要生产设备

发行人主要生产设备均从设备销售商或制造商处购买所得。截至2014年6月30日，发行人主要生产设备情况如下：

单位：万元

设备名称	数量	资产原值	取得方式	使用情况	成新率	权属
晶圆片制造净化系统成套装置（4号楼2层）	1套	1,268.13	购买	正在使用	72.71%	发行人
离子注入机 M533	1台	483.62	购买	正在使用	87.33%	发行人
离子注入机 M271	1台	402.31	购买	正在使用	82.58%	发行人
离子注入机 M390	1台	402.23	购买	正在使用	82.58%	发行人
超纯水制造系统	1套	423.30	购买	正在使用	72.29%	发行人
4号楼一层净化系统	1套	388.97	购买	正在使用	75.46%	发行人
离子注入机 M322	1台	256.29	购买	正在使用	87.33%	发行人
高纯气路系统	1套	136.82	购买	正在使用	72.71%	发行人
离子注入机	1台	125.77	购买	正在使用	71.50%	发行人
超声扫描显微镜	1台	95.11	购买	正在使用	90.50%	发行人
废水处理系统	1套	110.64	购买	正在使用	72.29%	发行人
高真空蒸发镀膜设备	3台	431.31	购买	正在使用	44.59%	发行人
ASM全自动铝线焊接机	2台	134.82	购买	正在使用	90.50%	发行人
背面研磨机	1台	98.29	购买	正在使用	62.00%	发行人
ASM全自动铝线焊接机	8台	528.16	购买	正在使用	90.50%	发行人
全自动铝线机	2台	137.14	购买	正在使用	84.17%	发行人
X射线检测机	1台	107.07	购买	正在使用	49.33%	发行人
TO-220FP 塑封模具	1台	56.41	购买	正在使用	88.92%	发行人

公司对生产设备进行常规维修保养，并根据经营发展战略和实际发展情况采取逐步添置生产设备及进行升级改造等措施保证公司生产的安全性、稳定性和连续性。在现有的经营环境下，公司的生产设备不存在周期性大修及周期性技术改造。

（二）发行人主要无形资产

发行人主要无形资产包括土地使用权、商标、专利、非专利技术，具体情况如下：

1、土地使用权

截至本招股说明书签署日，发行人拥有的土地使用权情况如下：

证书编号	地址	面积(m ²)	取得方式	取得时间	到期时间	用途	权属
启国用 2011 第 0402 号	启东科技创业 园兴龙路 8 号	18742.00	转让	2003 年 4 月 22 日	2052 年 12 月 20 日	工业 用地	捷捷 微电
启国用 2012 第 0080 号	启东近海盐场 滨海工业区	40000.00	购买	2012 年 3 月 7 日	2062 年 5 月 29 日	工业 用地	捷捷 微电

截至2014年6月30日，发行人土地使用权的账面原值为1,040.76万元，累计摊销71.32万元，账面净值969.44万元。

2、商标

截至本招股说明书签署日，发行人拥有的商标如下：

证书编号	商标	类别	取得方式	使用期限
5146082		第 9 类	自主申请	自 2009 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 20 日
9645446		第 9 类	自主申请	自 2012 年 7 月 28 日至 2022 年 7 月 27 日
9645440	捷捷	第 9 类	自主申请	自 2012 年 8 月 28 日至 2022 年 8 月 27 日

3、专利

截至本招股说明书签署日，发行人专利情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利保护期限	专利类型	取得方式
1	门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法	ZL200810122602.9	捷捷微电	自2008年6月16日至2028年6月15日	发明专利	自主申请
2	门极灵敏触发单向晶闸管芯片及其制造方法	ZL200910301954.5	捷捷微电	自2009年4月29日至2029年4月28日	发明专利	自主申请
3	一种低结电容过压保护晶闸管器件芯片的生产方法	ZL200910301945.6	捷捷微电	自2009年4月29日至2029年4月28日	发明专利	自主申请
4	内绝缘型塑封半导体器件及其	ZL201010211665.9	捷捷	自2010年6月28日	发明专利	自主

	制造方法		微电	至2030年6月27日	专利	申请
5	在半导体器件芯片玻璃钝化膜上划切的装置的使用方法	ZL201110210416.2	捷捷 微电	自2011年7月26日 至2031年7月25日	发明 专利	自主 申请
6	一种可控硅芯片与木片的烧结磨具及其使用方法	ZL201110186119.9	捷捷 微电	自2011年7月5日 至2031年7月4日	发明 专利	自主 申请
7	一种金属与塑料混合封装的可控硅封装结构及其封装方法	ZL201110185306.5	捷捷 微电	自2011年7月4日 至2031年7月3日	发明 专利	自主 申请
8	一种降低对通隔离扩散横向扩散宽度的结构及方法	ZL201110213223.2	捷捷 微电	自2011年7月28日 至2031年7月27日	发明 专利	自主 申请
9	台面工艺功率晶体管芯片结构和实施方法	ZL201110213277.9	捷捷 微电	自2011年7月28日 至2031年7月27日	发明 专利	自主 申请
10	台面工艺可控硅芯片结构和实施方法	ZL201110213225.1	捷捷 微电	自2011年7月28日 至2031年7月27日	发明 专利	自主 申请
11	一种大尺寸硅芯片采用塑料实体封装的可控硅及其封装方法	ZL201110186169.7	捷捷 微电	自2011年7月5日 至2031年7月4日	发明 专利	自主 申请
12	内绝缘型塑封半导体器件	ZL201020240792.7	捷捷 微电	自2010年6月28日 至2020年6月27日	实用新 型专利	自主 申请
13	台面工艺可控硅芯片结构	ZL201120270383.6	捷捷 微电	自2011年7月28日 至2021年7月27日	实用新 型专利	自主 申请
14	台面工艺功率晶体管芯片结构	ZL201120270384.0	捷捷 微电	自2011年7月28日 至2021年7月27日	实用新 型专利	自主 申请
15	一种大尺寸硅芯片采用塑料实体封装的可控硅	ZL201120233834.9	捷捷 微电	自2011年7月5日 至2021年7月4日	实用新 型专利	自主 申请
16	一种大功率半导体器件	ZL201120233780.6	捷捷 微电	自2011年7月5日 至2021年7月4日	实用新 型专利	自主 申请
17	一种单向晶闸芯片的门极结构	ZL201120233893.6	捷捷 微电	自2011年7月5日 至2021年7月4日	实用新 型专利	自主 申请
18	一种高粘度光刻胶无胶丝匀胶装置	ZL201120232561.6	捷捷 微电	自2011年7月4日 至2021年7月3日	实用新 型专利	自主 申请

19	一种提高双台面可控硅产品可靠性的封装结构	ZL201120233779.3	捷捷 微电	自2011年7月5日 至2021年7月4日	实用新 型专利	自主 申请
----	----------------------	------------------	----------	--------------------------	------------	----------

上述专利目前的法律状态均为有效。发行人专利技术为公司自主知识产权，应用于功率半导体芯片和封装器件的多道生产工艺中，降低原材料的损耗率，提高生产效率，保证各批次产品性能优良、一致、稳定，从降低生产成本、提升产品质量、增强品牌知名度、把握定价话语权等多方面保证公司持续盈利能力。

五、发行人拥有的特许经营权

截至本招股说明书签署日，发行人未拥有特许经营权。

六、发行人核心技术情况

发行人是国家高新技术企业和江苏省创新型企业。截至本招股说明书签署日，发行人拥有 19 项专利，其中发明专利 11 项，实用新型专利 8 项。发行人 2008 年获省财政厅、经贸委及发改委的自主创新和产业升级专项引导资金支持，2010 年获国家发改委和工信部的电子信息产业振兴和技术改造项目中央预算内资金投资支持，2011 年被评选为江苏省民营科技企业，2012 年被中国电器工业协会评选为中国电器工业最具影响力品牌。发行人“新型门极灵敏触发单向可控硅芯片”、“新型半导体高压器件芯片”、“JST16A-800 型内绝缘型塑封半导体器件”、“低结电容过压保护晶闸管器件芯片”、“具有高换向能力和高结温的双向晶闸管”、“Super247 外形的晶闸管器件”、“内引线采用 CLIP 结构的晶闸管器件”、“门极灵敏触发单向晶闸管”、“边门极结构的高压大电流单向晶闸管器件芯片”、“新型台面工艺功率晶体管芯片”、“TG-C 型可控硅模块”、“台面工艺结构可控硅芯片”、“新型门极灵敏触发单向晶闸管芯片”、“门极灵敏触发单向可控硅器件”、“新型双台面结构晶闸管芯片”、“具有 150℃ 高结温性能双向晶闸管芯片”、“TO-220A、TO-P3 型内绝缘塑封晶闸管器件”先后被江苏省科技厅认定为高新技术产品。发行人产品符合 UL 电气绝缘性要求、ROHS 环保要求、REACH 化学品注册、评估、许可和限制要求、无卤化要求等。

（一）发行人拥有的主要技术

公司目前拥有的核心技术全部为与功率半导体芯片和封装器件相关的技术，具体情况如下表：

序号	主要技术名称	技术来源	创新方式
1	门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法	自主开发	集成创新
2	门极灵敏触发单向晶闸管芯片及其制造方法	自主开发	集成创新
3	内绝缘型塑封半导体器件	自主开发	集成创新
4	一种低结电容过压保护晶闸管器件芯片的生产方法	自主开发	集成创新
5	内绝缘型塑封半导体器件及其制造方法	自主开发	集成创新
6	一种金属与塑料混合封装的可控硅封装结构	自主开发	集成创新
7	一种可控硅芯片与钼片的烧结模具	自主开发	集成创新
8	一种提高双台面可控硅产品可靠性的封装结构	自主开发	集成创新
9	一种大尺寸硅芯片采用塑料实体封装的可控硅	自主开发	集成创新
10	台面工艺功率晶体管芯片结构	自主开发	集成创新
11	台面工艺可控硅芯片结构	自主开发	集成创新
12	一种降低对通隔离扩散横向扩散宽度的结构	自主开发	集成创新
13	一种单向晶闸芯片的门极结构	自主开发	集成创新
14	一种高粘度光刻胶无胶丝匀胶装置	自主开发	集成创新
15	一种大功率半导体器件	自主开发	集成创新
16	半导体高压器件芯片及其制造方法	自主开发	集成创新
17	一种金属与塑料混合封装的可控硅封装结构及其方法	自主开发	集成创新
18	一种大功率半导体器件及其封装方法	自主开发	集成创新
19	一种可控硅芯片与钼片的烧结模具及其使用方法	自主开发	集成创新
20	一种检测铜丝球焊质量的工艺方法	自主开发	集成创新
21	一种大尺寸硅芯片采用塑料实体封装的可控硅及其封装工艺	自主开发	集成创新
22	在半导体器件芯片玻璃钝化膜上划切的装置及其使用方法	自主开发	集成创新
23	台面工艺功率晶体管芯片结构和实施方法	自主开发	集成创新
24	一种降低对通隔离扩散横向扩散宽度的结构及方法	自主开发	集成创新
25	三象限双向可控硅的设计和制造技术	自主开发	集成创新

26	“硼”对通隔离扩散的深度控制技术	自主开发	集成创新
27	芯片背面多层金属电极工艺技术	自主开发	集成创新
28	漏电断路器用灵敏触发晶闸管芯片设计和制造技术	自主开发	集成创新
29	平面钝化工艺技术	自主开发	集成创新
30	硅片双面化学抛光工艺技术	自主开发	集成创新
31	用于无功补偿的单向晶闸管芯片的设计和制造技术	自主开发	集成创新
32	封装过程的芯片焊接无空洞技术	自主开发	集成创新
33	T0-220FP 型塑封产品的封装技术	自主开发	集成创新
34	降低 T0-3P 封装可控硅产品电压早期失效率的工艺技术	自主开发	集成创新
35	6.0-8.0V 瞬态电压抑制二极管的设计和制造技术	自主开发	集成创新
36	1A/2400V 高压整流二极管的设计和制造技术	自主开发	集成创新
37	离子注入法实现铝深结扩散的工艺技术	自主开发	集成创新
38	TVS 芯片的设计和制造技术	自主开发	集成创新

（二）报告期内发行人主营产品占营业收入的比重

发行人专注于功率半导体分立器件技术和生产工艺的研发，上述核心技术包括公司的专利技术和非专利技术，全部应用于功率半导体芯片和器件的生产制造，针对不同产品规格和客户要求，调整生产工艺，设计功率器件的功能，最终达到在工业生产和居民生活用电中稳定、可靠地控制和转换电能及保护电子产品电路的目的。发行人主营产品为功率半导体芯片和器件，在报告期内，发行人主营产品收入占营业收入的比例情况如下表：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
功率半导体芯片营业收入	3,974.40	6,470.66	6,932.49	7,530.74
功率半导体分立器件营业收入	6,743.90	12,930.53	10,295.29	9,462.44
核心技术产品收入合计	10,718.30	19,401.19	17,227.78	16,993.17
营业收入	10,722.27	19,453.78	17,249.74	17,031.74
占营业收入比例	99.96%	99.73%	99.87%	99.77%

（三）报告期内发行人研发费用的构成

功率半导体分立器件的芯片技术是企业的核心竞争力，只有加强芯片技术的研发和设计制造能力，公司才具有快速发展的基础。发行人一直重视自主研发，报告期内，发行人研发投入分别为 873.49 万元、808.86 万元、918.62 万元和 541.03 万元，占营业收入的比例分别为 5.13%、4.69%、4.72%和 5.05%，研发费用的具体构成如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年
1、内部研究开发投入额	517.03	918.62	808.86	873.49
其中：人员人工	257.85	464.68	378.31	289.83
直接投入	152.33	256.96	223.40	316.55
折旧费和长期摊销费用摊销	97.86	178.90	186.72	213.89
检测费	1.97	2.91	1.91	3.46
仪器设备检测维护费	0.42	-	-	-
无形资产摊销	1.50	-	-	-
其他费用	5.10	15.16	18.52	49.76
2、委托外部研究开发投入额	24.00	-	-	
研究开发投入额合计	541.03	918.62	808.86	873.49

2014 年 3 月 14 日，发行人与西安电子科技大学签订了《技术开发（委托）合同》，发行人委托西安电子科技大学研究开发高压大容量 2500V/10A SiC 肖特基二极管制造技术研发项目。根据该《技术开发（委托）合同》，发行人享有申请该项技术专利的权利；专利权取得后，专利权人为捷捷微电，专利的使用权归捷捷微电所有。

发行人和西安电子科技大学就该合同在签约、履约过程中知悉的技术参数和经营数据等信息设定了保密措施，涉密人员范围包括双方组织内部所有了解或知悉保密内容的在职和离职人员，保密期限为合同签订后 10 年。

（四）发行人核心技术人员、研发人员的情况

1、发行人研发团队情况

截至2014年6月30日,发行人拥有研发人员68人,占员工总数的14.47%,其中核心技术人员为黄善兵、王成森、沈卫群、黎重林、薛治祥、颜呈祥六人,占发行人员工总数的1.28%。发行人核心技术人员取得的专业资质及重要科研成果和获得奖项的情况参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”。发行人主要技术人员与公司签订了《保密协议》和《竞业禁止协议》,保证公司技术秘密的安全性。核心技术人员和部分优秀技术人员持有公司股份,与公司利益保持一致,最近两年,发行人技术团队稳定,核心技术人员没有发生变化。

七、发行人在境外生产经营及资产情况

发行人未在境外从事生产经营活动,也未拥有境外资产。

八、发行人当年和未来三年的发展规划及拟采取的措施

(一) 公司未来三年发展目标

发行人明确定位于功率半导体分立器件设计和制造行业,目前和未来三年,在塑封晶闸管器件和芯片以及半导体防护器件两个细分领域内成为我国行业内的领先企业,建立高端客户群,实现民族品牌国际化,在我国功率半导体分立器件市场上进一步替代进口同类产品,并以此为突破,打开国际市场的销售空间,优化公司盈利结构,提升公司盈利能力。

(二) 公司的发展规划及所采取的措施

公司未来三年将紧紧围绕上述发展目标,专致于功率半导体分立器件领域,走专业化的发展路线,从技术创新、市场开拓、品牌建设、生产水平、人才引进五个大方面,全面提升公司的综合竞争力和市场影响力,实现科技化发展的模式,打造可持续技术研发体系,在此基础上,优化客户结构,加强品牌影响力,做精做细生产环节,吸收引进高端人才,实现科技化发展的模式。

1、提升技术创新能力的措施

功率半导体分立器件的技术具有无限精细化和拓展性的发展空间，针对公司现有成熟产品，公司仍将进一步精细化工艺技术，在工业生产、居民生活的用电中最大程度地减少电能的损耗，促进工业产业结构升级，节能降耗。

在深化现有产品技术的同时，公司推行技术领先战略，立足于公司目前的功率半导体分立器件技术及产品，以市场需求为准则，不断研发、生产市场需要的产品，积极创造条件涉足新的产品领域，因此，公司计划构建高端技术研发平台，加强自主创新能力建设，建立一条超快恢复功率二极管研发试验线、一条功率 MOSFET、IGBT 研发试验线、一个碳化硅器件研发试验线及一个产品性能检测和试验站，推动公司功率半导体分立器件产品和技术向更加新型化、全面化的方向发展。

2、市场开拓的措施

(1) 拓宽中高端客户群的规划

在功率半导体分立器件市场上，产品和品牌的客户认可度是扩大产品辐射面的首要营销要素。公司将不断优化客户结构，拓宽中高端客户群，与主要应用领域的知名企业建立销售关系，通过具有影响力的客户采购带动公司市场份额的提升。

现阶段，国内外知名企业陆续对公司开展产品、技术等方面的考核，公司将通过加强技术领域的沟通和服务，提升潜在优质客户对公司产品的信任度和满意度，确立公司领先的市场地位。

(2) 扩大公司市场占有率的规划

通过长期的技术积累和持续的技术创新，公司产品性能已经达到国外大型半导体公司同类产品的水平，具备大面积替代进口产品的技术实力。公司将在优化客户结构的基础上，增强客户的信任度，延伸现有市场份额至国际同类产品在我国的市场空间，并通过打开国际大客户的销售渠道逐步将产品销售到海外，实现“替代进口—走向国际市场”的市场扩张目标。

3、品牌建设的措施

公司品牌是宝贵的无形资产，是促进销售的有力保证。公司将通过向市场和客户充分展示产品的技术质量优势的方式，以对用户负责的态度，从生产、检验、售后服务等各个环节强化质量第一的意识，促使客户信任公司的产品，销售团队加强与客户间的产品质量信息的协调和沟通，公司研发、质量控制部门协助销售部门提供技术支持，并发挥网络资源的便利优势，做好公司网上信息系统的建设工作，系统全面地展示公司产品，列示所有产品的规格书，方便客户随时了解公司任何产品。

在进一步扎实品牌推广工作的基础上，公司扩展高端客户群，提高向下游知名企业的销售份额，取代进口产品，获得更多客户对公司技术、产品的认可，增强公司的品牌影响力，突出公司的品牌形象。

4、提升公司产品制造能力的措施

生产设备和生产人员是保证发行人产品制造能力的两大要素，产品性能指标的提升不仅需要技术研发与创新作为保证，也要求配备先进的生产设备，从而配合生产工艺的调整和进步，公司未来在将会根据技术研发创新的进展和需求，引进与之匹配的先进设备，确保技术成果及时、顺利地应用到生产环节，转化为公司盈利新的增长点。

功率半导体分立器件芯片和封装成品的制造流程长，工序多，产品的质量取决于各个环节的操作质量。随着先进设备的引进和使用，未来公司将着重培训生产员工的技术水平和操作技能，提升员工整体素质，熟练使用新型机器设备，保证每道生产环节精细加工、规范操作，确保公司产品制造能力的全方位提升。

5、引进高端人才的措施

公司的技术团队是保持公司技术创新能力的核心资源，公司将继续吸收和培养半导体分立器件领域的科技人才，提高公司核心技术团队的活力和创新能力，从而增强公司核心竞争力。同时，公司将引进、培养管理、市场等多方面的人才，满足公司规模逐步扩大的人才需求；建立合理的激励机制吸引人才、提升人才素质，确保公司的人才储备与公司的技术研发投入、产能扩充相配套，保证公司长期稳定的发展。

（三）发展规划所依据的假设条件

上述业务发展计划是依据国家当前功率半导体分立器件的产业政策、本公司现有的业务发展条件、市场地位和竞争优势为基础所制定的：

- 1、国家的政策导向不会发生重大不利变化；
- 2、国家整体经济环境不会发生重大不利变化；
- 3、半导体分立器件制造行业处于正常发展状态，不会出现重大不利市场变化；
- 4、本次股票发行与上市工作进展顺利，募集资金及时到位。

（四）发展规划实施过程中可能面临的主要困难和拟采取的措施

1、资金困难

公司技术研发的周期很长，从技术、产品的调研、方案制定、设计、工艺开发到试验、购买设备、试生产、客户认定、改造生产环境、人才培养、正式生产的过程中，需要大量的资金投入，如果相应的资金不到位，将在一定程度上制约公司技术创新的效率。

公司在依靠自身盈利积累的同时，努力拓宽融资渠道，本次公开发行股票融资将为公司实现技术创新、技术成果产业化的目标提供资金支持，有助于公司提升核心竞争力。

2、管理风险

公司市场份额快速提升，随着下游知名企业和大型企业与公司的订单增多，未来业务量将会明显加大。另外，高素质人才的引进、公司规模的扩大等方面都要求管理能力的匹配。

公司将严格按照上市公司的要求规范运作，进一步加强公司治理、风险管理和财务管理的能力。

（五）发展计划与现有业务的关系

公司上述发展规划全部围绕功率半导体分立器件研发、设计、生产和销售

这一中心目标而制定，以发展持续的技术创新能力为核心，拓宽市场优质客户群为重点，配合生产能力的提升、高层次人才团队的建设和募集资金的到位，延伸和深化公司现有业务，提升盈利能力，建立现代化企业制度，提高公司综合竞争实力。

（六）持续公告规划实施和目标实现的计划

在本次发行并在创业板上市后，公司将通过定期报告公告发展规划的实施情况。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

(一) 发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

1、发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业

发行人控股股东捷捷投资主要从事投资项目管理。捷捷投资自成立以来，除持有捷捷微电 42.87%的股权外，不存在其他经营活动。

发行人实际控制人为黄善兵先生，截至本招股说明书签署日，黄善兵先生除控制发行人之外，控制的其他企业的主营业务情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	担任职务	主营业务
江苏捷捷投资有限公司	1,000	董事长	投资项目管理，企业项目策划，财务管理，机械设备租赁
南通蓉俊投资管理有限公司	100	—	投资管理咨询，经济信息咨询
上海虹菊电子有限公司	200	—	金属材料、五金交电、橡塑制品、装潢材料、日用百货批发兼零售；计算机软硬件及相关产品的销售、维修、通讯设备的销售和维修。

此外，报告期内，曾受黄善兵控制的企业中导电子（已注销）、明昊电子（已注销）和金环工贸（已转让）的基本情况参见“第五节 发行人基本情况”之“五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”。

2、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或潜在同业竞争

发行人主营半导体分立器件、电力电子元器件制造、销售。

捷捷投资主营业务范围为投资项目管理，捷捷投资自成立以来除持有捷捷微电 42.87%的股权外，不存在其他经营活动。

蓉俊投资主营业务范围为投资管理咨询，经济信息咨询，蓉俊投资自成立以来除持有捷捷微电 3.43%的股权外，不存在其他经营活动。

上海虹菊主营业务范围为金属材料、五金交电、橡塑制品、装潢材料、日用百货批发兼零售；计算机软硬件及相关产品的销售、维修、通讯设备的销售和维修。上海虹菊已长期处于歇业状态，不存在与发行人经营相同或类似的产品及服务。

中导电子成立于 2010 年 5 月 18 日，于 2011 年 4 月 13 日完成工商注销。从成立至注销不足一年，且存续期内未开展经营活动。

明昊电子成立于 2005 年 4 月 8 日，2010 年 11 月前为发行人合并范围内的子公司，与发行人不构成同业竞争或潜在同业竞争。2010 年 11 月后，由于发行人已经购买了明昊电子的经营性资产并整合其业务和人员，明昊电子已不具备从事生产经营能力，至 2011 年 8 月 4 日完成注销。

金环工贸于 2013 年 8 月由黄善兵、张祖蕾将其持有的出资全部转让，转让前金环工贸主营业务范围为玩具加工、制造、销售，不存在与发行人经营相同或类似的产品及服务。

综上所述，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或潜在同业竞争。

（二）发行人控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

发行人控股股东捷捷投资、实际控制人黄善兵先生做出的关于避免同业竞争的承诺如下：

捷捷投资承诺：“本公司目前未对外投资与公司主营业务相同或构成竞争关系的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；

在今后的任何时间，本公司不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构

成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用控股股东地位促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行；

本公司愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任，且若本公司违反上述承诺，本公司自愿在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起 5 个工作日内，停止在公司处分红，同时本公司持有的公司股份将不得转让，若转让的，则转让所得归公司所有，直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时为；

上述承诺长期有效，除非本公司不再为公司的股东。”

黄善兵先生承诺：“本人目前未对外投资与公司主营业务相同或构成竞争关系的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；

在今后的任何时间，本人及本人关系密切的家庭成员不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用实际控制人地位促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行；

本人愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任，且若本人违反上述承诺，本人自愿在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，若转让的，则转让所得归公司所有，直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时为止；

上述承诺长期有效，除非本人不再为公司的实际控制人和股东且不继续在捷捷微电任职。”

二、关联方及关联关系

按照《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的相关规定，发行人目前的关联方和关联关系如下：

（一）控股股东、实际控制人和持有发行人 5%以上股份的股东

股东名称	持股比例	与本公司关系
捷捷投资	42.87%	控股股东
黄善兵	13.72%	实际控制人，董事长兼总经理
中创投资	9.71%	主要股东
王成森	6.86%	主要股东，董事、副总经理、工程技术研究中心主任
张祖蕾	5.71%	主要股东，副总经理
正和世通	5.71%	主要股东

（二）发行人及其控股股东董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

1、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

发行人董事、监事、高级管理人员详细情况参见“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。与持有发行人5%以上股份的自然人的、发行人董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员中黄健、张家铨在发行人处任职情况见下表；黄健、李燕、张家铨间接持有发行人股份情况参见“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“二、公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属间接持有本公司股份情况”。除此以外，与持有发行人5%以上股份的自然人的、发行人董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员均未在发行人处任职或持有公司股份。

黄健、张家铨在发行人任职情况如下：

姓名	在发行人处任职	关联关系
----	---------	------

黄健	人力资源部部长、芯片制造部部长	黄善兵之子
张家铨	证券投资部部长、证券事务代表	张祖蕾与沈卫群之子

2、在发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业中任董事、监事、高级管理人员的其他人员

姓名	任职单位	职务	其他关系
张玉红	江苏捷捷投资有限公司	监事	张祖蕾之妹妹
李忠平	南通蓉俊投资管理有限公司	监事	张玉平之配偶
黄萍	江苏捷捷投资有限公司	董事	黄善兵之妹妹
黄红菊	上海虹菊电子有限公司	执行董事、总经理	黄善兵之妹妹
陈乐权	上海虹菊电子有限公司	监事	黄红菊之配偶的父亲

上述人员均未在发行人处任职或持有公司股份。

(三) 关联自然人控制或有重大影响的其他企业

截止到本招股说明书签署日，关联自然人控制或有重大影响的其他企业如下：

单位：万元

姓名	企业名称	注册资本	持股比例	任职情况
盛波	南通红土创新资本创业投资有限公司	12,000.00	-	董事总经理
	深圳市创新投资集团有限公司	351,087.46	-	高级投资经理
黄健	南通蓉俊投资管理有限公司	100.00	99%	-
李燕			1%	执行董事、总经理
黄红菊	上海虹菊电子有限公司	200.00	80%	执行董事、总经理
陈乐权			20%	监事

此外，报告期内，曾受黄善兵控制的企业中导电子（已注销）、明昊电子（已注销）和金环工贸（已转让）的情况参见“第五节 发行人基本情况”之“五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”。

三、关联交易

（一）报告期内发行人经常性关联交易

报告期内，发行人不存在经常性关联交易。

（二）报告期内偶发性关联交易

报告期内关联方为发行人提供担保，具体情况如下：

担保人	内容	担保方式	担保主债权金额	担保主债权期限
黄善兵、李华	最高额个人连带责任保证	保证担保	1500万元授信额度（借款金额500万元）	2010.2.3-2011.2.2
黄善兵、李华	个人连带责任保证	保证担保	3000万元	2010.11.9-2011.11.8
张祖蕾、沈卫群				
张祖蕾、沈卫群	个人连带责任保证	保证担保	1000万元	2011.3.2-2011.11.7

除上述情况外，报告期内发行人不存在其他偶发性关联交易。

（三）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内捷捷微电与关联方之间的关联交易发生在捷捷微电整体变更为股份公司之前，整体变更为股份公司之后，捷捷微电与关联方未发生关联交易，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

四、关于规范关联交易的制度安排

公司在《公司章程》和《关联交易管理办法》中对关联交易的回避制度、关联交易的原则、关联交易的决策权限做出了严格的规定，具体情况如下：

（一）关联交易的回避制度

1、《公司章程》关于关联交易的回避制度

《公司章程》第一百条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东

大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东在股东大会审议关联交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与表决。会议主持人应向出席会议的股东说明本章程规定的关联股东回避制度，并宣布需回避表决的关联股东的名称。需回避表决的关联股东不应参与投票表决，如该关联股东参与投票表决的，该表决票作为无效票处理。

关联股东没有主动说明关联关系的，其他股东可以要求其说明情况并回避表决。

《公司章程》第一百零一条规定：公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，并不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

2、《关联交易管理办法》关于关联交易的回避制度

《关联交易管理制度》第二十三条规定：“公司在进行关联交易的内部审议、决策程序时，应当采取必要的回避措施：（一）任何个人只能代表一方签署协议；（二）关联人不得以任何方式干预公司的决定；（三）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；（四）股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决”。

《关联交易管理办法》第三十条规定：公司发生的关联交易事项不论是否需要董事会批准同意，关联董事均应在该交易事项发生之前向董事会披露其关联关系的性质和关联程度。

《关联交易管理办法》第三十二条规定：公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所代表的股份数不计入有表决权股份总数。股东大会对有关关联交易事项作出决议时，视普通决议和特别决议不同，分别由非关联股东投票表决，表决过程应当由两名非关联股东代表参加计票、监票。

（二）关联交易的原则

《关联交易管理办法》第二条规定：关联交易应遵循诚实信用、平等自愿、

等价有偿、公开、公平、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。

（三）关联交易决策权限的规定

《公司章程》第九十六条规定：公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币 30 万元的关联交易事项，以及与关联法人发生的交易金额低于人民币 100 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易事项，由总经理在董事会授权范围内审议批准。

《公司章程》第九十七条规定：公司与关联自然人发生的交易金额达到人民币 30 万元以上（含 30 万元）的关联交易事项，应由公司董事会审议批准。公司与关联法人发生的交易金额在人民币 100 万元以上（含 100 万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上（含 0.5%），并低于人民币 1000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易，应由公司董事会审议批准。

《公司章程》第九十八条规定：公司与关联自然人、关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币 1000 万元以上（含 1000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易，应当聘请具有合法资格的中介机构对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交公司股东大会审议批准。

《公司章程》第九十九条规定：公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

《公司章程》第一百零二条规定：公司拟与关联人达成的总额高于 100 万元且高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易，公司独立董事应对其程序及公允性明确发表独立意见。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

《公司章程》第一百三十一条规定：“为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应具有一般董事的职权，还具有以下特别职权：（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的交易总额在人民币 100 万元以上或占公司最近经审计净资产值 5%以上的关联交易）应由独立董事同意后，方可提交董事会讨论；……”。

五、报告期内关联交易履行的程序及独立董事意见

报告期内，公司关联交易仅为发行人关联方为公司借款提供担保，且该关联交易发生在捷捷微电整体变更为股份公司之前。上述关联担保没有以明显不合理的条款及条件限制发行人（包括其前身）的权利或加重发行人（包括其前身）的义务或责任；不存在损害发行人（包括其前身）及其股东、尤其是中小股东利益的情形。根据公司相关规定，上述关联交易无需履行关联交易的审批程序。

公司独立董事对公司报告期内的关联交易发表如下意见：“江苏捷捷微电子股份有限公司在报告期内与关联方之间发生的关联交易均签订了合同，不存在有争议或纠纷的情形；捷捷微电在报告期内关联交易定价合理、公允，未损害公司和全体股东的利益。”

第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理

一、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介

(一) 董事会成员

董事会成员	在本公司职务	任期	提名人	选聘情况
黄善兵	董事长、总经理	2011.8.25-2014.8.24	张祖蕾	发行人创立大会暨第一次股东大会、发行人第一届董事会第一次会议选举
王成森	董事、副总经理、工程技术研究中心主任	2011.8.25-2014.8.24	张祖蕾	发行人创立大会暨第一次股东大会选举
沈欣欣	董事、财务总监、董事会秘书	2011.8.25-2014.8.24	黄善兵	
盛波	董事	2011.8.25-2014.8.24	黄善兵	
许苏明	独立董事	2011.8.25-2014.8.24	沈欣欣	
陈良	独立董事	2011.8.25-2014.8.24	沈欣欣	
雷星晖	独立董事	2012.3.15-2014.8.24	黄善兵	2012年第二次临时股东大会选举

黄善兵先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1956年生，高中，高级经济师。黄善兵先生系公司创始人之一，其职业生涯专注于功率半导体分立器件行业。黄善兵先生于1974年10月至1995年2月在启东市晶体管厂工作，先后担任工人、科长、副厂长。1995年3月，黄善兵先生创立捷捷微电的前身启东市捷捷微电子有限公司，自设立之日起至今担任公司法定代表人、董事长（改制前为执行董事）和总经理，主要负责公司的经营、管理和市场营销，目前兼任发行人控股股东捷捷投资董事长。

王成森先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1961年生，大学本科，高级工程师。王成森先生于1982年7月至2000年11月，就职于山东半导体总厂，

担任助理工程师、工程师、高级工程师；2000年12月至今在发行人处工作，主管产品开发和技術管理工作，现任公司董事、副总经理、工程技术研究中心主任。王成森先生于2001年1月至今，先后开发了具有高二次击穿功率的低频大功率晶体管芯片和达林顿芯片、0.8A~200A/600V~1600V单向晶闸管系列芯片、0.6A~40A/600V~1200V双向晶闸管系列芯片，主持开发公司“门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法”、“一种低结电容过压保护晶闸管器件芯片的生产方法”、“一种降低对通隔离扩散横向扩散宽度的结构及方法”、“台面工艺功率晶体管芯片结构”等发明专利以及各项专有技术的研发工作。

沈欣欣先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年生，大专，会计师，高级经济师。沈欣欣先生于1985年9月至1993年2月在启东化纤分厂会计、总账会计；1993年3月至1996年5月在启东市第二电信安装工程公司，历任工程二队队长、总账会计、副经理、法定代表人；1996年6月至2001年1月任启东市再生资源总公司副经理；2001年2月至今在发行人处工作，主管财务工作，现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

盛波先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1961年生，硕士，工程师。盛波先生于1985年7月至1987年9月在杭州电子工业学院计算机系任进修教师；1987年12月至1990年7月，任深圳大龙电子公司计算机部经理、总经理助理；1990年8月至1992年5月，在深圳市经济发展局工作；1993年3月至1999年8月，任深圳银岛投资发展股份有限公司董事总经理、深圳九龙源国际投资有限公司董事；1999年8月至今，担任深圳市创新投资集团有限公司高级投资经理，南通红土创新资本创业投资有限公司董事兼总经理，南通红土创新资本创业投资管理有限公司董事兼总经理，无锡红土创业投资有限公司董事兼总经理，南通红土伟达创业投资有限公司董事兼总经理，南通红土伟达创业投资管理有限公司总经理，成都创新投资管理有限公司总经理，江苏海四达电源科技股份有限公司董事、江苏界达特异新材料股份有限公司董事、北京金一文化发展股份有限公司董事、深圳云海通讯股份有限公司董事、深圳市联嘉祥科技股份有限公司董事、江苏瑞雪海洋科技有限公司副董事长、江苏万林现代物流股份有限公司监事会主席；自2011年8月起，担任公司董事。

许苏明先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1957年生，博士研究生，教授。许苏明先生先后任教于华侨大学、东南大学。在东南大学先后担任社会科学系副主任、文学院副院长、人文学院副院长，并获得讲师、副教授、教授职称，现为东南大学教授、博士生导师、现代社会发展研究中心主任。许苏明先生曾经于1993年至2001年期间担任南京市青年联合会副主席，自1998年至今担任南京市政协委员、常委，现为南京市人民政府参事、南京市政协立法咨询委员会委员、社会法制委员会委员、南京市社科联常委，以及吉林光华控股集团股份有限公司、南京三宝科技股份有限公司、苏州攀特电陶科技股份有限公司和江苏江南农村商业银行股份有限公司的独立董事。自2011年8月起，许苏明先生担任发行人独立董事。

陈良先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，硕士，教授。陈良先生于1990年至2000年在南京经济学院会计系任教，担任财务教研室主任；2000年至今在南京财经大学会计学院任教，历任财务管理系主任、会计学院副院长，并于2005年至2010年曾经担任过际华集团南京3521与5302公司的外部董事。陈良先生目前担任江苏省粮食会计学会副会长、江苏建筑会计学会顾问、苏州攀特电陶科技股份有限公司和江苏力博士机械股份有限公司独立董事。自2011年8月起，陈良先生担任发行人独立董事。

雷星晖先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，博士研究生，教授。雷星晖先生自1986年至今任职于同济大学，曾任经济与管理学院副院长、对外联络与发展办公室主任、校长办公室主任，现任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师、同济大学研究生院常务副院长，以及上海国际机场股份有限公司、浙江永贵电器股份有限公司、厦门银润投资控股股份有限公司和江西耐普矿机新材料股份有限公司的独立董事。自2012年3月15日起，雷星晖先生担任发行人独立董事。

（二）监事会成员

监事会成员	在本公司职务	任期	提名人	选聘情况
张玉平	监事会主席	2011.8.25-2014.8.24	王成森	发行人创立大会暨第一次

				股东大会、发行人第一届监事会第一次会议选举
薛治祥	监事、防护器件项目部二极体封装项目组经理	2011.8.25-2014.8.24	黄善兵	发行人创立大会暨第一次股东大会
陈杰	职工监事、市场营销部副部长	2011.8.25-2014.8.24	—	发行人职工代表大会

张玉平女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1958年生，高中。张玉平女士于1976年7月至1995年12月在启东市晶体管厂工作，担任生产部副部长；1996年1月至今在发行人处工作，曾任芯片制造部副部长，自2011年8月起，张玉平女士担任发行人监事会主席。

薛治祥先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年生，大专，工程师。薛治祥先生于1994年至2002年在国营第8070厂工作，历任班长、技术员、扩散车间技术负责人；2003年至今在发行人处工作，现任防护器件项目部二极体封装项目组经理，为公司发明专利“门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法”、“门极灵敏触发单向晶闸管芯片及其制造方法”、“一种低结电容过压保护晶闸管器件芯片的生产方法”等发明专利的发明人之一。自2011年8月起，薛治祥先生担任发行人监事。

陈杰先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1979年生，大专。陈杰先生于1998年10月至2002年12月，在南通迪皮茜电子有限公司从事资材采购工作；2003年1月至2003年12月，在启东吉莱电子有限公司从事销售业务；2004年1月至今，在发行人处从事销售业务，现任发行人市场营销部副部长。2011年8月，陈杰先生被公司职工代表大会选举为职工监事。

（三）高级管理人员

高级管理人员	在本公司职务	任期	选聘情况
黄善兵	董事长、总经理	2011.8.25-2014.8.24	发行人第一届
王成森	董事、副总经理、工程技术研	2011.8.25-2014.8.24	董事会第一次

	究中心主任		会议聘任
沈欣欣	董事、财务总监、董事会秘书	2011.8.25-2014.8.24	
张祖蕾	副总经理	2011.8.25-2014.8.24	
沈卫群	副总经理、物资管理部部长	2011.8.25-2014.8.24	

黄善兵先生，简历参见本节“（一）董事会成员”。

王成森先生，简历参见本节“（一）董事会成员”。

沈欣欣先生，简历参见本节“（一）董事会成员”。

张祖蕾先生，男，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中。张祖蕾先生于1980年1月至1989年12月在启东市汇龙电管站工作，任机电组组长；1990年1月至1996年12月在启东市再生资源公司工作，任营销部经理；1997年1月至今在发行人处就职，曾担任公司监事，主管公司销售工作，现任公司副总经理，并兼任发行人股东中创投资董事。

沈卫群女士，女，1960年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中，高级经济师。沈卫群女士于1977年7月至1995年2月在启东晶体管厂工作，担任生产部副部长；1995年3月至今在发行人处工作，主管公司生产工作，曾任任发行人芯片制造部部长，现为发行人副总经理、物资管理部部长。为公司发明专利“门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法”发明人之一。

（四）其他核心人员

本公司其他核心人员主要为六名核心技术人员。

黄善兵先生，简历参见本节“（一）董事会成员”。

王成森先生，简历参见本节“（一）董事会成员”。

沈卫群女士，简历参见本节“（三）高级管理人员”。

黎重林先生，男，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。黎重林先生于2004年7至2005年7月工作于南京东大微电子有限公司，担任蒸发工艺员及生产车间副主任，从事半导体过压保护器件方面的工艺与产品试验；2005年7月至今在发行人处工作，曾任技术质量部副部长，现任防护器件项目部部长，

主要负责芯片生产线质量管理，产品工艺技术改进以及新产品开发试验，同时攻关了半导体放电管产品，通过杂质调制效应，开发出的放电管产品电压一致性优良。黎重林先生是公司“门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法”、“一种低结电容过压保护晶闸管器件芯片的生产方法”、“一种低对通隔离扩散横向扩散宽度的结构及方法”、“台面工艺功率晶体管芯片结构和实施方法”等发明专利以及“台面工艺可控硅芯片结构”、“一种单项晶闸管芯片的门极结构”等实用新型专利的发明人之一。

薛治祥先生，简历参见本节“（二）监事会成员”。

颜呈祥先生，男，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。颜呈祥先生自2005年11月至今在发行人处工作，曾任客户服务部副部长，现任市场营销部部长。作为主要技术研发人员，颜呈祥先生研究开发了离子注入机工艺的导入、LPCVD工艺的导入、酸腐和碱腐抛光单晶硅工艺、多晶硅沉积工艺和离子注入法形成负温度系数的薄膜电阻的方法等技术项目，为公司多项专利技术如“门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法”、“门极灵敏触发单向晶闸管芯片及其制造方法”和“一种低结电容过压保护晶闸管器件芯片的生产方法”以及实用新型专利“一种高粘度光刻胶无胶丝匀胶装置”的发明人之一。

（五）公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员兼职单位与发行人之间的关联关系

截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员兼职的单位中，与发行人存在关联关系的单位如下：

姓名	兼职单位	兼职情况	与发行人关系
黄善兵	江苏捷捷投资有限公司	董事长	控股股东
张祖蕾	南通中创投资管理有限公司	董事	股东
沈卫群	南通中创投资管理有限公司	董事长	股东
盛波	深圳市创新投资集团有限公司	高级投资经理	股东
	南通红土创新资本创业投资管理有限公司	董事总经理	股东

除上述情况外，发行人不存在董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的

兼职单位与发行人存在关联关系。

（六）公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的亲属关系

公司副总经理张祖蕾和沈卫群是夫妻关系。除此以外，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在亲属关系。

（七）发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任的情况

2013年11月至2014年8月，保荐机构、发行人律师和会计师对公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、持股5%以上股东进行了辅导，辅导效果良好，被辅导对象均已了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任。

二、公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接持有本公司股份情况

姓名	在本公司职务	直接持股数（万股）	持股比例
黄善兵	董事长、总经理	960	13.72%
王成森	董事、副总经理、工程技术研究中心主任	480	6.86%
沈欣欣	董事、财务总监、董事会秘书	300	4.29%
张玉平	监事会主席	15	0.21%
薛治祥	监事、防护器件项目部二极体封装项目组经理	45	0.64%
张祖蕾	副总经理	400	15.42%
黎重林	防护器件项目部部长	15	0.21%
颜呈祥	市场营销部部长	15	0.21%

除上述人员外，公司不存在其他董事、监事、高级管理人员、核心人员及其近亲属直接持有本公司股份的情形。

（二）公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属间接持有本公司股份情况

1、通过捷捷投资间接持有本公司股份的情况

姓名	职务/亲属关系	持有捷捷投资的股权		通过捷捷投资间接持有本公司的股权	
		持股数（万股）	持股比例	持股数（万股）	持股比例
黄善兵	法定代表人、董事长、总经理	700	70%	3,000	42.87%
黄健	黄善兵之子	300	30%		

2、通过蓉俊投资间接持有本公司股份的情况

姓名	职务/亲属关系	持有蓉俊投资的股权		通过蓉俊投资间接持有本公司的股权	
		持股数（万股）	持股比例	持股数（万股）	持股比例
黄健	黄善兵之子	99	99%	240	3.43%
李燕	黄善兵儿媳	1	1%		

3、通过中创投资间接持有本公司股份的情况

姓名	职务/亲属关系	持有中创投资的股权		通过中创投资间接持有本公司的股权	
		持股数（万股）	持股比例	持股数（万股）	持股比例
张祖蕾	副总经理	80	40%	680	9.71%
沈卫群	副总经理、张祖蕾之妻	60	30%		
张家铨	张祖蕾、沈卫群之子	60	30%		

除此上述人员外，发行人不存在其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属间接持有本公司股份的情形。

（三）公司董事、监事、高级管理人员以及其他核心人员所持股份的质押或冻结情况

截至本招股说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其及亲属持有的本公司股份不存在质押或冻结的情况。

三、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况

截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在与发行人及其业务相关的对外投资。

四、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从发行人及关联企业领取报酬情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成、确定依据及所履行的程序

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由基本工资和奖金组成，基本工资以员工岗位为依据确定，奖金以公司年度盈利水平和各部门绩效考核结果为依据确定。

公司董事会下属薪酬与考核委员会分别于2012年底和2013年底对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬提出提案并进行审核。自2014年起，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬经薪酬与考核委员会审议后提交公司董事会和股东大会审议批准。

（二）公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员报告期内的薪酬情况

2011年、2012年和2013年，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从发行人处领取的薪酬总额分别为461.80万元、447.42万元和464.26万元，占发行人各期利润总额的比例为6.47%、6.21%和6.01%。2013年度公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从发行人及其关联企业领取收入的情况如下：

姓名	职务	领取报酬(万元)	领薪单位
黄善兵	董事长、总经理	76.93	发行人
王成森	董事、副总经理、工程技术研究中心主任	80.59	发行人
沈欣欣	董事、财务总监、董事会秘书	75.64	发行人

盛波	董事	30.00	红土创投
许苏明	独立董事	6.00	发行人
陈良	独立董事	6.00	发行人
雷星晖	独立董事	6.00	发行人
张玉平	监事会主席	11.29	发行人
薛治祥	监事、防护器件项目部二极体封装项目组经理	27.06	发行人
陈杰	职工监事、市场营销部副部长	23.00	发行人
张祖蕾	副总经理	50.79	发行人
沈卫群	副总经理、物资管理部部长	50.83	发行人
黎重林	防护器件项目部部长	25.58	发行人
颜呈祥	市场营销部部长	24.55	发行人

除上述收入外，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员未享受其他待遇，也没有退休金计划安排。

五、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的协议、承诺及其履行情况

公司与在公司任职的董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员及其他核心人员签订《劳动合同》和《保密协议》。截至本招股说明书签署日，上述合同履行正常。

六、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况

2011年8月25日，发行人由捷捷有限整体变更设立股份公司，经公司创立大会暨第一次股东大会通过，选举黄善兵先生、王成森先生、沈欣欣先生、盛波先生、许苏明先生、陈良先生和李泽宏先生为公司董事会成员，其中许苏明先生、陈良先生和李泽宏先生为独立董事。

李泽宏先生由于工作繁忙，无法履行独立董事的勤勉义务，向发行人递交了《辞职报告书》，2012年2月28日和3月15日，发行人召开第一届董事会第五次会议和2012年第二次临时股东大会，同意李泽宏先生辞去公司独立董事一

职及其担任的战略委员会委员和提名委员会主任委员职务，并推选雷星晖先生为公司独立董事。2012年3月15日，发行人第一届董事会第六次会议推选雷星晖担任公司战略委员会委员和提名委员会主任委员。

除上述情况外，发行人董事、监事、高级管理人员最近两年未发生变化。

七、公司治理

（一）股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会的运行情况及人员的履职情况

1、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

公司成立以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市规则》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况制定了公司章程，逐步建立了科学和规范的法人治理结构，制订和完善了相关内部控制制度，股东大会、董事会和监事会的议事规则及独立董事和董事会秘书制度等治理文件。

2011年8月25日，公司召开创立大会暨首次股东大会，会议审议并一致通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》及《江苏捷捷微电子股份有限公司股东大会议事规则》、《江苏捷捷微电子股份有限公司董事会议事规则》、《江苏捷捷微电子股份有限公司监事会议事规则》、《江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事工作制度》和《江苏捷捷微电子股份有限公司关联交易管理制度》，同时选举产生了股份公司第一届董事和第一届监事，通过了《关于设立审计委员会的议案》、《关于设立战略委员会的议案》、《关于设立提名委员会的议案》和《关于设立薪酬与考核委员会的议案》。上述制度的制定和实施使公司初步建立起了符合上市公司要求的公司治理结构。

2011年8月25日，公司召开了第一届董事会第一次会议，选举董事长，选举审计委员会委员、选举战略委员会委员、选举提名委员会委员及选举薪酬与考核委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，产生了公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会各专门委员会委员及其主任委员，任期三年。同时，还通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司审

计委员会工作制度》、《江苏捷捷微电子股份有限公司战略委员会工作制度》、《江苏捷捷微电子股份有限公司提名委员会工作制度》、《江苏捷捷微电子股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》、《江苏捷捷微电子股份有限公司总经理工作细则》、《江苏捷捷微电子股份有限公司董事会秘书工作细则》。

2011年11月25日，公司召开第一届第三次董事会会议，一致通过了《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部审计制度》和《重大信息内部报告制度》，《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》，经2011年12月12日公司第三次临时股东大会审议通过并执行，公司已建立了完善的制度体系。

通过上述制度的制定和有效实施，公司逐步健全了符合上市要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。

2、报告期内，发行人股东大会、董事会、监事会的实际运行情况

截至本招股说明书签署日，发行人股东大会、董事会、监事会的实际运行情况如下：

会议	召开次数	会议出席情况
股东大会	12	全体股东
董事会	15	全体董事
监事会	8	全体监事

发行人历次股东大会、董事会、监事会均按照《公司章程》规定的程序召开，决议内容合法有效，公司董事会、高级管理人员均能够按照《公司法》、《公司章程》等各项规定切实履行职权。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运行情况良好。

3、独立董事制度运行情况

公司于2011年8月25日制定了《独立董事工作制度》，独立董事依据有关法律、法规、公司章程谨慎、认真、勤勉地履行了权利和义务，参与了公司重大经营决策，对公司本次募集资金投资项目、公司经营管理、发展方向及发展战略的选择、完善公司内部控制、决策机制等方面提出了积极的建议。公司独立董事不存在对发行人有关事项提出异议的情形。

4、董事会秘书制度的运行情况

报告期内，公司董事会秘书筹备了13次董事会会议和11次股东大会，确保了公司董事会和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

5、董事会审计委员会及其他专门委员会的人员构成及运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，人员构成如下：

委员会名称	人员构成	
	主任委员	委员
审计委员会	陈良	许苏明、黄善兵
战略委员会	王成森	黄善兵、雷星晖
薪酬与考核委员会	许苏明	陈良、沈欣欣
提名委员会	雷星晖	许苏明、黄善兵

公司董事会专门委员会的设置和人员构成符合相关法律法规的规定，战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司设立的审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会成员由3名董事组成（含2名独立董事），主任陈良先生为会计专业人士。报告期内，公司董事会审计委员会共召开10次会议，参与了公司本次发行审计及内部控制评价、定期报告审计等事项，并对财务工作和审计工作进行定期总结，有效履行了对公司内部控制、财务制度执行情况的监督职责。

（二）发行人内部控制情况

1、公司管理层对内部控制的自我评估意见

公司成立以来，一直致力于内部控制制度的制定和完善，建立并逐步健全法人治理结构，建立了包括决策管理制度、预算管理制度、资产管理制度、风险管理制度及内部审计制度在内的内部控制制度。

本公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司“三会”和高管人员的职责及制衡机制能够有效运作，实现了公司决策程序和议事程序规范化、透明化，公司内部监督和反馈系统健全、有效。同时，相关的制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计等做出了明确规定，保证了公司内部控制系统的完整，实现了公司规范、安全、顺畅的运行。

根据不相容职务必须分离的内部控制原则，本公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离、经营责任与会计责任相分离；授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保等重大事项，按金额及权限分别由总经理、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。

本公司已建立健全并有效执行内部控制制度，保证业务活动的有效进行，保护资产的安全、完整，防止和杜绝舞弊行为发生，为财务会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供合理的保证。

公司出具了《江苏捷捷微电子股份有限公司关于内部控制有关事项的说明》，公司管理层认为“本公司于2014年6月30日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制”。

2、注册会计师对发行人内部控制的鉴证意见

瑞华会计师事务所出具了瑞华核字[2014]48370012号《内部控制鉴证报告》，认为，“江苏捷捷公司于2014年6月30日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。”

（三）规范运行情况

发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书

和董事会专门委员会制度，自成立至今，发行人及其董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

（四）发行人资金管理、对外投资、担保事项的情况、相关政策及制度安排

1、发行人资金管理情况、相关政策及制度安排、执行情况

发行人建立了《资金管理制度》、《财务支出审批管理制度》等资金日常管理和控制制度，并严格执行。

《公司章程》对公司资金管理决策权限作出如下规定：公司借贷、委托贷款涉及金额低于 3,000 万元（含 3,000 万元）且低于公司最近一期经审计净资产 30%（含 30%）的，由总经理签署；涉及金额超过 3,000 万元、低于 5,000 万元（含 5,000 万元）的，由总经理报请董事会批准；涉及金额在 5,000 万元以上的，由总经理提出方案，经董事会报请股东大会批准。

《资金管理制度》对公司资金管理决策权限作出如下规定：审批权限内的款项，由财务部办理对外支付手续，按如下程序逐级审批，直至满足本办法规定的批准权限为止，即相关部门-财务部资金岗位主管-财务部部长-财务总监-总经理。

报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况，公司资金管理制度执行情况良好。

2、发行人对外投资情况、相关政策及制度安排、执行情况

为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，规避投资风险，有效、合理的使用资金，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，捷捷微电制定了《对外投资管理制度》。

《对外投资管理制度》对公司对外投资的审批权限作了如下规定：公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，分别根据《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

《公司章程》对公司对外投资涉及金额低于 3,000 万元（含 3,000 万元）且低于公司最近一期经审计净资产 30%（含 30%）的，由总经理签署；涉及金额超过 3,000 万元、低于 5,000 万元（含 5,000 万元）的，由总经理报请董事会批准；涉及金额在 5,000 万元以上的，由总经理提出方案，经董事会报请股东大会批准。

报告期内，本公司对外投资的决策和执行均符合相关决策权限和程序的规定。

3、发行人对外担保事项、相关政策及制度安排、执行情况

为规范公司的对外担保的管理，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《公司法》、《证券法》、《担保法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，捷捷微电结合公司的实际情况制定了《对外担保管理制度》。

《对外担保管理制度》关于对外担保的审批作了如下规定：

“第十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（1）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计的总资产的 30%以后的任何担保；

（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（5）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3,000 万元；

（6）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（7）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。

公司在连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的，应当由股东大会作出决议并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股东

大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东、及控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第十五条 除本制度规定应由股东大会审议的对外担保事项外，公司其他对外担保需经董事会审议通过，并须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

第二十一条 独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见，必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保进行核查。如发现异常，应及时向董事会和监管部门报告。”

报告期内，本公司无对外担保的情形；如日后发生相关事项，发行人将按照相关制度及要求严格执行相关程序，确保发行人及发行人股东的合法权益不受损失。

八、发行人对投资者权益保护的情况

（一）建立健全内部信息披露制度和流程

为保护投资者的合法权利，保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，明确投资者关系管理负责人、投资者关系管理的内容、应披露的信息及披露标准、信息的传递、审核、披露流程等内容，加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，《公司章程》和《董事会议事规则》中明确规定：董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露。

公司将通过定期报告与临时公告、年度报告说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演等多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通。并且以充分披露信息、合法性、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗和互动沟通等原则，保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

（二）完善股东投票机制

1、投票方式和行使表决权

《公司章程（草案）》中关于投票方式和行使表决权的規定：“公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会公告中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司在保证股东大会合法、有效的前提下，还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席……”

股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。”

2、累积投票制

《公司章程（草案）》中关于累积投票制的規定：“股东大会就选举二名以上董事进行表决时，采用累积投票制。

累积投票制实施办法如下：

（一）累积表决票数计算办法

1、每位股东持有的有表决权的股份乘以本次股东大会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决票数。

2、股东大会进行多轮选举时，应当根据每轮选举应当选董事人数重新计算股东累积表决票数。

3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、独立董事、监事、本次股东大会监票人、见证律师或公证处公证员对宣布结果有异议时，应当立即进行核对。

（二）投票办法

每位股东均可以按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人。如果股东投票于两名以上董事

候选人时，不必平均分配票数；但其分别投票之和只能等于或者小于其累积表决票数，否则，其该项表决无效。

（三）董事当选

1、等额选举

（1）董事候选人获取选票数超过参加会议有效表决股份数二分之一以上时，即为当选；

（2）若当选董事人数少于应选董事，但已当选董事人数超过本章程规定的董事成员三分之二时，则缺额应当在下次股东大会填补；

（3）若当选董事人数少于应选董事，且由此导致董事会成员不足本章程规定的三分之二时，则应当对未当选的董事候选人进行第二轮选举；

（4）若第二轮选举仍未能满足前款要求时，则应当在本次股东大会结束之后的二个月内，再次召开股东大会对缺额董事进行选举。

2、差额选举

（1）董事候选人获取选票数超过参加会议有效表决股份数二分之一以上时，且该等人数等于或小于应当选董事人数时，该等候选人即为当选；

（2）若获取超过参加会议有效表决股份数二分之一以上选票的董事候选人多于应当选董事人数时，则按得票多少排序，取得票数较多者当选；

（3）若因两名及其以上的候选人得票相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举；

（4）若第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举；

（5）由此导致董事会成员不足本章程规定的三分之二以上时，则下次股东大会应当在本次股东大会结束后的二个月内召开。

股东大会选举二名以上股东代表担任的监事时，表决方法与选举董事相同。”

3、网络投票

《公司章程（草案）》中关于利润分配的投票规定：“公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过，其中股东大会决议需要经出席股东大会的股东所持表决权的 $2/3$ 以上通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是中小股东等公众投资者）和独立董事的意见制定或调整股东回报计划。……股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利，充分听取中小投资者等公众股东的意见。”

第九节 财务会计信息与管理层分析

以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。本公司提醒投资者，除阅读本节所披露的财务会计信息外，还应关注审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、财务报表

报告期内公司无子公司，无合并报表。

（一）资产负债表

单位：元

项目	2014/6/30	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
流动资产：				
货币资金	102,789,026.44	108,255,752.75	92,015,324.80	80,545,419.14
交易性金融资产				
应收票据	33,112,524.00	31,217,996.06	18,138,007.52	18,913,730.90
应收账款	58,988,056.40	52,640,523.06	37,151,203.62	34,876,342.51
预付款项	584,187.53	1,013,210.75	1,450,332.11	1,649,297.76
应收利息				
应收股利				
其他应收款	11,800.00	14,000.00	63,000.00	45,000.00
存货	46,318,611.54	41,505,411.07	40,025,664.22	35,438,299.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				4,071,129.15
流动资产合计	241,804,205.91	234,646,893.69	188,843,532.27	175,539,219.26
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				

长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	99,249,037.44	110,192,939.47	105,084,578.10	113,739,194.13
在建工程	5,347,314.80	3,186,840.40	16,810,986.62	1,864,271.68
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	10,269,750.92	9,860,425.53	10,065,264.81	1,098,483.62
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,065,350.02	3,084,660.83	3,123,496.81	2,967,802.25
其他非流动资产	7,590,665.49	2,572,955.90		8,980,686.08
非流动资产合计	125,522,118.67	128,897,822.13	135,084,326.34	128,650,437.76
资产总计	367,326,324.58	363,544,715.82	323,927,858.61	304,189,657.02
流动负债：				
短期借款				30,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	15,253,970.04	14,157,364.29	13,329,202.86	26,484,690.53
预收款项	290,650.45	382,053.91	219,215.28	356,811.86
应付职工薪酬	6,482,811.83	6,342,842.71	4,920,677.29	4,008,690.53
应交税费	7,577,043.91	5,482,242.31	2,482,022.85	869,031.04
应付利息				66,146.67
应付股利				
其他应付款	50,000.00	50,000.00		

一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	29,654,476.23	26,414,503.22	20,951,118.28	61,785,370.63
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,888,938.42	7,174,188.94	9,857,929.12	11,004,510.00
非流动负债合计	5,888,938.42	7,174,188.94	9,857,929.12	11,004,510.00
负债合计	35,543,414.65	33,588,692.16	30,809,047.40	72,789,880.63
股东权益：				
股本（实收资本）	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	134,549,719.79	134,549,719.79	134,549,719.79	134,549,719.79
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,480,630.39	15,480,630.39	8,856,909.14	2,685,005.66
一般风险准备				
未分配利润	111,752,559.75	109,925,673.48	79,712,182.28	24,165,050.94
股东益合计	331,782,909.93	329,956,023.66	293,118,811.21	231,399,776.39
负债和股东权益总计	367,326,324.58	363,544,715.82	323,927,858.61	304,189,657.02

（二）利润表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	107,222,681.25	194,537,815.00	172,497,410.14	170,317,359.41

减：营业成本	50,987,775.33	94,711,290.88	79,989,119.56	78,769,034.62
营业税金及附加	1,333,753.30	2,245,858.05	2,015,303.66	816,900.13
销售费用	2,698,559.20	6,881,192.54	5,270,211.06	3,884,107.08
管理费用	10,600,346.40	18,440,151.09	18,732,533.19	14,341,625.16
财务费用	-326,574.13	-2,316,947.68	-1,342,431.23	127,156.52
资产减值损失	1,000,152.77	910,018.57	1,123,224.55	945,504.97
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号 填列)				
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	40,928,668.38	73,666,251.55	66,709,449.35	71,433,030.93
加：营业外收入	2,467,558.52	4,232,515.03	5,476,611.62	497,643.12
减：营业外支出	14,248.60	639,283.62	122,404.47	535,081.59
其中：非流动资产处置 损失		524,751.70		376,295.61
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	43,381,978.30	77,259,482.96	72,063,656.50	71,395,592.46
减：所得税费用	6,555,092.03	11,022,270.51	10,344,621.68	11,087,336.89
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	36,826,886.27	66,237,212.45	61,719,034.82	60,308,255.57
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.53	0.95	0.88	0.94
(二) 稀释每股收益	0.53	0.95	0.88	0.94
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	36,826,886.27	66,237,212.45	61,719,034.82	60,308,255.57

(三) 现金流量表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	114,283,963.47	195,094,555.86	197,108,066.16	174,409,051.28
收到的税费返还		1,038,212.25	4,047,569.69	
收到其他与经营活动有关的现金	1,506,285.58	4,292,616.91	5,514,981.43	10,650,753.85
经营活动现金流入小计	115,790,249.05	200,425,385.02	206,670,617.28	185,059,805.13
购买商品、接受劳务支付的现金	38,442,378.94	73,700,139.63	64,631,231.51	78,700,482.98
支付给职工以及为职工支付的现金	17,668,724.75	27,812,351.21	25,591,564.64	21,372,404.83
支付的各项税费	18,146,543.13	27,386,869.24	26,925,110.51	27,538,438.90
支付其他与经营活动有关的现金	3,945,426.52	7,846,469.08	7,706,260.93	5,026,855.83
经营活动现金流出小计	78,203,073.34	136,745,829.16	124,854,167.59	132,638,182.54
经营活动产生的现金流量净额	37,587,175.71	63,679,555.86	81,816,449.69	52,421,622.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	12,309.25	2,222,222.31	231,316.92	

现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	12,309.25	2,222,222.31	231,316.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,446,211.27	20,261,350.22	40,487,660.95	70,176,954.59
投资支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金				1,100,000.00
投资活动现金流出小计	10,446,211.27	20,261,350.22	40,487,660.95	71,276,954.59
投资活动产生的现金流量净额	-10,433,902.02	-18,039,127.91	-40,256,344.03	-71,276,954.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				49,062,500.00
取得借款收到的现金				40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	56,600.00		108,152.59	
筹资活动现金流入小计	56,600.00		108,152.59	89,062,500.00
偿还债务支付的现金			30,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,620,000.00	29,400,000.00	90,200.00	439,242.24
支付其他与筹资活动有关的现金		103,165.89		900,000.00
筹资活动现金流出小计	32,620,000.00	29,503,165.89	30,090,200.00	41,339,242.24
筹资活动产生的现金流量净额	-32,563,400.00	-29,503,165.89	-29,982,047.41	47,723,257.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-5,410,126.31	16,137,262.06	11,578,058.25	28,867,925.76
加：期初现金及现金等价物余额	107,160,739.45	91,023,477.39	79,445,419.14	50,577,493.38
六、期末现金及现金等价物余额	101,750,613.14	107,160,739.45	91,023,477.39	79,445,419.14

二、 审计意见

公司已聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日、2014年6月30日资产负债表，2011年度、2012年度、2013年及2014年1-6月利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计。

瑞华会计师事务所对上述报表出具了瑞华审字[2014]48370003号标准无保留意见的《审计报告》，审计结论如下：

“我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏捷捷微电子股份有限公司2014年6月30日、2013年12月31日、2012年12月31日、2011年12月31日的财务状况以及2014年1-6月、2013年度、2012年度、2011年度的经营成果和现金流量。”

三、 影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标

（一）影响收入、成本、费用和利润的主要因素

1、影响本公司收入的主要因素是产品的市场前景、产品技术优势及定价能力、新产品和新市场的开拓效果以及新增产能的消化能力。本公司拥有 30 余项功率半导体芯片和器件的核心技术不仅保证公司产品性能优良、工艺领先、质量

稳定可靠、性价比高，还可及时根据客户需求设计、生产定制产品，不断推出新产品。现在及未来三年，公司计划在塑封晶闸管器件和芯片以及半导体防护器件两个细分领域内成为我国行业内的领先企业，建立高端客户群，实现民族品牌国际化，在我国功率半导体分立器件市场上进一步替代进口同类产品，并以此为突破，打开国际市场的销售空间，优化公司盈利结构，提升公司盈利能力。

2、影响本公司成本的主要因素是原材料价格，以及通过技术工艺降低成本的能力。发行人产品生产的主要原材料包括硅单晶、引线框架、高纯银、硼源、环氧模塑料、陶瓷片等，其占发行人总采购的 50%左右。报告期内，硼源、环氧模塑料、陶瓷片单价变动较小，硅单晶、高纯银、引线框架价格下降幅度较为明显。

近年来，随着公司的发展，无论从研发成果的转化或者规模经济的效果来看，公司成本都得以有效的控制和降低。首先，随着公司生产能力的逐渐更新换代，公司的生产效率得到了大幅提高，其次，公司通过研发创新、精细化管理，单片材料利用率得到了有效提高，另外，随着公司规模壮大，逐渐体现规模效应，随着公司产量和销量的增加，固定资产利用率得到有效的提高，单位分摊固定成本随产量的上升明显降低，公司募投项目实施后，单位固定资产的产值将进一步得到提高。

3、本公司期间费用主要包括销售费用、管理费用、财务费用。报告期内，公司期间费用占比稳定、费用结构合理，预计不会对公司生产经营产生重大不利影响。

4、影响本公司利润的主要因素是毛利率。报告期内公司毛利率水平较高，主要原因是公司通过自主研发和技术创新，研发成果转化利润效果明显，公司产品售价和成本优势决定公司较高的毛利率水平。本公司未来将持续通过技术研发新产品、工艺改进、强化成本管理等有效途径，进一步提升产品附加值，保持公司良好的毛利率。

(二) 发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标

根据公司所处的行业状况及自身特点,本公司营业收入增长率、毛利率水平、经营性现金流量等指标对分析公司收入、成本、费用和利润具有较为重要的意义,其变动对本公司业绩变动具有较强的预示作用。

1、营业收入增长率可用来判断公司的业务发展状况

2012年、2013年,公司营业收入增长率分别为1.28%、12.78%,2014年1-6月公司主营业务收入占2013年全年的55.12%。说明公司主营业务市场前景良好,公司主营竞争能力较强。

2、毛利率水平可用来判断公司产品的竞争力和获利能力

2011年、2012年、2013年和2014年1-6月,公司主营业务毛利率分别为53.65%、53.57%、51.18%和52.43%,说明公司具有较强的产品定价能力以及成本控制能力,公司盈利能力较强。

3、经营性现金流量可用来判断公司经营活动的健康状态

2011年、2012年、2013年和2014年1-6月,公司经营性现金流量分别为5,242.16万元、8,181.64万元、6,367.96万元和3,758.72万元。经营性现金流量持续为正数且与公司净利润水平相匹配,公司盈利质量、回款情况良好。

通过上述关键指标的分析可以看出,公司目前业务发展状况和盈利质量较好,预计在经营环境未发生重大不利变化的条件下,可以继续保持市场竞争力和持续发展能力。

四、主要会计政策和会计估计

(一) 收入确认原则和计量方法:

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

销售商品确认收入的具体时点

1、国内销售收入确认具体时点

公司商品已发至客户并经客户验收确认后，销售商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方。因此，公司在产品经客户验收后确认收入。

2、出口销售收入确认具体时点

公司海外业务遵循国际通行的商贸规则和惯例，采取 FOB 报价，T/T、L/C、OA 等结算方式，故公司在货物报关装船时确认收入。

（二）金融工具

1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.取得该金融资产的目的**

的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

（2）持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期

或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费

用及折价或溢价等。

（3）贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

3、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的

金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（2）可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的

风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

（2）其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

6、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

7、衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

8、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（三）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1、坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2、坏账准备的计提方法

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将应收款项余额大于应收款项账面价值 10%（含 10%）的款项划分为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	账龄状态

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	10.00	10.00

1-2 年	30.00	30.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备,包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

3、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的,按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(四) 存货

1、存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品、发出商品、委托加工物资、周转材料等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的

影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、周转材料的摊销方法

周转材料于领用时均按一次摊销法摊销。

（五）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	3-10	5.00	9.50-31.67
运输设备	4-5	5.00	19.00-23.75
办公设备及其他	5-10	5.00	9.50-19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的

预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

4、融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5、其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（六）在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见（五）固定资产“3、非流动非金融资产减值”

（七）长期股权投资

1、投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（八）无形资产

1、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

2、研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见（五）固定资产“3、非流动非金融资产减值”

（九）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的

政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

1、政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

2、政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

1、应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

2、所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

3、相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损

失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不

是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4、所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(十三) 主要税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的 15%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。

2、税收优惠及批文

本公司于2011年8月2日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准取得国家高新技术企业证书，证书编号为:GR201132000112，有限期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司按15%的税率征收企业所得税。

(十四) 会计政策、会计估计变更的说明

1、会计政策变更

报告期内无会计政策变更。

2、会计估计变更

报告期内无会计估计变更。

(十五) 前期会计差错

报告期内无前期会计差错更正。

五、分部信息

(一) 营业收入按业务划分

单位：万元

类别		主营业务	其他业务	合计
2014年1-6月	收入	10,718.30	3.97	10,722.27

	成本	5,098.21	0.57	5,098.78
2013 年度	收入	19,401.20	52.58	19,453.78
	成本	9,471.13	-	9,471.13
2012 年度	收入	17,227.78	21.96	17,249.74
	成本	7,998.91	-	7,998.91
2011 年度	收入	16,993.17	38.56	17,031.74
	成本	7,876.90	-	7,876.90

(二) 营业收入按产品划分

单位：万元

类别		功率半导体芯片	功率半导体分立器件	其他	合计
2014 年 1-6 月	收入	3,974.40	6,743.90	3.97	10,722.27
	比例	37.07%	62.90%	0.04%	100.00%
2013 年度	收入	6,470.66	12,930.53	52.58	19,453.78
	比例	33.26%	66.47%	0.27%	100.00%
2012 年度	收入	6,932.49	10,295.29	21.96	17,249.74
	比例	40.19%	59.68%	0.13%	100.00%
2011 年度	收入	7,530.74	9,462.44	38.56	17,031.74
	比例	44.22%	55.56%	0.23%	100.00%

(三) 营业收入按区域划分

单位：万元

类别		内销收入	出口收入	合计
2014 年 1-6 月	收入	9,616.52	1,105.75	10,722.27
	占比	89.69%	10.31%	100.00%
2013 年度	收入	17,488.50	1,965.29	19,453.78
	占比	89.90%	10.10%	100.00%
2012 年度	收入	15,960.67	1,289.07	17,249.74

	占比	92.53%	7.47%	100.00%
2011 年度	收入	15,946.85	1,084.89	17,031.74
	占比	93.63%	6.37%	100.00%

(四) 营业收入按销售方式划分

单位：万元

销售方式	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
经销	2,680.78	25.00%	4,988.89	25.64%	4,634.78	26.87%	3,151.27	18.50%
直销	8,041.49	75.00%	14,464.89	74.36%	12,614.97	73.13%	13,880.46	81.50%
合计	10,722.27	100.00%	19,453.78	100.00%	17,249.74	100.00%	17,031.74	100.00%

六、最近一年收购兼并情况

发行人最近一年内无收购兼并其它企业资产（或股权）的情况。

七、非经常性损益情况

以下非经常性损益明细表以合并报表数据为基础，并经瑞华会计师事务所核
验。

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-52.48	15.61	-37.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	246.15	413.46	529.67	49.32

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
债务重组损益	-	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	82.62	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.81	-1.67	-9.86	-15.43
其他符合非经营性损益定义的损益项目	-	-	-	-
小计	245.33	441.94	535.42	-3.74
减：所得税影响额	36.80	66.29	79.02	-0.08
少数股东权益影响额	-	-	-	-
合计	208.53	375.65	456.40	-3.66
扣除非经常性损益后的净利润	3,474.16	6,248.07	5,715.51	6,034.49
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润	3,474.16	6,248.07	5,715.51	6,034.49

报告期，发行人的非经常损益金额较小，对发行人业绩影响较小。

八、主要财务指标

（一）基本财务指标

财务指标	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
流动比率(倍)	8.15	8.88	9.01	2.84
速动比率(倍)	6.59	7.31	7.10	2.27
资产负债率	9.68%	9.24%	9.51%	23.93%
应收账款周转率(次/年)	1.92	4.33	4.79	5.50
存货周转率(次/年)	1.16	2.32	2.12	2.75

息税折旧摊销前利润(万元)	5,600.81	9,883.70	9,175.48	8,626.17
利息保障倍数(倍)	-	-	3,814.64	191.98
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.54	0.91	1.17	0.75
每股净现金流量(元)	-0.08	0.23	0.17	0.41
无形资产(扣除土地使用权)占净资产比率(%)	-	-	-	-
归属于发行人股东的净利润	3,682.69	6,623.72	6,171.90	6,030.83
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润	3,474.16	6,248.07	5,715.51	6,034.49
归属于发行人股东的每股净资产	4.74	4.71	4.19	3.31

注：相关财务指标计算公式：

- ① 流动比率=流动资产/流动负债
- ② 速动比率=速动资产/流动负债
- ③ 资产负债率=负债总额/资产总额×100%
- ④ 应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额
- ⑤ 存货周转率=销售成本/存货平均余额
- ⑥ 息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息+折旧+摊销
- ⑦ 利息保障倍数=息税前利润/利息费用=(利润总额+利息费用)/利息费用
- ⑧ 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本(实收资本)
- ⑨ 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本(实收资本)
- ⑩ 归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东的期末净资产/期末股本(实收资本)

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产 收益率%	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2014年1-6月	10.94	0.53	0.53
	2013年度	20.61	0.95	0.95
	2012年度	23.53	0.88	0.88
	2011年度	35.10	0.94	0.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2014年1-6月	10.32	0.50	0.50
	2013年度	19.44	0.89	0.89
	2012年度	21.79	0.82	0.82
	2011年度	35.12	0.94	0.94

公司按照证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求计算上述指标。

九、财务状况分析

（一）行业状况及对公司财务状况的影响分析

发行人主营功率半导体芯片及器件的研发、设计、生产和销售，行业特点以及公司主营业务的实际情况决定了公司属于技术密集型和资本密集型企业。技术创新能力、研发成果转化能力和先进制造力决定了公司的盈利能力，上述特征体现了公司资金需求大、固定资产比重高和设备更新速度快的实际情况。

公司通过多年积累及持续技术创新，形成公司自主知识产权的技术产品，具有性价比高、竞争力强的特点。近年来，公司产品不仅能够替代进口，而且对外出口额也逐年增加，产品市场份额逐年提高，为公司创造了良好的盈利，成为公司持续、优质的现金来源。

现阶段，公司处于快速成长期，公司多年来形成的累计利润已陆续投入到公司发展中，但是随着公司品牌影响力的深化，公司市场份额增长较快，未来两三年之后产能将成为公司发展中的主要矛盾，因此，为解决日益增长的供销矛盾，保持未来发展中的核心竞争力，在生产能力建设方面，需要滚动发展、提前部署，公司需要努力拓宽融资渠道、优化资本结构，提前筹备产能项目和研究项目，建

立未来竞争中的硬件和软件基础，才能实现优质的可持续增长。

（二）资产及营运能力分析

1、资产构成及变化情况

报告期，公司的资产构成如下：

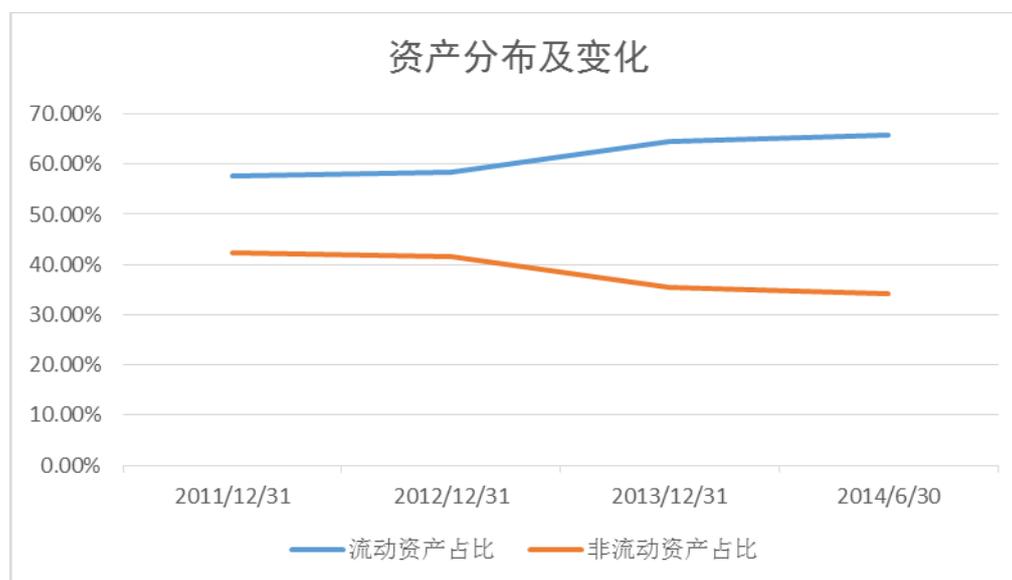
单位：万元

项目	2014/6/30		2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	10,278.90	27.98%	10,825.58	29.78%	9,201.53	28.41%	8,054.54	26.48%
应收票据	3,311.25	9.01%	3,121.80	8.59%	1,813.80	5.60%	1,891.37	6.22%
应收账款	5,898.81	16.06%	5,264.05	14.48%	3,715.12	11.47%	3,487.63	11.47%
预付款项	58.42	0.16%	101.32	0.28%	145.03	0.45%	164.93	0.54%
其他应收款	1.18	0.00%	1.40	0.00%	6.30	0.02%	4.50	0.01%
存货	4,631.86	12.61%	4,150.54	11.42%	4,002.57	12.36%	3,543.83	11.65%
其他流动资产	-	-	-	-	-	-	407.11	1.34%
流动资产合计	24,180.42	65.83%	23,464.69	64.54%	18,884.35	58.30%	17,553.92	57.71%
固定资产	9,924.90	27.02%	11,019.29	30.31%	10,508.46	32.44%	11,373.92	37.39%
在建工程	534.73	1.46%	318.68	0.88%	1,681.10	5.19%	186.43	0.61%
无形资产	1,026.98	2.80%	986.04	2.71%	1,006.53	3.11%	109.85	0.36%
递延所得税资产	306.54	0.83%	308.47	0.85%	312.35	0.96%	296.78	0.98%
其他非流动资产	759.07	2.07%	257.30	0.71%	-	-	898.07	2.95%
非流动资产合计	12,552.21	34.17%	12,889.78	35.46%	13,508.43	41.70%	12,865.04	42.29%
资产总计	36,732.63	100.00%	36,354.47	100.00%	32,392.79	100.00%	30,418.97	100.00%

报告期，公司发展迅速，资产总额稳定增长，从2011年末的30,418.96万元增长到2014年6月末的36,732.63万元，公司资产规模增长与公司发展及销售增长水平相适合。

报告期，由于公司通过生产经营实现了较好的盈利并转化为现金，伴随着

固定资产折旧摊销，公司资产结构中，流动资产占比呈上升趋势，非流动资产占比呈下降的趋势。



2、流动资产质量分析

公司流动资产构成及变化如下：



报告期，公司流动资产主要为货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、存货和其他流动资产。

(1) 货币资金

报告期内，公司实现了较好的盈利成为公司良好的现金来源。2011-2013

年公司货币资金余额占总资产比例逐年增加；2014年6月末资金余额占总资产比例为27.98%，较2013年末略有下滑，主要系2014年上半年现金分红3,500万元。货币资金的增加符合公司现阶段盈利能力强、发展迅速的特点。

公司一直秉承稳健的经营作风，尤其是2008年来，国际经济环境不确定性因素增多，公司为应对各种不确定因素的影响，需要保持适当的预防性现金持有量。总体而言，公司货币资金余额适合公司的经营发展。

(2) 应收票据

报告期各期末，公司应收票据余额分别为1,891.37万元、1,813.80万元、3,121.80万元和3,311.25万元。公司的应收票据均为银行承兑汇票，不存在商业承兑汇票，均具备真实交易背景。

公司允许信誉良好的客户使用银行承兑票据结算以提高结算效率，应收票据余额的变化主要由公司当期收到的票据未到期情况及公司将该等票据用于支付结算时背书的情况决定。银行承兑汇具有良好的保证基础，公司应收票据款项质量良，各期内均按能按期收款，不存在票据违约的情况。

(3) 应收账款

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为3,487.63万元、3,715.12万元、5,264.05万元和5,898.81万元。公司应收账款中，2013年末较2012年末增加1,548.93万元，主要系公司2013年下半年销售增加导致的自然增长较快。截止2014年6月30日，公司应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

①应收账款账龄分析

单位：万元

账龄	2014/6/30	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
1年以内	6,447.66	5,838.33	4,168.41	3,833.62
1-2年	133.12	9.56	13.83	47.69
2-3年	5.45	5.72	39.95	7.98

3年以上	116.32	114.59	105.99	101.22
合计	6,702.55	5,968.20	4,328.17	3,990.52

公司主营产品为中高端功率半导体芯片及器件，主要客户具有良好的经济实力和基础，报告期各期末，公司应收账款余额主要为正常信用期内的交易余额，应收账款余额正常，质量较好。账龄在1年以内的应收账款占总额的比例分别为96.07%、96.16%、97.82%和96.20%，不存在账龄较长的大额应收账款。

②坏账计提情况

单位：万元

账龄	2014/6/30			
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	6,447.66	96.20	644.77	10
1-2年	133.12	1.99	39.93	30
2-3年	5.45	0.08	2.73	50
3年以上	116.32	1.73	116.32	100
合计	6,702.55	100.00	803.75	11.99
账龄	2013/12/31			
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	5,838.33	97.82	583.83	10
1-2年	9.56	0.16	2.87	30
2-3年	5.72	0.1	2.86	50
3年以上	114.59	1.92	114.59	100
合计	5,968.20	100	704.15	11.8
账龄	2012/12/31			
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	4,003.16	96.16	400.32	10
1-2年	13.83	0.33	4.15	30
2-3年	39.95	0.96	19.97	50

3年以上	105.99	2.55	105.99	100
合计	4,162.93	100	530.43	12.74
账龄	2011/12/31			
	账面余额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	3,833.62	96.07	383.36	10
1-2年	47.69	1.19	14.31	30
2-3年	7.98	0.2	3.99	50
3年以上	101.22	2.54	101.22	100
合计	3,990.52	100	502.88	12.6

公司应坏账准备计提政策参见本节之“四、主要会计政策和会计估计之(三)应收款项”。公司严格按照相关政策计提了应收账款坏账准备,报告期内,公司不存在大额冲销额应收款项的情形,公司坏账准备计提充足。

③截止 2014 年 6 月 30 日,公司应收账款金额前五名单位情况如下:

单位: 万元

单位名称	金额	占应收账款 总额比例%	2014年1-6 月销售收入	2013年度 销售收入
浙江正泰电器股份有限公司	390.12	5.82	559.40	158.97
上海田贯电子科技有限公司	367.82	5.49	355.48	503.57
深圳市槟城电子有限公司	322.08	4.81	603.64	614.16
厦门泰格微电子科技有限公司	302.50	4.51	207.72	413.07
深圳市国王科技有限公司	298.11	4.44	383.23	813.67
合计	1,680.63	25.07	2,109.48	2,503.44

2014年6月末公司应收款前五名单位主要为公司长期合作中的重要客户,与公司合作关系良好,款项均为正常销售货款,账龄在1年以内。上述客户与发行人除正常业务外无其他关系,与发行人、发行人的股东、发行人的实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和发行人的其他关联方(包括发行人的关联方)不存在关联关系。

上述客户中浙江正泰电器股份有限公司为公司 2013 年内新增的客户，2013 年度和 2014 年 1-6 月公司对其销售 158.97 万元、559.40 万元。

浙江正泰电器股份有限公司为上海证券交易所上市公司，股票代码：601877，注册资本 10.1 亿，2013 年度销售收入为 120 亿，具有较强的资本实力及较好的资信，相关应收款项安全。

④公司坏账准备政策与可以上市公司比较情况

公司管理层秉承稳健的经营作风，制定稳健的坏账计提政策并按账龄计提了应收款项的减值准备。公司坏账准备计提比例与可比上市公司比较如下：

单位：%

公司名称	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
长电科技	5	10	20	50	50	100
通富微电	5	15	50	100	100	100
华天科技	5	10	30	50	80	100
晶方科技	2	10	30	50	50	100
杨杰科技	5	10	50	100	100	100
台基股份	5	10	30	50	50	100
华微电子	2	5	10	50	50	90
士兰微	5	10	30	100	100	100
可比公司平均值	4.25	10	31.25	68.75	72.5	98.75
捷捷微电	10	30	50	100	100	100

注：上市公司数据来源于已公开 2013 年财务报告。

上表可见，公司应收账款按账龄计提比例与行业内上市公司相比更为稳健，体现了公司应收账款良好的质量和管理层稳健的作风。

（4）预付账款

报告期各期末，公司预付账款余额为 164.93 万元、145.03 万、101.32 万元和 58.42 万元。公司预付账款余额主要为一年以内的款项，截止 2014 年 6 月

30日，公司预付账款单位与发行人除正常业务外无其他关系，与发行人、发行人的股东、发行人的实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和发行人的其他关联方（包括发行人的关联方）不存在关联关系。报告期各年末，公司预付账款均为正常业务结算款项，不存在坏账的情况。

（5）存货

报告期各期末，公司存货余额分别为 3,543.83 万元、4,002.57 万元、4,150.54 万元和 4,631.86 万元，公司存货逐年增加，存货占资产总额的比例保持在 12%左右，较为稳定，存货规模的增长与公司的销售规模的增长情况相匹配。公司存货具体构成如下：

单位：万元

项目	2014/6/30		2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	770.91	16.64%	672.55	16.20%	615.64	15.38%	1,000.40	28.23%
在产品	2,598.74	56.11%	2,333.01	56.21%	2,204.63	55.08%	1,637.87	46.22%
库存商品	844.68	18.24%	625.97	15.08%	850.75	21.26%	576.8	16.28%
发出商品	233.45	5.04%	379.22	9.14%	210.33	5.25%	189.1	5.34%
委托加工物资	10.39	0.22%	-	0.00%	0.62	0.02%	9.9	0.28%
周转材料	173.69	3.75%	139.8	3.37%	120.59	3.01%	129.76	3.66%
合计	4,631.86	100.00%	4,150.54	100.00%	4,002.57	100.00%	3,543.83	100.00%

公司的存货主要为原材料、在产品、库存商品和发出商品，上述项目余额的增加主要与销售规模增加有关，由于产品生产周期长、品种规格多，需要提前备货生产。

项目	2014/6/30	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
存货	4,631.86	4,150.54	4,002.57	3,543.83
营业收入	10,722.27	19,453.78	17,249.74	17,031.74
占比	43.20%	21.34%	23.20%	20.81%

目前公司产品深受客户认可，公司具有较强的自主定价能力，报告期内保

持了较高的毛利率水平，截至 2014 年 6 月 30 日，发行人的存货主要为原材料、在产品和库存商品，均为正常生产及其日常备货所需，目前产品销售价格稳定，不存在减值迹象，无需计提存货减值准备。

2013 年存货减值准备计提与可比上市公司比较情况

公司	存货原值	存货减值准备	计提比例	综合毛利率
长电科技	63,153.66	316.12	0.50%	19.80%
通富微电	25,932.95	981.98	3.79%	16.58%
华天科技	28,553.97	210.55	0.74%	21.53%
晶方科技	3,582.49	-	-	56.28%
扬杰科技	7,687.74	151.21	1.97%	33.06%
台基股份	8,218.21	61.45	0.75%	33.95%
华微电子	25,060.93	2,219.89	8.86%	21.42%
士兰微	54,374.06	2,911.54	5.35%	26.02%
平均值	216,564.01	6,852.74	3.16%	28.58%
捷捷微电	4,542.29	-	-	51.31%

上表可见，毛利率水平越高，存货减值的可能性越小。综合毛利率高于平均值的公司中，晶方科技毛利率为 56.28%，其存货未计提减值准备，扬杰科技和台基股份综合毛利率也相对较高，其存货计提的减值准备比例也较小。发行人 2013 年综合毛利率为 51.31%，其存货减值的可能性较小，其存货减值准备计提情况合理。

(6) 其他流动资产

2011 年 12 月 31 日，发行人的其他流动资产为 407.11 万元，主要是公司于 2011 年 8 月 2 日经批准取得国家高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司自 2011 年 1 税收优惠月 1 日起按 15% 的税率征收企业所得税。由于 2011 年前 3 个季度，公司按 25% 计提和预缴所得税费用，2011 年 4 季度，发行人获得了高新技术企业资质认定，并经税务备案认可，公司自 2011 年起执行 15% 缴纳所得税，形成 2011 年末公司多缴所得税 407.11 万元。

发行人于 2012 年 6 月 1 日收到了汇算清缴后的退库款，收款后发行人不存在可列报于报表中其他流动资产的项目，因此，发行人 2012 年末无其他流动资产。

3、非流动资产质量分析

报告期，公司非流动资产主要为固定资产、在建工程、无形资产和递延所得税资产。

(1) 固定资产

报告期各期末，公司固定资产余额为 11,373.92 万元、10,508.46 万元、11,019.29 万元和 9,924.90 万元。

报告期内，发行人固定资产各项目原值情况如下表：

单位：万元

项目	2014/6/30	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
房屋及建筑物	2,393.22	2,393.22	2,372.94	2,304.52
机器设备	15,764.67	15,652.37	13,350.54	12,879.91
运输工具	278.13	273.42	260.27	143.88
办公设备及其他	584.15	569.80	485.67	150.02
固定资产原值	19,020.17	18,888.80	16,469.42	15,478.32

报告期内，发行人固定资产净值构成情况如下表：

单位：万元

项目	2014/6/30		2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	金额	金额	比例	金额	比例	金额	比例
房屋及建筑物	1,921.81	19.36%	1,976.18	17.93%	2,091.34	19.90%	2,134.29	18.76%
机器设备	7,594.06	76.52%	8,589.89	77.95%	7,934.60	75.51%	9,084.79	79.87%
运输工具	136.56	1.38%	126.7	1.15%	142.5	1.36%	64.39	0.57%
办公设备及其他	272.46	2.75%	326.51	2.96%	340.02	3.24%	90.44	0.80%

净值合计	9,924.90	100.00%	11,019.29	100.00%	10,508.46	100.00%	11,373.92	100.00%
------	----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------

公司固定资产主要为生产厂房及机器设备等生产性固定资产，占公司固定资产总额的 95%以上，发行人主营中高端功率半导体芯片及器件，产品生产需要配置价值较高的先进生产设备，因此，报告期公司固定资产中机器设备的比重相对较高。

公司属于半导体芯片及器件制造行业，行业及公司生产经营的特点决定了公司固定资产中设备更新快比重高的特点，公司根据固定资产实际使用情况制定了较为稳健的固定资产折旧年限，公司针对不同类型设备采用 3-10 年折旧年限。报告期各期末公司固定资产成新率分别为 73.48%、63.81%、58.34%和 52.18%。

报告期，发行人生产经营情况较好，资产的正常运转形成了公司报告期内的净利润 6,030.83 万元、6,171.90 万元、6,623.72 万元和 3,682.69 万元。公司资产盈利性较好，公司制定了严格的固定资产管理制度和合理的折旧政策，固定资产不存在公允价值低于账面价值或其他可能导致固定资产出现资产减值的迹象。

2013 年公司固定资产折旧政策与可比上市公司比较情况如下：

项目	捷捷 微电	长电 科技	通富 微电	华天 科技	晶方 科技	杨杰 科技	台基 股份	华微 电子	士兰微
预计使用年限(年)									
房屋及建筑物	20	20~30	25	10~25	20~40	20	20	35	30~35
机器设备	3-10								
运输工具	4~5	10~12	8	8~10	5~12	5~10	10	10	5~10
办公设备及其他	5-10	5~8	5	5~10	5~10	4	10	10	5
预计净残值(%)									
房屋及建筑物	5	4	10	3	10	5	10	3	5
机器设备	5	4	10	3	10	5	10	3	5
运输工具	5	4	10	3	10	5	10	3	5
办公设备及其他	5	4			10		10	3	5

年折旧率(%)									
房屋及建筑物	4.75	3.20~4.80	3.6	3.88~9.70	2.25~4.50	4.75	4.5	2.77	2.71~3.17
机器设备	9.50~31.67								
运输工具	19.00~23.75	12~19.20	11.25	9.70~12.13	7.50~18.0	9.50~19	9	9.7	9.50~19.0
办公设备及其他	9.5~19								

注：上市公司数据来源于已公开的 2013 年财务报告。

上表可见，公司固定资产折旧政策较为稳健，符合公司管理层一贯稳健作风。

(2) 在建工程

报告期，发行人在建工程余额如下：

单位：万元

项目	2014/6/30	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
安装工程-设备	404.75	258.54	1,665.40	175.73
其他	129.98	60.14	15.7	10.7
合计	534.73	318.68	1,681.10	186.43

公司重大在建工程项目构成及变化情况如下：

单位：万元

工程名称	2013/12/31	本期增加数	本期转入固定资产数	2014/6/30
设备安装工程	258.54	146.21	-	404.75
其他	60.14	69.83	-	129.98
合计	318.68	216.05	-	534.73
工程名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
设备安装工程	-	-	-	自有资金
其他	-	-	-	自有资金

合计	-	-	-	
----	---	---	---	--

公司制定了符合企业会计准则规定的在建工程归集方法，并严格按照相关方法归集核算在建工程支出情况，报告期内在建工程的成本归集不包含与该项目无关的支出。

(3) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 109.85 万元、1,006.53 万元、986.04 万元和 1,026.98 万元。公司无形资产主要为土地使用权，为了实施募投项目的建设，公司于 2012 年 3 月 7 取得了启国用 2012 第 0080 号土地使用权证。

单位：万元

类别	初始金额	摊余价值	剩余年限	摊销年限 (年)	摊销方 法
土地使用权(募投项目用地)	912.83	870.44	47.92	50.25	直线法
土地使用权	127.93	99.00	38.50	49.75	直线法
合计	1,040.76	969.44	-	-	

除此以外，公司还拥有多项专利技术和非专利技术等无形资产，公司的研发投入按企业会计准则要求均已费用化，未形成账面无形资产。详见本招股说明书之“第六节 业务和技术”。

(4) 递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产余额为 296.78 万元、312.35 万元、308.47 万元和 306.54 万元。公司递延所得税资产主要由应收款项按账龄计提的减值准备、应付职工薪酬以及与资产相关的政府补助项目，账面价值与计税基础差异形成的可抵扣差异。

报告期，公司已确认的递延所得税资产如下：

单位：万元

项 目	2014/6/30	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
资产减值准备	121.07	106.06	92.41	75.56
应付职工薪酬	97.14	94.79	72.07	56.15
政府补助	88.33	107.61	147.87	165.07
合 计	306.54	308.47	312.35	296.78

引起递延所得税资产的暂时性差异项目：

项 目	2014/6/30	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
资产减值准备	807.10	707.09	616.08	503.76
应付职工薪酬	647.57	631.94	480.45	374.32
政府补助	588.89	717.42	985.79	1,100.45
合 计	2,043.57	2,056.44	2,082.33	1,978.53

报告期，公司实现了较好的盈利水平，公司具有较好的盈利能力，管理层估计未来期间公司能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异，从而在报告期末确认了暂时性差异项目的递延所得税资产。

(5) 其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产余额为 898.07 万元、0 万元、257.30 万元和 759.07 万元。报告期内，公司其他非流动负债主要为预付土地使用权购买款和预付设备款项。

4、资产减值准备分析

报告期，发行人的资产减值准备计提余额如下表：

单位：万元

项目	2014/6/30	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
坏账准备	807.10	707.09	616.08	503.76
存货跌价准备	-	-	-	-
固定资产减值准备	-	-	-	-
合计	807.10	707.09	616.08	503.76

报告期，本公司的资产减值准备均为应收款项按账龄计提的坏账准备，坏账准备的规模及变动情况主要取决于应收款项的规模及其账龄情况，详见本节之“十一、财务状况分析”之“（二）资产分析”之“1、资产构成情况分析”之“（3）应收账款”。

本公司按照稳健性原则，根据公司业务和资产的实际状况，制定了合理的资产减值准备计提政策。本公司对各类资产的减值情况进行审慎核查，主要资产的账面价值与资产质量实际状况相符，不存在因资产减值准备提取不足而影响公司持续经营能力的情形。

发行人管理层认为：公司资产结构合理，整体资产优良，资产减值准备计提符合资产的实际状况，计提减值准备足额、合理。

5、资产营运能力分析

报告期发行人应收账款周转率、存货周转率的指标如下表：

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
应收账款周转率(次/年)	1.92	4.33	4.79	5.50
存货周转率(次/年)	1.16	2.32	2.12	2.75

报告期内，发行人应收账款周转率分别为 5.50、4.79、4.33 和 1.92。发行人的应收款项的结算周期通常在 60-90 天，报告期内发行人收款情况良好，大部分的应收款项账龄均在 1 年以内，4-5 次的应收账款周转率符合发行人应收实际结算情况。上表中，发行人 2014 年 1-6 月周转率相对较低，主要是由于 2013 年下半年来，行业逐渐复苏，销售情况好转，销售增长形成的应收款增加。

报告期内，发行人的存货周转率为 2.75、2.12、2.32 和 1.16，发行人的存货周转率主要与产品生产周期及生产备料和销售备货情况有关。通常情况，发行人芯片的生产周期为 2-3 个月，而将芯片封装为器件的生产周期约为 1 周左右，另外还需要各备 1 个月左右的生产用料和销售备货，因此，发行人从材料至实现销售 5-6 个月的周转时间对应发行人的 2-3 次的存货周转率符合发行人实际生产经营情况。报告期内，发行人存货周转率相对稳定且保持在较好的水平的存货周转率反映了公司良好的生产效率以及快速实现销货的能力。

与同行业可比上市公司比较，2013 年公司经营效率指标情况如下：

公司	应收账款周转率(次/年)	存货周转率(次/年)
长电科技	9.59	6.71
通富微电	5.32	6.17
华天科技	6.67	8.18
晶方科技	9.54	7.45
扬杰科技	3.59	5.85
台基股份	6.13	1.65
华微电子	4.28	4.00
士兰微	3.91	2.46
平均值	6.13	5.31
捷捷微电	4.33	2.32

可比公司数据来源:WIND。

上表分析可见，发行人的应收账款周转率和存货周转率低于行业可比上市公司平均水平。主要是由于上述公司具体主营业务的差异，其中封装业务生产周期较短，剔除主要以封装业务为主业的长电科技、通富微电、华天科技及晶方科技，2013 年度扬杰科技、台基股份、华微电子、士兰微的平均应收账款周转率和存货周转率分别为 4.48 和 3.49，与发行人 2013 年应收账款周转率和存货周转率较为接近，发行人 2013 年存货周转率略低与上述四家公司平均水平，主要是由于发行人专注于功率半导体芯片和器件，并将自产芯片用于封装器件后对外销售，生产链的延长降低了存货周转率，但实现了价值链的延伸，获取更多的毛利空间。

发行人管理层认为：公司应收账款、存货周转率情况符合公司所处行业的特征及公司处于快速发展时期的业务特点，是公司为顺应市场发展的需要，积极开拓新兴市场，适度调整经营策略所致。公司通过制定应收账款和存货的相关内部控制制度等方式来加强应收账款和存货的管理，合理控制经营风险。

（三）负债及偿债能力分析

1、负债构成及变化情况

报告期内发行人主要负债构成情况如下表：

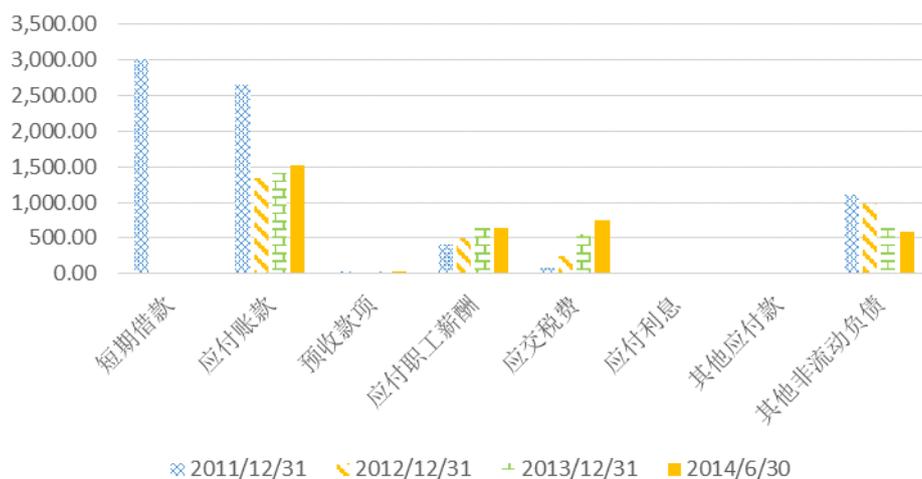
单位：万元

项目	2014/6/30		2013/12/31		2012/12/31		2011/12/31	
	金额	金额	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	-	-	-	-	-	-	3,000.00	41.21%
应付账款	1,525.40	42.92%	1,415.74	42.15%	1,332.92	43.26%	2,648.47	36.39%
预收款项	29.07	0.82%	38.21	1.14%	21.92	0.71%	35.68	0.49%
应付职工薪酬	648.28	18.24%	634.28	18.88%	492.07	15.97%	400.87	5.51%
应交税费	757.70	21.32%	548.22	16.32%	248.2	8.06%	86.9	1.19%
应付利息	-	-	-	-	-	-	6.61	0.09%
其他应付款	5.00	0.14%	5	0.15%	-	-	-	-
流动负债合计	2,965.45	83.43%	2,641.45	78.64%	2,095.11	68.00%	6,178.53	84.88%
其他非流动负债	588.89	16.57%	717.42	21.36%	985.79	32.00%	1,100.45	15.12%
非流动负债合计	588.89	16.57%	717.42	21.36%	985.79	32.00%	1,100.45	15.12%
负债合计	3,554.34	100.00%	3,358.87	100.00%	3,080.90	100.00%	7,278.98	100.00%

报告期，公司的负债主要为流动负债，与公司资产的流动性较高的特性相吻合。

报告期公司的负债结构及变化如下：

负债构成及变化



公司负债主要为短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费和其他非流动负债。

2、负债分析

(1) 短期借款

单位：万元

类别	2014/6/30	2013/12/31	2012/12/31	2009.12.31
抵押借款	-	-	-	-
信用借款	-	-	-	3,000.00
合计	-	-	-	3,000.00

报告期公司的短期借款情况如下：

单位：万元

借款银行	用途	借款金额	借款期限	合同签订日期	年利率	借款人
江苏银行股份有限公司启东支行	流动资产	500	2010.02.03- 2011.02.02	2010.2.3	5.841%	发行人
江苏银行股份有限公司启东支行	流动资产	3000	2010.11.9- 2011.11.8	2010.11.9	6.116%	发行人

江苏银行股份有 限公司启东支行	流动资产	1000	2011.3.2- 2011.11.7	2011.3.2	6.666%	发行人
江苏银行股份有 限公司启东支行	流动资产	3000*	2011.12.19- 2012.11.29	2011.12.19	7.216%	发行人

*注：公司于 2012 年 1 月偿还了江苏银行股份有限公司启东支行 3,000 万元银行借款。

报告期，公司加强资金管理，以保障公司信誉为原则，严格按照合同约定的付款政策支付货款，适当运用银行贷款用于短期资金周转，保持并逐步获得银行授信额度，确保银行借款渠道的畅通以备短期资金周转。

（2）应付账款

报告期各期末，公司应付账款余额为 2,648.47 万元、1,332.92 万元、1,415.74 万元和 1,525.40 万元，公司应付账款余额主要与公司的采购活动有关。2014 年 6 月末公司的应付账款主要为材料采购款和设备采购款，主要应付账款均在正常信用期内，公司不存在延期支付的款项。

截止 2014 年 6 月 30 日，公司应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

公司应付账款金额前五名单位情况如下：

单位：万元

单位名称	关系	款项性质	期末金额	时间	备注
泰州东田电子有限公司	非关联方	货款	275.09	一年以内	
中国电子科技集团公司第四十六研究所	非关联方	货款	152.59	一年以内	
臻美国际有限公司	非关联方	设备款	98.31	三年以上	注 1
江阴市化学试剂厂有限公司	非关联方	货款	66.12	一年以内	
ASMPACIFIC(HONGKONG)LIMITED	非关联方	设备款	59.31	一年以内	
合计	—		651.42	—	—

注 1：发行人 2008 年 1 月 3 日与臻美国际有限公司签定购买一台“LPCVD 低压化学

气相沉积系统”合同，合同总价 196.61 万元。2008 年 1 月 7 日，发行人支付臻美国际有限公司预付款 98.31 万元，该设备于 2008 年 9 月 19 日运达公司，经检验臻美国际有限公司所交付的设备存在部件不全、配置与技术协议不符的情况，发行人针对合同不符事项及时与对方进行沟通协商并多次催促臻美国际有限公司落实该设备安装、调试等事项未果，因生产需要发行人按合同支付了臻美国际有限公司的 50%款项，其余款项停止支付，自行购买所缺部件，并安排设备安装调试，对不符合技术要求之处进行了整改。

该设备经发行人自行安装、调试、整改后运行正常，于 2009 年 10 月 30 日转入固定资产。由于当时臻美国际有限公司已全额开具了发票，后续的处理中又未及时出具相关证明文件，发行人出于谨慎原则，对该项采购已作为应付账款处理。该笔款项发生至今已有三年，臻美国际有限公司未按合同履行在先，对发行人的付款也未提出过异议，该应付款项不存在争议，合同事项已超过诉讼保护时效，发行人不存在因上述行为而现实或潜在的经济损失。

(4) 应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额为 400.87 万元、492.07 万元、634.28 万元和 648.28 万元，应付职工薪酬主要为工资薪金项目，上述项目的计提与实际发放存在一定的时间差异从而形成账面余额，公司不存在拖欠员工薪金的情形。

(5) 应交税费

报告期各期末，公司应交税费余额为 86.90 万元、248.20 万元、548.22 万元和 757.70 万元，公司应交税费主要为增值税和所得税项目，报告期公司不存在税务违规或延期缴税的情形。

(6) 其他流动负债

报告期，公司其他流动负债均为与资产相关的政府补助项目。具体情况如下：

单位：万元

项目	2014/6/30	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
江苏省自主创新和产业升级专项引	7.88	21.81	54.43	126.00

导资金				
国家发改委及工信部关于电子信息产业振兴和技术改造项目专项拨款	238.50	285.54	382.31	400.00
电子信息产业振兴和技术改造项目专项拨款地方配套项目资金	342.52	410.07	549.05	574.45
合计	588.89	717.42	985.79	1,100.45

3、偿债能力分析

财务指标	2014/6/30	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
流动比率(倍)	8.15	8.88	9.01	2.84
速动比率(倍)	6.59	7.31	7.10	2.27
资产负债率	9.68%	9.24%	9.51%	23.93%
财务指标	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
息税折旧摊销前利润(万元)	5,600.81	9,883.70	9,175.48	8,626.17
利息保障倍数(倍)	-	-	3,814.64	191.98

公司实行稳健的资金安排策略，合理安排债务规模。2014年6月末负债主要集中在应付账款、应付职工薪酬、应交税费和其他非流动负债，其中，其他流动负债588.89万元占公司负债总额的16.57%，为与资产相关的政府补助项目，不需要实际偿付。公司需要实际偿付的负债主要来源于公司业务往来中的经营性负债，经营性负债与公司业务发展及采购情况相适应，对于经营性负债的偿付公司拥有良好的业务基础，公司具有较强的短期偿债能力。对于银行借款，近年来经过多轮加息后，银行借款成本较高，公司尽量减少借款额度的使用，有效降低资金成本。与此同时，公司也与银行保持良好的关系以获得必要的银行授信额度，为公司未来资金需求提供一定的保障。

报告期，公司管理层一贯秉承稳健的经营作风，保持银行授信额度，同时为树立业内良好的品牌形象，公司在支付结算中，加强采购付款的管理，严格按照采购合同约定的期限内支付款项，杜绝有损公司信誉的情况发生，公司及时付款和严格履约的风格已在业内形成了良好的口碑。

2011年至2014年6月末，公司的流动比率、速动比率变化趋好，公司流动资产超额覆盖流动负债，公司具有较好的短期偿债能力，同时，报告期，随着公司盈利水平的实现，公司资产负债率逐年降低，公司具有较强的长期偿债能力，财务风险较小。

2013年公司的流动比率和速动比率与可比上市公司比较情况如下：

公司简称	流动比率	速动比率	资产负债率 (%)
长电科技	0.63	0.47	65.18
通富微电	1.32	1.09	38.80
华天科技	1.89	1.52	44.56
晶方科技	1.86	1.67	29.26
扬杰科技	2.39	1.84	27.16
台基股份	9.96	8.79	8.54
华微电子	1.63	1.43	43.94
士兰微	2.28	1.79	44.97
平均值	2.75	2.33	37.80
捷捷微电	8.88	7.31	9.24

可比公司数据来源:WIND。

上表可见，公司流动比率及速度比率明显高于可比上市公司，资产负债率明显低于可比上市公司平均水平，公司具有较强的抗风险能力。

从息税折旧摊销前利润指标来看，2011年至2013末，公司息税折旧摊销前利润分别为8,626.17万元、9,175.48万元和9,883.70万元，保持了稳定增长的趋势，不断增强公司偿债保障能力。

报告期，公司不存在对正常生产、经营活动有重大影响的需要披露的或有负债，也不存在重大表外融资情况。

发行人管理层认为：公司秉持稳健的财务政策，负债稳定、规模较低，资产负债率保持在良好的水平，公司偿债能力较强。随着公司进入快速发展的步伐，公司将进一步拓展外部融资渠道，优化资产负债结构和负债的期限结构，降低资

金成本，保持适当的财务杠杆比例，实现可持续发展的增长。

（四）所有者权益分析

单位：万元

股东权益	2014/6/30	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
股本（实收资本）	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
资本公积	13,454.97	13,454.97	13,454.97	13,454.97
盈余公积	1,548.06	1,548.06	885.69	268.50
未分配利润	11,175.26	10,992.57	7,971.22	2,416.51
股东权益合计	36,732.63	32,995.60	29,311.88	23,139.98

1、股本（实收资本）

报告期内，公司股本（实收资本）的变动情况如下：

（1）2011年3月23日，经公司临时股东会决议，张玉平、黎重林、颜呈祥、徐洋、陈德洲、吴家健、周榕榕、钱清友、沈怡东、沈广宇、严巧成以货币资金增加公司注册资本105万元人民币。

（2）2011年5月11日，经公司临时股东会决议，黄善兵以货币资金增加公司注册资本360万元人民币。

（3）2011年6月12日，经公司临时股东会决议，正和世通以货币资金增加公司注册资本400万元人民币。

（4）2011年8月10日，公司根据利安达验字[2011]第1070号验资报告将截止2011年7月31日经审计的净资产181,449,719.79元按1：0.3692的比例折为6700万股，每股面值为人民币1元，注册资本为人民币6,700万元。

（5）2011年9月10日，经公司第二次股东大会决议，深圳创新投和红土资创投以货币资金增加公司注册资本300万元人民币。

2、资本公积

报告期内，公司资本公积变化主要是由于报告期内的增资溢价及股改转入形

成：

(1) 2011年3月23日，经公司临时股东会决议，张玉平、黎重林、颜呈祥、徐洋、陈德洲、吴家健、周榕榕、钱清友、沈怡东、沈广宇、严巧成以货币资金增加公司注册资本105万元人民币，实际出资超过注册资本金额131.25万元计入资本公积。

(2) 2011年6月12日，经公司临时股东会决议，正和世通以货币资金增加公司注册资本400万元人民币，实际出资超过注册资本金额1,600万元计入资本公积。

(3) 2011年8月25日，公司根据利安达验字[2011]第1070号验资报告将截止2011年7月31日经审计的净资产181,449,719.79元按1: 0.3692的比例折为6700万股后，折股后溢价部分114,449,719.79元转作公司的资本公积。

(4) 2011年9月10日，经公司第二次股东大会决议，深圳创新和红土资本以货币资金增加公司注册资本300万元人民币，实际出资超过注册资本金额2010万元计入资本公积。

3、盈余公积

报告期，公司按照税后利润的10%计提法定盈余公积，2011年8月25日，因公司整体改制为股份有限公司将改制前的全部法定盈余公积转入资本公积。

4、未分配利润

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
期初未分配利润	10,992.57	7,971.22	2,416.51	4,376.55
加：本期利润转入	3,682.69	6,623.72	6,171.90	6,030.83
减：提取法定盈余公积	-	662.37	617.19	268.50
减：应付普通股股利	3,500.00	2,940.00	-	-
减：其他（股改转入资本公积）	-	-	-	7,722.37
期末未分配利润	11,175.26	10,992.57	7,971.22	2,416.51

十、盈利能力分析

公司报告期内的经营业绩如下表所示：

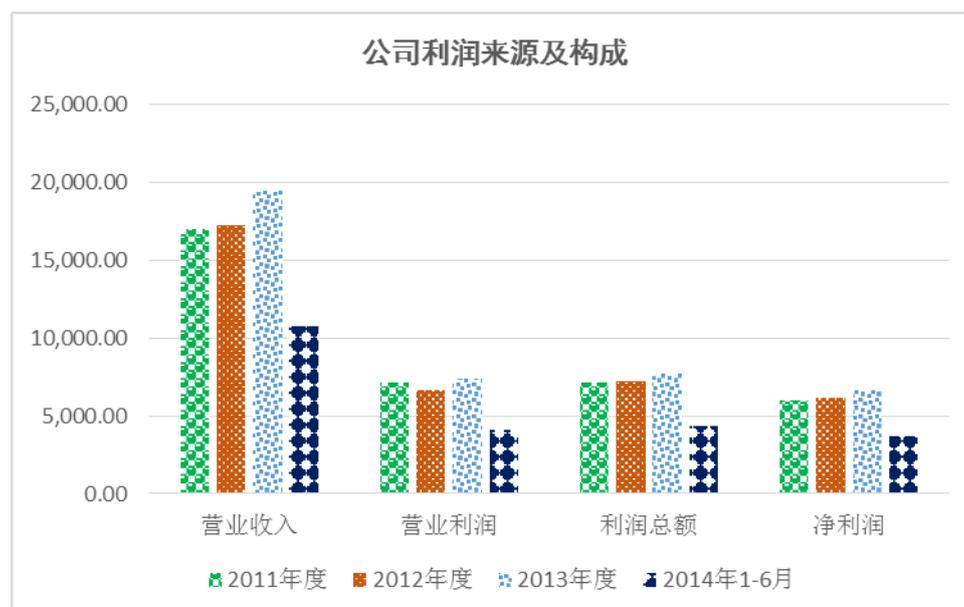
单位：万元

项 目	2014 年 1-6 月	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
		金额	同比增长	金额	同比增长	金额	同比增长
营业收入	10,722.27	19,453.78	12.78%	17,249.74	1.28%	17,031.74	30.99%
营业利润	4,092.87	7,366.63	10.43%	6,670.94	-6.61%	7,143.30	63.72%
利润总额	4,338.20	7,725.95	7.21%	7,206.37	0.94%	7,139.56	64.05%
净利润	3,682.69	6,623.72	7.32%	6,171.90	2.34%	6,030.83	71.40%

报告期内发行人经营状况保持了良好的发展态势，主要体现在：

公司主营业务突出，主要生产和销售中高端功率半导体芯片及器件，报告期内公司净利润主要来源于营业利润。营业利润占利润总额的比例为100.05%、92.57%、95.35%和94.34%。

报告期，公司营业利润、利润总额和净利润呈现平稳增长趋势。



2012 年，发行人营业收入、利润总额和净利润均较 2011 年保持平稳增长态势；2013 年，公司营业利润、利润总额和净利润分别较上年增长 10.43%、

7.21%和 7.32%，净利润与利润来源增长趋势基本一致，体现了公司主营业务的优质增长。

（一）营业收入分析

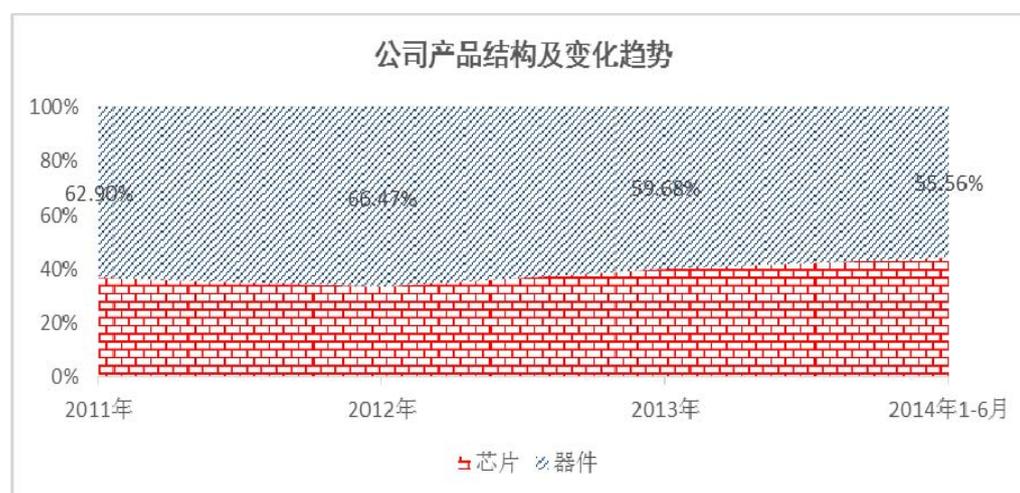
1、营业收入的构成分析

（1）营业收入分产品构成情况

单位：万元

类别		功率半导体芯片	功率半导体器件	其他	合计
2014年1-6月	收入	3,974.40	6,743.90	3.97	10,722.27
	比例	37.07%	62.90%	0.04%	100.00%
2013年度	收入	6,470.66	12,930.53	52.58	19,453.78
	比例	33.26%	66.47%	0.27%	100.00%
2012年度	收入	6,932.49	10,295.29	21.96	17,249.74
	比例	40.19%	59.68%	0.13%	100.00%
2011年度	收入	7,530.74	9,462.44	38.56	17,031.74
	比例	44.22%	55.56%	0.23%	100.00%

报告期，公司主营业务突出，营业收入中功率半导体器件产品增长较快，器件销售收入从2011年的9,462.4万元增长到2013年12,930.53万元，年复合增长10.97%。



2011年前，受限于产能限制，公司将主要力量集中于芯片研发生产销售，2011年后，随着公司产能的增加，公司加大自封装生产器件产品，通过高品质的器件产品销售，与终端电气厂商直接对话，及时响应客户需求，并能够从客户利益出发，切实解决客户在将器件用于电器生产中的技术难题，为公司树立品牌形象建立了良好的基础。

近年来，公司通过高品质的产品及高标准赢得了德力西、正泰等优质客户的认可，公司品牌形象的建立提升了公司产品的竞争力和性价比，良好的品牌形象得到了市场的认可。

(2) 按销售方式划分的营业收入

单位：万元

销售方式	2014年1-6月		2013年度		2012年度		2011年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
经销	2,680.78	25.00%	4,988.89	25.64%	4,634.78	26.87%	3,151.27	18.50%
直销	8,041.49	75.00%	14,464.89	74.36%	12,614.97	73.13%	13,880.46	81.50%
合计	10,722.27	100.00%	19,453.78	100.00%	17,249.74	100.00%	17,031.74	100.00%

发行人按照客户否为公司产品的终端用户将业务划分为直销和经销，公司经销商并非公司产品的终端用户，其从公司采购产品后再对外销售。报告期，发行人产品销售以直销为主。

(3) 按销售区域划分的营业收入

单位：万元

类别		内销收入	出口收入	合计
2014年1-6月	收入	9,616.52	1,105.75	10,722.27
	占比	89.69%	10.31%	100.00%
2013年度	收入	17,488.50	1,965.29	19,453.78
	占比	89.90%	10.10%	100.00%
2012年度	收入	15,960.67	1,289.07	17,249.74

	占比	92.53%	7.47%	100.00%
2011 年度	收入	15,946.85	1,084.89	17,031.74
	占比	93.63%	6.37%	100.00%

报告期，公司具体出口情况如下：

单位：万元

国家或地区	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年	2011 年	主要产品
西班牙	342.48	600.26	348.24	281.26	晶闸管
台湾	371.90	541.92	433.79	403.87	晶闸管
韩国	277.95	506.33	430.06	361.04	晶闸管、晶闸管芯片
德国	81.09	217.65	5.94	—	保护类芯片
日本	4.52	31.60	57.91	35.39	晶闸管芯片
香港	7.99	21.95	1.52	3.33	晶闸管
印度	18.89	34.28	5.15	—	晶闸管
美国	0.93	10.40	1.33	—	晶闸管
其他	-	0.90	10.41	—	晶闸管
合计	1,105.75	1,965.29	1,294.35	1,084.89	晶闸管

发行人出口业务采用代理出口的模式，公司具有自主定价权，出口业务主要采用人民币结算，并采用电汇的结算方式。

(4) 报告期内发行人按具体产品划分

项目	晶闸管系列		防护器件系列		其他		合计
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	
2014 年 1-6 月	8,446.81	78.78%	1,990.31	18.56%	285.15	2.66%	10,722.27
2013 年度	16,986.79	87.32%	2,172.90	11.17%	294.09	1.51%	19,453.78
2012 年度	15,696.16	90.99%	1,063.76	6.17%	489.82	2.84%	17,249.74
2011 年度	15,448.17	90.70%	618.02	3.63%	965.55	5.67%	17,031.74

发行人主营产品为晶闸管系列产品 and 防护器件系列产品，晶闸管系列产品平

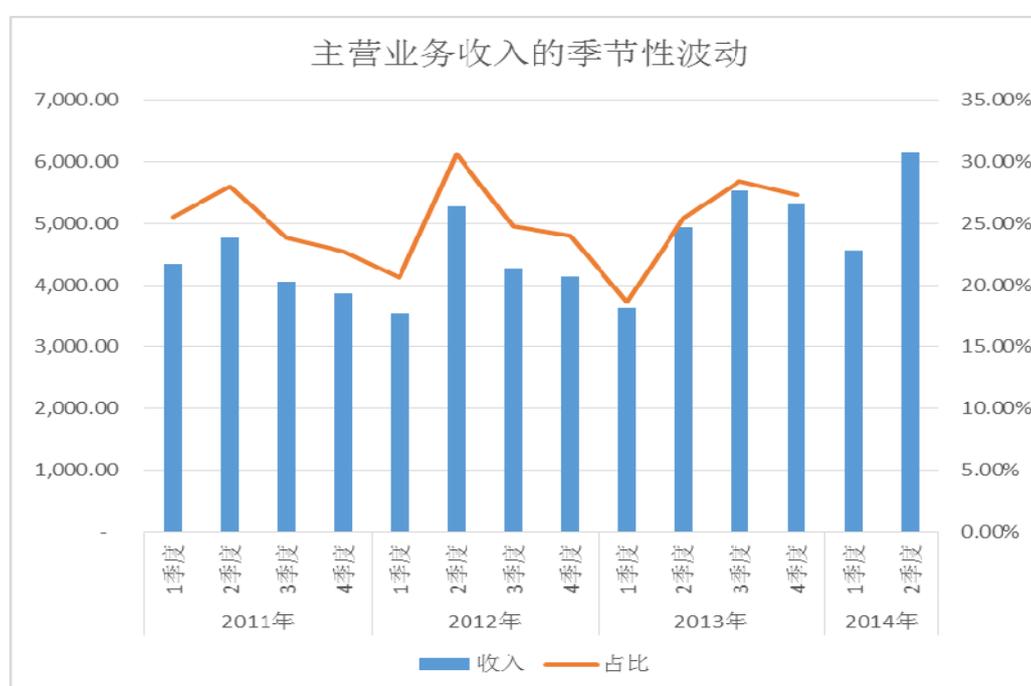
稳增长，防护器件系列产品实现快速增长点。

2、季节性波动因素分析

功率半导体分立器件作为电力电子行业的基础核心部件，它是工业化和信息化融合的重要技术手段，在电力电子技术领域的应用和市场中起着决定性的作用，广泛应用于国民经济各个工业部门和社会生活的各个方面，其发展对国民经济和国家安全领域具有重要影响。

公司下游客户主要为各类电器厂商及工业用户等，市场及产品分布广泛，单一类别客户的波动对公司业绩影响较小，公司产品销售不具有明显的周期性和季节波动性。

从公司生产情况来看，公司生产中主要原料为单晶硅和金属材料，单晶硅及金属行业经过多年的发展，目前技术成熟，供应充足，市场价格稳定。由于中国传统节日放假的因素影响，公司在每年 1、2 月份的时候，由于放假时较多，放假当月的产量会有一些的影响，但总体上来讲，客户一般都提前备货或者期后增加采购，公司产品的供需不存在明显的季节性。



3、公司营业收入增长情况分析

单位：万元

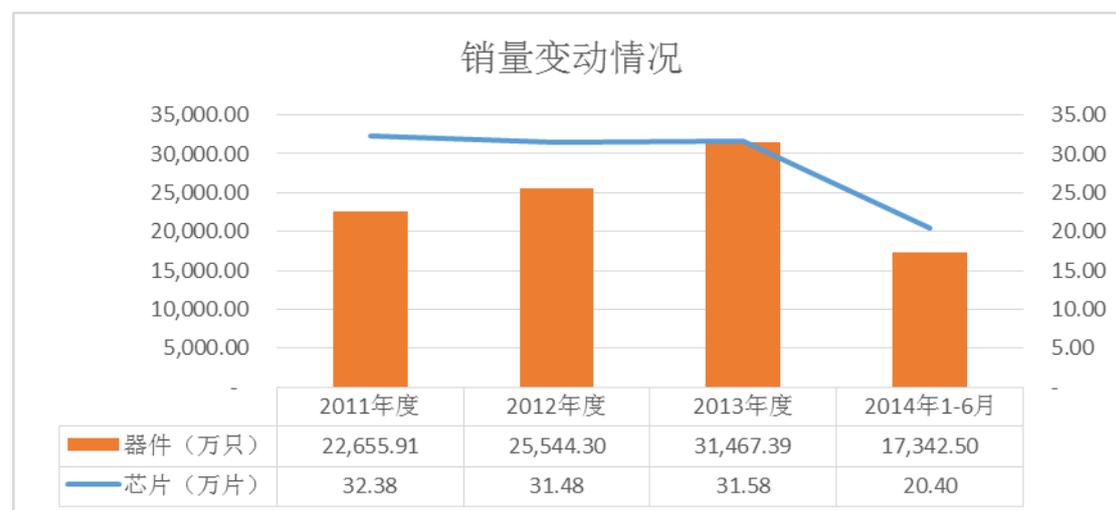
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	10,722.27	19,453.78	17,249.74	17,031.74
净利润	4,092.87	6,623.72	6,623.72	6,030.83

最近三年，发行人的营业收入稳定增长，从2011年的17,031.74万元增长到2013年的19,453.78万元；公司净利润从2011年的6,030.83万元增长到2013年的6,623.72万元。

报告期内，发行人营业收入增长的主要源于销量的增长：

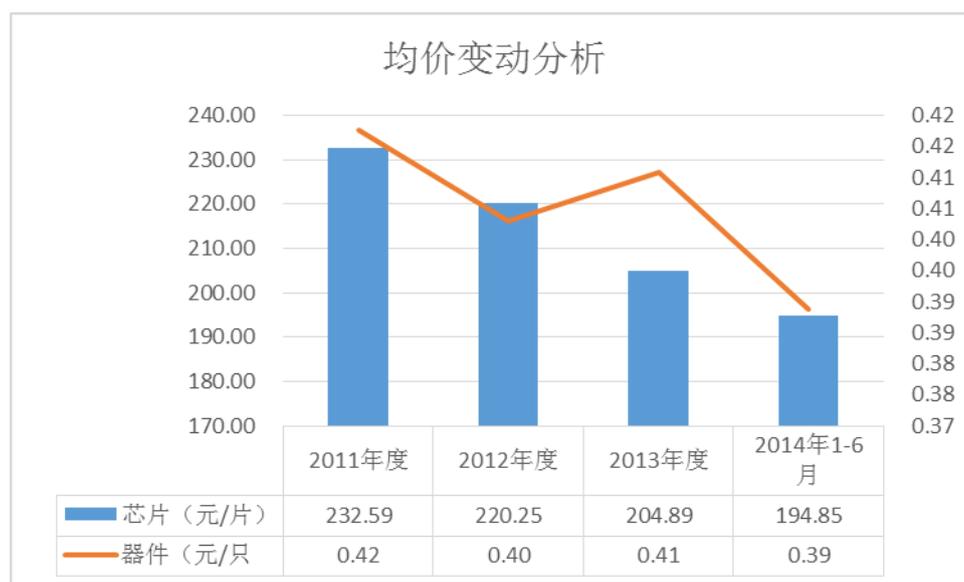
项目		2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
芯片	销量（万片）	20.40	31.58	31.48	32.38
	均价（元/片）	194.85	204.89	220.25	232.59
	销售收入（万元）	3,974.40	6,470.66	6,932.49	7,530.74
器件	销量（万只）	17,342.50	31,467.39	25,544.30	22,655.91
	均价（元/只）	0.39	0.41	0.40	0.42
	销售收入（万元）	6,743.90	12,930.53	10,295.29	9,462.44

（1）销量变动分析



报告期内，发行人为更好的服务于终端电器客户并树立品牌形象，发行人自封装器件产品产量及销量不断增加，因此，发行人销量的增长主要是器件销量的增长，发行人2012年销量较上年增长45.53%，2013年较上年增长23.19%。

(2) 销售均价的变化分析



受宏观经济波动的影响，报告期内，发行人的芯片均价及器件均价均有所下降，尤其是2012年较为明显，在此背景下，发行人通过不断的努力和技术创新，克服各种困难，不断提升产品及服务的竞争力，开拓及优化客户结构并取得了明显的成效，2012年至今，在销量迅速增长的情况下，价格下降空间收窄，逐渐趋于平稳，从而实现了营业收入的增长。

4、营业收入增长及与可比上市公司比较情分析

最近三年，发行人的营业收入增长与可比上市公司增长情况比较如下：

对比公司	2013 年度	2012 年度	2011 年度
长电科技	15.01%	17.91%	4.04%
通富微电	11.15%	-1.97%	-6.08%
华天科技	50.76%	24.01%	12.72%
晶方科技	33.53%	10.20%	13.09%
扬杰科技	16.70%	1.01%	26.21%
台基股份	-18.38%	-16.49%	20.76%
华微电子	18.27%	-3.92%	-4.34%
士兰微	21.42%	-12.74%	1.79%
行业平均	18.56%	2.25%	8.52%

捷捷微电	12.78%	1.28%	30.99%
------	--------	-------	--------

总体来看，发行人的营业收入增长趋势与可比上市公司平均变化趋势相当，各公司表现不一主要是由于主营产品构成差异，上述公司具体产品及其结构差异如下：

可比公司	产品分类	2013年		
		收入（万元）	占营业收入比例	毛利率
长电科技	芯片封测	480,456.13	94.17	19.15
	芯片	27,620.04	5.41	30.24
通富微电	集成电路封装测试	175,857.66	99.51	16.19
华天科技	集成电路产品	240,247.84	98.17	20.59
晶方科技	芯片封装	44,647.25	99.12	55.96
	设计	363.38	0.81	92.65
	其他产品	32.69	0.07	79.50
扬杰科技	功率二极管	29,400.39	55.76	29.60
	整流桥	14,378.70	27.27	33.66
	分立器件芯片	7,515.09	14.25	44.52
	其他	1,436.45	2.72	27.38
台基股份	晶闸管	15,764.03	71.62	38.12
	模块	5,831.07	26.49	20.87
	其他	245.51	1.12	31.47
华微电子	半导体器件	120,803.30	96.81	20.67
	其他	2,729.43	2.19	30.31
士兰微	器件	79,339.04	48.44	26.28
	集成电路	58,870.38	35.94	31.22
	发光二极管	24,024.60	14.67	8.79
	其他	281.54	0.17	68.93

发行人主营功率半导体器件芯片和功率半导体器件，2013年晶闸管系列产品占营业收入的87.32%，防护器件系列产品占营业收入的9.7%，从具体产品类

别类看，上述可比上市公司中，台基股份和士兰微与捷捷微电更具有可比性，但其报告期内营业收入增长表现各不相同，主要是由于产品用途广泛，不同公司拥有不同的客户及不同的应用领域，各领域受宏观经济影响程度各不相同。

发行人在市场上具有较高的品牌知名度，产品质量优异，获得客户广泛认可，营业收入逐年上升。2011年和2012年，在不利的经营环境下，针对市场需求下滑局面，发行人努力发挥品牌、技术、质量、服务及渠道优势，积极拓展功率半导体各细分市场领域，加大产品销售和技术服务力度，保持在替代进口产品方面的竞争力，报告期内产品销售额的平稳增长。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成分析

（1）营业成本分产品构成划分

单位：万元

类别		功率半导体芯片	功率半导体分立器件	其他	合计
2014年1-6月	成本	1,657.11	3,441.10	0.57	5,098.78
	比例	32.50%	67.49%	0.01%	100.00%
2013年度	成本	2,872.95	6,598.18	-	9,471.13
	比例	30.33%	69.67%	-	100.00%
2012年度	成本	2,855.68	5,143.23	-	7,998.91
	比例	35.70%	64.30%	-	100.00%
2011年度	成本	3,035.43	4,841.48	-	7,876.90
	比例	38.54%	61.46%	-	100.00%

（3）营业成本按销售方式划分

单位：万元

销售方式	2014年1-6月		2013年度		2012年度		2011年度	
	成本	占比	成本	占比	成本	占比	成本	占比
经销	1,469.14	28.81%	2,492.77	26.32%	2,492.77	31.16%	1,777.49	22.57%

直销	3,629.64	71.19%	6,978.35	73.68%	5,506.14	68.84%	6,099.41	77.43%
合计	5,098.78	100.00%	9,471.13	100.00%	7,998.91	100.00%	7,876.90	100.00%

(3) 营业成本按销售区域划分

单位：万元

成本	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
外销	517.93	916.82	636.75	522.50
内销	4,580.85	8,554.31	7,362.16	7,354.40
营业成本	5,098.78	9,471.13	7,998.91	7,876.90

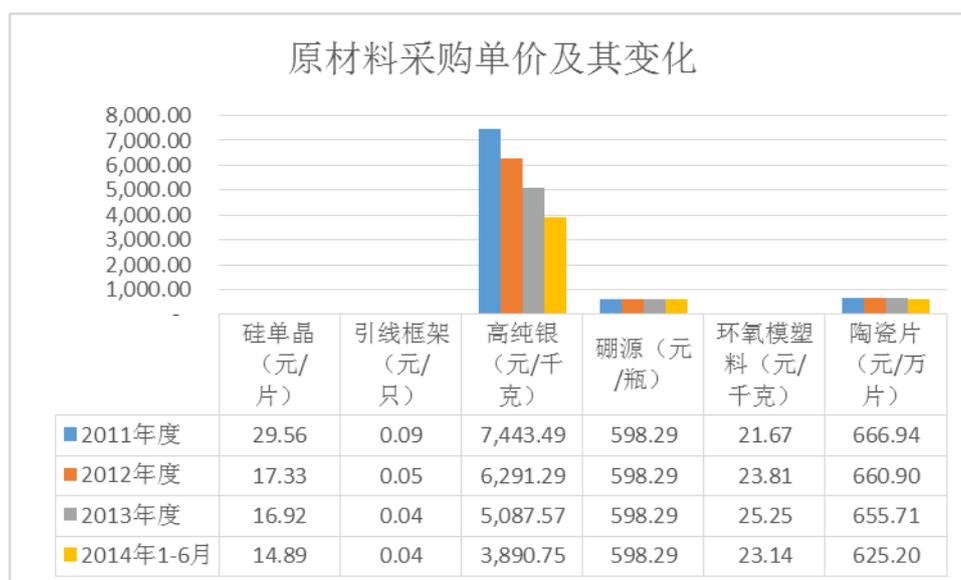
(4) 营业成本按具体产品划分

项目	晶闸管系列		保护器件系列		其他		合计
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	
2014年1-6月	4,147.52	81.34%	826.25	16.20%	125.00	2.45%	5,098.78
2013年度	8,434.21	89.05%	936.41	9.89%	100.51	1.06%	9,471.13
2012年度	7,342.99	91.80%	412.56	5.16%	243.36	3.04%	7,998.91
2011年度	7,090.46	90.02%	203.96	2.59%	582.48	7.39%	7,876.90

2、主要原材料和能源的采购数量及采购价格及其变化，以及对利润的影响

(1) 主要原材料

报告期内，发行人的主要原材料包括硅单晶、引线框架、高纯银、硼源、环氧模塑料、陶瓷片，其占发行人总采购的50%左右，报告期内主要原材料采购均价及变化如下：



上表可见，报告期内，硼源、环氧模塑料、陶瓷片单价变动较小，硅单晶和引线框架价格下降幅度较为明显，尤其是2012年下降幅度最为明显，期后下降幅度开始收窄。

发行人的主要原材料占采购总额的50%左右，在产量稳定的情况下，主要材料采购价格下降将形成公司的单位销售成本下降。报告期内，发行人产品单位成本变动情况如下：



2012年发行人单位销售成本明显下降，其后价格下降幅度收窄，与主要原材料的采购均价变化趋势相当。

(2) 主要能源

报告期内，发行人主要耗用的能源为水和电，具体情况如下：

项目		2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
电	数量（万度）	574.78	1,105.19	935.11	882.78
	金额（万元）	392.84	760.11	657.03	596.19
	平均单价（元/度）	0.68	0.69	0.7	0.68
水	数量（万吨）	9.68	16.67	13.66	13.84
	金额（万元）	47.89	82.51	67.62	69.02
	平均单价（元/吨）	4.95	4.95	4.95	4.99

报告期内，水、电的均价及耗用量较为稳定，对发行人销售成本的影响较小。

3、营业成本变化的主要原因分析

报告期内，发行人的营业成本变化情况如下：

项目		2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
芯片	销量（万片）	20.40	31.58	31.48	32.38
	单位销售成本（元/片）	81.24	90.97	90.73	93.75
	成本（万元）	1,657.11	2,872.95	2,855.68	3,035.43
器件	销量（万只）	17,342.50	31,467.39	25,544.30	22,655.91
	单位销售成本（元/只）	0.20	0.21	0.20	0.21
	成本（万元）	3,441.10	6,598.18	5,143.23	4,841.48

报告期内，发行人销量的增加形成营业成本总额的增加，单位成本的下降主要有由于材料采购成本的下降和产量增加形成的单位产品折旧摊销降低。

发行人的成本构成如下：

单位：万元

成本项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
原材料	2,519.43	5,031.82	4,395.57	5,483.50

人工	757.95	1,224.94	1,069.87	929.52
制造费用	1,821.40	3,214.37	2,533.47	1,463.89
合计	5,098.78	9,471.13	7,998.91	7,876.90

各项成本占总成本的比例如下：

成本构成(占比)	2014年1季度	2013年度	2012年度	2011年度
原材料占比	49.41%	53.13%	54.95%	69.61%
人工占比	14.87%	12.93%	13.38%	11.80%
制造费用占比	35.72%	33.94%	31.67%	18.58%
合计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

报告期，随着主要材料成本的价格下降，发行人成本中原材料占比逐年下降，制造费用及人工占比逐渐增加，规模优势在成本降低中的体现明显。

(三) 发行人毛利率及变动情况分析

1、公司的利润来源及分产品毛利率情况

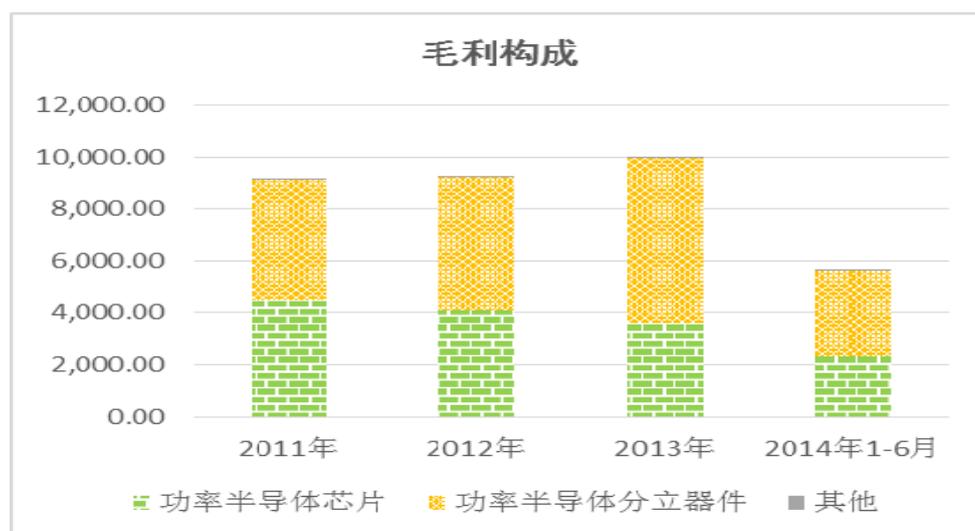
(1) 公司利润来源及毛利情况

单位：万元

类别		功率半导体芯片	功率半导体分立器件	其他	合计
2014年1-6月	毛利	2,317.29	3,302.80	3.40	5,623.49
	比重	41.21%	58.73%	0.06%	100.00%
2013年度	毛利	3,597.72	6,332.35	52.58	9,982.65
	比重	36.04%	63.43%	0.53%	100.00%
2012年度	毛利	4,076.81	5,152.06	21.96	9,250.83
	比重	44.07%	55.69%	0.24%	100.00%
2011年度	毛利	4,495.31	4,620.96	38.56	9,154.83
	比重	49.10%	50.48%	0.42%	100.00%

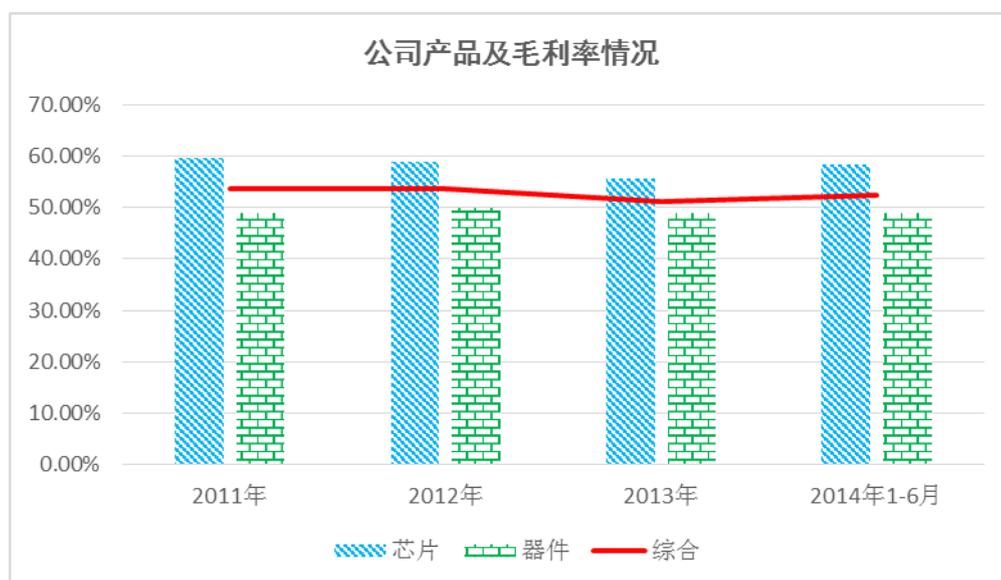
报告期，公司利润来源于功率半导体芯片及功率半导体分立器件产品。功率半导体芯片经封装后即成为功率半导体分立器件，用于生产各类电器及工业品

等。



报告期内，公司营业毛利保持稳定增长。营业毛利增长的主要原因为营业收入的增长和较为稳定的毛利率。

(2) 报告期，发行人主营业务毛利率分析



报告期，公司产品毛利率保持在 50%以上，器件毛利率相对稳定，芯片毛利率 2013 年较 2012 年略有下滑。

报告期内，发行人主营业务产品毛利率的变化趋势如下表：

单位：万元

分类	项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
----	----	-----------	--------	--------	--------

功率半导体芯片	收入	3,974.40	6,470.66	6,932.49	7,530.74
	成本	1,657.11	2,872.95	2,855.68	3,035.43
	毛利率	58.31%	55.60%	58.81%	59.69%
功率半导体分立器件	收入	6,743.90	12,930.53	10,295.29	9,462.44
	成本	3,441.10	6,598.18	5,143.23	4,841.48
	毛利率	48.97%	48.97%	50.04%	48.83%
合计	收入	10,718.30	19,401.20	17,227.78	16,993.18
	成本	5,098.21	9,471.13	7,998.91	7,876.91
	毛利率	52.43%	51.18%	53.57%	53.65%

综合毛利率水平的波动主要是产品销售均价及单位销售成本的变化幅度不一致所形成的，具体情况如下：

项目		2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
芯片	销售均价（元/片）	194.85	204.89	220.25	232.59
	销售均价变化幅度	-4.90%	-6.97%	-5.31%	-
	单位销售成本（元/片）	81.24	90.97	90.73	93.75
	单位销售成本变化幅度	-10.69%	0.27%	-3.23%	-
	毛利率	58.31%	55.60%	58.81%	59.69%
器件	销售均价（元/只）	0.39	0.41	0.40	0.42
	销售均价变化幅度	-5.37%	1.96%	-3.50%	-
	单位销售成本（元/只）	0.20	0.21	0.20	0.21
	单位销售成本变化幅度	-5.37%	4.14%	-5.78%	-
	毛利率	48.97%	48.97%	50.04%	48.83%

2013年芯片毛利率较2012年下降三个百分点主要是由于发行人芯片销售均价下滑，但同期销售成本略有上升所致。报告期内，发行人器件毛利率波动较小主要是由于销售均价和单位销售成本变动趋势和幅度相当。

2、毛利率行业比较和波动的原因分析

最近三年，发行人与可比上市公司毛利率对比情况如下表：

公司名称	毛利率 (%)		
	2011 年	2012 年	2013 年
长电科技	17.91	14.24	19.80
通富微电	13.88	14.19	16.58
华天科技	18.79	18.87	21.53
晶方科技	56.21	56.45	56.28
扬杰科技	26.05	30.90	33.06
台基股份	38.37	34.18	33.95
华微电子	29.31	22.66	21.42
士兰微	30.93	22.34	26.02
平均	28.93	26.73	25.33
捷捷微电	53.65	53.57	51.18

可比公司数据来源:WIND。

捷捷微电专业从事功率半导体分立器件的研发、设计、生产和销售，拥有以芯片制造和器件封装构成的完整业务体系。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局国民经济分类标准，属于半导体分立器件制造行业（国民经济行业分类代码：C3962）。

下述 8 家可比公司均属于半导体行业上市公司，发行人将其作为行业可比上市公司，其中长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技主要从事封装相关业务；扬杰科技、台基股份同发行人业务模式较为接近；华微电子、士兰微主营产品同发行人类似。

可比公司	产品分类	2013年			2012年			2011年		
		收入(万元)	占营业收入比例	毛利率	收入(万元)	占营业收入比例	毛利率	收入(万元)	占营业收入比例	毛利率
长电科技	芯片封测	480,456.13	94.17%	19.15%	414,840.20	93.51%	13.33%	344,293.30	91.51%	17.27%
	芯片	27,620.04	5.41%	30.24%	27,213.15	6.13%	26.16%	27,529.75	7.32%	24.45%
通富微电	集成电路封装测试	175,857.66	99.51%	16.19%	157,631.58	99.14%	13.45%	160,308.32	98.83%	12.86%
华天科技	集成电路产品	240,247.84	98.17%	20.59%	158,734.14	97.79%	17.74%	127,144.54	97.14%	17.28%
晶方科技	芯片封装	44,647.25	99.12%	55.96%	33,360.12	98.97%	56.05%	30,429.16	99.45%	55.99%
	设计	363.38	0.81%	92.65%	347.29	1.03%	92.65%	168.03	0.55%	94.09%
	其他产品	32.69	0.07%	79.50%						
扬杰科技	功率二极管	29,400.39	55.76%	29.60%	25,116.43	56.04%	26.33%	26,323.86	58.56%	24.19%
	整流桥	14,378.70	27.27%	33.66%	13,682.49	30.53%	30.85%	14,160.95	31.50%	25.40%
	分立器件芯片	7,515.09	14.25%	44.52%	5,437.24	12.13%	44.97%	3,801.10	8.46%	41.76%
	其他	1,436.45	2.72%	27.38%	583.23	1.30%	28.12%	667.72	1.49%	23.21%
台基股份	晶闸管	15,764.03	71.62%	38.12%	19,997.34	74.15%	37.69%	23,320.73	72.21%	41.68%
	模块	5,831.07	26.49%	20.87%	5,911.67	21.92%	23.31%	7,067.85	21.89%	28.15%
	散热器				613.77	2.28%	19.29%	1,076.87	3.33%	24.24%
	其他	245.51	1.12%	31.47%	260.58	0.97%	23.16%	612.66	1.90%	33.32%
华微电子	半导体器件	120,803.30	96.81%	20.67%	101,534.22	96.23%	21.56%	105,906.60	96.44%	28.87%
	其他	2,729.43	2.19%	30.31%	2,682.93	2.54%	37.67%	2,777.78	2.53%	28.86%
士兰微	器件	79,339.04	48.44%	26.28%	59,211.99	43.89%	20.48%	48,449.97	31.34%	28.79%
	集成电路	58,870.38	35.94%	31.22%	57,280.12	42.46%	28.33%	69,892.91	45.21%	29.86%
	发光二极管	24,024.60	14.67%	8.79%	17,474.44	12.95%	5.70%	35,421.08	22.91%	35.65%
	其他	281.54	0.17%	68.93%	382.41	0.28%	65.13%	652.60	0.42%	46.75%

上表可见，同行业上市公司毛利率差异主要体现在产品结构差异上。

技术水平是决定毛利率水平的一个重要影响因素，拥有自主知识产权的企业一般都实现了较高的毛利率水平。上述可比公司中，长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技主要从事封装相关业务，通常情况，封装业务的毛利率水平较低，但拥有ThinPac晶圆级芯片尺寸封装技术的企业苏州晶方半导体科技股份有限公司，其2011年、2012年和2013年的毛利率达到56.21%、56.45%和56.28%，较一般封装企业业务模式有较大差异。同发行人业务较为接近的扬杰科技于2009年投入芯片生产线，2011年-2013年分立器件芯片业务毛利率分别为41.68%、44.97%和44.52%，同样，毛利率水平较高。

捷捷微电主营中高档的功率半导体芯片及器件的研发生产和销售，公司具有自主知识产权，通过技术创新，产品技术达到国际水平，公司产品目前已形成替代进口和对外出口的能力。公司具有自主定价权，且公司通过技术创新和有效管理，实现节约化生产，单位成本较低。报告期内，发行人主营产品为晶闸管系列产品 and 防护器件系列产品，由于发行人拥有从芯片设计到器件自封装完整业务体系及技术，相关产品毛利水平较高。

发行人的芯片毛利率约为58%左右，与此可比的扬杰科技于2009年投入芯片生产线也实现了较高的毛利率，其2011年-2013年分立器件芯片业务毛利率分别为41.68%、44.97%和44.52%。

发行人的产品主要是晶闸管系列产品和防护器件系列产品，2013年发行人器件产品实现的毛利率约为48%，与此可比的台基股份2011年-2013年晶闸管也是实现较高的毛利率水平，保持在40%左右。

报告期内，公司综合毛利率保持在50%以上，主要原因为：

(1) 公司通过技术创新实现产品较好的价格优势

近年来，公司通过自主研发，形成一系列具有成熟自主知识产权的产品，同时，公司通过持续研发创新开发新技术产品，为客户解决各种技术难题，新技术产品体现了公司研发成果的转化，具有较高的附加值，产品具有较好的价格优势。报告期，公司持续开发创新产品并投向市场。

报告期，公司主营中高档功率半导体芯片及器件，由于中高档产品的核心技术掌握在少数国外厂商手中，捷捷微电通过技术研发及创新，是少数掌握中高档功率半导体芯片及器件的核心技术的生产厂家之一，公司产品的技术优势及公司提供个性化服务的特点决定公司能够根据市场及时反应，产品性价比高，公司主要产品价格优势明显。近年来，公司替代进口效果明显，对外出口数额也逐年提升。

公司通过技术创新，产品具有自主定价权，高价位产品品种的持续开发及其市场份额的提高是报告期公司实现较高毛利率的直接原因之一。

（2）规模经济和生产效率的提高有效降低单位成本

2011年至2013年，公司主要产品为晶闸管系列产品和防护器件系列产品，产品相对集中，但集中后容易形成规模优势，报告期，随着产销量的增加，规模优势将更明显。

（3）公司原材料利用率的提高双重保障公司成本优势

公司研发成果的转化一方面体现在新产品上，同时也体现在生产工艺技术上。公司经过多年的生产积累，2011年至2013年，公司多项技术逐步应用于生产工艺，公司通过对生产工艺的集约化、精细化管理，公司产品设计及生产工艺方面都有大幅提升，单个器件耗用的芯片量有效降低，原材料利用率的提高双重保障公司成本优势。

（4）完善产品价值链、提高产品品质、提供个性化服务，增加产品附加值

2011年来，公司通过增加自封装产量，完善产品价值链，增加产品总体附加值，对公司毛利率的提升有一定的贡献。同时，公司通过自封装产品有利于提高产品品质，通过器件产品建立与客户直接对话的渠道，能够及时反应客户需求以及为客户提供更好的个性化服务，有利于树立良好的品牌形象。

综上，公司通过自主研发和技术创新，研发成果转化利润效果明显，公司产品售价和成本优势决定公司较高的毛利率水平，公司也通过品牌建设，将生产和管理的细节优化，毛利率水平稳步提高。公司也将积极推进研发创新工作，建设研究中心，深化研发体制，为公司未来可持续增长奠定技术研发先行的基础，实

现公司未来高品质的成长。

（四）利润表逐项分析

1、营业收入及营业成本参见本节之“（一）营业收入分析”和“（二）营业成本分析”。

2、期间费用

报告期内发行人期间费用及占营业收入的比重情况如下表：

单位：万元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度		2011年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
营业收入	10,722.27	100.00%	19,453.78	100.00%	17,249.74	100.00%	17,031.74	100.00%
销售费用	269.86	2.52%	688.12	3.54%	527.02	3.06%	388.41	2.28%
管理费用	1,060.03	9.89%	1,844.02	9.48%	1,873.25	10.86%	1,434.16	8.42%
财务费用	-32.66	-0.30%	-231.69	-1.19%	-134.24	-0.78%	12.72	0.07%

2013年公司三项费用占营业收入的比重与可比上市公司比较情况如下：

公司	销售费用占比（%）	管理费用占比（%）	财务费用占比（%）
长电科技	1.62	13.23	3.45
通富微电	0.41	10.97	2.65
华天科技	1.49	9.88	1.39
晶方科技	0.38	16.43	0.33
扬杰科技	2.90	9.32	0.12
台基股份	5.18	13.69	-6.22
华微电子	3.52	11.47	3.60
士兰微	2.49	18.13	3.91
平均值	2.25	12.89	1.15
捷捷微电	3.54	9.48	-1.19

可比公司数据来源:WIND。

报告期，发行人销售费用的具体构成如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
职工薪酬	96.08	272.73	255.57	192.38
包装运杂费	102.07	214.95	149.15	111.81
差旅费	27.57	58.91	42.03	24.32
业务宣传费	3.89	1.68	0.92	11.64
业务招待费	18.58	56.61	36.21	30.48
会展费	9.32	14.74	11.24	13.28
广告费	-	5.00	2.00	3.16
其他	12.36	63.50	29.90	1.32
合计	269.86	688.12	527.02	388.41

报告期，发行人的销售费用占营业收入相对稳定。2012年销售费用较2011年增加138.61万元，同比增加35.69%，主要系职工薪酬及包装运杂费增加所致。

报告期，发行人管理费用的具体构成如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
研发费用	541.03	918.62	808.86	873.49
职工薪酬	267.75	460.61	362.09	161.23
中介机构费	18.87	38.83	214.17	—
业务招待费	57.52	107.07	89.11	88.18
修理费	44.43	85.48	84.36	43.80
税费	26.94	62.60	81.39	66.31
差旅费	29.18	44.02	61.27	33.79
折旧费	24.15	44.71	55.83	55.49
无形资产摊销	11.97	22.62	18.89	3.59
环境保护费	2.50	5.65	17.74	—

办公费	2.81	12.27	14.82	25.02
通讯费	1.11	2.03	9.16	8.10
保安服务费	3.12	6.00	7.56	5.84
汽车维修费	-	4.37	4.79	4.12
其他	28.66	29.15	43.22	65.20
合计	1,060.03	1,844.02	1,873.25	1,434.16

报告期内，发行人的管理费用分别为1,434.16万元、1,873.25万元、1,844.02万元和1,060.03万元，发行人的管理费用主要为研发费用和管理人员薪酬，公司属于自主研发创新型企业，各年研发费用相对较高。报告期内，公司管理费用占营业收入比重相对稳定。

报告期，公司财务费用的具体构成如下：

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
利息支出	-	-	2.41	44.93
减：利息收入	32.40	264.38	134.10	39.81
汇兑损益	-4.64	23.40	-9.72	4.99
银行手续费	4.38	9.29	7.18	2.61
合计	-32.66	-231.69	-134.24	12.72

报告期内，发行人不存在利息资本化的情形。

3、其他项目分析

(1) 报告期内发行人利润表的其他项目对净利润的情况如下表：

单位：万元

项目	2013年1-6月		2013年度		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
净利润	3,682.69	100.00%	6,623.72	100.00%	6,171.90	100.00%	6,030.83	100.00%
资产减值损失	100.02	2.72%	91.00	1.37%	112.32	1.82%	94.55	1.57%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-	-	-	-

投资收益	-	-	-	-	-	-	-	-
营业外收入	246.76	6.70%	423.25	6.39%	547.66	8.87%	49.76	0.83%
营业外支出	1.42	0.04%	63.93	0.97%	12.24	0.20%	53.51	0.89%
所得税费用	655.51	17.80%	1,102.23	16.64%	1,034.46	16.76%	1,108.73	18.38%

报告期，公司的资产减值损失均为应收款项按账龄计提的坏账准备，资产减值损失情况取决于公司应收款项余额及账龄的变化情况。

报告期，公司的公允价值变动损益、投资收益、营业外支出金额较小，对公司业绩影响非常小。2014年1-6月公司的营业外收入主要为取得的各项政府补助。税收优惠和政府补助对净利润的影响详见本节之“十二、盈利能力分析”之“（六）税收优惠和政府补助对经营业绩的影响分析”。

（五）非经常性损益及其影响分析

报告期发行人非经常性损益发生额较少，对公司经营成果无重大影响，详见本节之“七、非经常性损益情况”。

（六）税收优惠和政府补助对经营业绩的影响分析

报告期，发行人的各项税收优惠和计入当期损益的政府补助占当期利润总额的比例如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
所得税税收优惠	435.72	732.23	700.02	785.82
政府补助	246.15	413.46	529.67	49.32
合计	681.86	1,145.69	1,229.69	835.14
利润总额	4,338.20	7,725.95	7,206.37	7,139.56
税收优惠和政府补助占利润总额比例	15.72%	14.83%	17.06%	11.70%

报告期，发行人的各项税收优惠和计入当期损益的政府补助占当期利润总额的比例较小，主要为发行人享受的优惠主要为高新技术企业税收优惠。发行人经

营成果对税收优惠和政府补助不存在严重依赖。

1、税收优惠情况

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
发行人适用的所得税税率	15%	15%	15%	15%
法定企业所得税税率	25%	25%	25%	25%
发行人所得税税收优惠	435.72	732.23	700.02	785.82

捷捷微电 2011 年获得了国家高新技术企业认定，适用 15% 的优惠所得税率。

2、政府补助占当期利润总额的比例

项目		与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
2014年1-6月	金额（万元）	117.62	128.53	246.15
	占利润总额的比例	2.71%	2.96%	5.67%
2013年	金额（万元）	145.09	268.37	413.46
	占利润总额的比例	1.88%	0.03	5.35%
2012年	金额（万元）	415.01	114.66	529.67
	占利润总额的比例	5.76%	0.02	7.35%
2011年	金额（万元）	49.32	-	49.32
	占利润总额的比例	0.69%	-	0.69%

由上表可知，报告期内，公司与收益相关的政府补助分别为 0.69%、7.35%、5.35%和 5.67%，占当期利润总额比例较低，公司的经营成果不存在对政府补助的重大依赖。

（七）所得税费用与会计利润的关系

报告期内所得税费用与会计利润的关系如下：

1、所得税费用（收益）的组成

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
会计利润总额	4,338.20	7725.95	7206.37	7139.56
当期所得税费用	653.58	1,098.34	1,050.03	1,178.73
递延所得税费用	1.93	3.88	-15.57	-70.00
所得税费用合计	655.51	1,102.23	1,034.46	1,108.73
所得税费用占利润总额比例	15.11%	14.27%	14.35%	15.53%

报告期内，所得税费用占税前利润总额比例分别 15.53%、14.35%、14.27% 和 15.11%。

报告期内公司按照高新技术企业优惠税率 15%征收企业所得税，报告期内公司所得税费用占税前利润总额比例与公司适用的企业所得税税率基本一致。

十一、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐人对发行人是否具备持续盈利能力的核查意见

影响发行人持续盈利能力的风险因素已在本招股说明书“第四节 风险因素”进行了披露。发行人不存在以下对持续盈利能力构成重大不利影响的情形：

（一）发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（二）发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（三）发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

（四）发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户存在重大依赖；

（五）发行人最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

(六) 其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

保荐机构经核查后认为，发行人已披露了其面临的风险因素，发行人不存在上述对持续盈利能力构成重大不利影响的情形，发行人具备持续盈利能力。

十二、现金流量分析

(一) 报告期公司现金流量简要情况

单位：万元

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	3,758.72	6,367.96	8,181.64	5,242.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,043.39	-1,803.91	-4,025.63	-7,127.70
筹资活动产生的现金流量净额	-3,256.34	-2,950.32	-2,998.20	4,772.33
现金及现金等价物净增加额	-541.01	1,613.73	1,157.81	2,886.79

1、经营活动产生的现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 5,242.16 万元、8,181.64 万元、6,367.96 万元和 3,758.72 万元，公司经营活动现金流量净额来源于公司净利润，报告期，公司收款情况较好，三年及一期累计经营活动产生的现金流量净额占净利润的比例占 104.63%。

公司经营活动现金流量金额占净利润的比例如下：

单位：万元

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度	合计
经营活动产生的现金流量净额	3,758.72	6,367.96	8,181.64	5,242.16	23,550.48
净利润	3,682.69	6,623.72	6,171.90	6,030.83	22,509.14
比 例	102.06%	96.14%	132.56%	86.92%	104.63%

2、投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-7,127.70 万元、

-4,025.63 万元、-1,803.91 万元和-1,043.39 万元，公司投资活动的现金流主要为购建固定资产、土地使用权支付的现金。

报告期，公司处于快速发展期，为保持未来发展中的核心竞争力，公司根据发展状况制定中长期战略，尤其是生产能力方面需要滚动发展、提前部署，2011 年至 2014 年 6 月末，公司累计形成固定资产原值 13,184.89 万元，上述投入已逐步转化为生产力并实现盈利。

3、筹资活动产生的现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 4,772.33 万元、-2,998.20 万元、-2,950.32 万元和-3,256.34 万元。

2011 年，公司筹资活动产生的现金流量主要为短期借款补充流动资金产生的现金流量以及公司增资收到的资本投入。当期公司共收到股东投入 4,906.25 万元，取得银行借款累计收到的现金为 4,000 万元，偿还银行借款累计支付的现金为 4,000 万元。

2012 年，公司筹资活动产生的现金流量主要为偿还银行借款 3,000 万元。

2013 年，公司筹资活动产生的现金流量主要为现金分红 2,940 万元。

2014 年 1-6 月，公司筹资活动产生的现金流量主要为现金分红 3,500 万元。

报告期，公司拥有良好的融资渠道，在公司良好增长的前提下，公司得到了股东及银行的大力支持，为公司发展筹集了必须的资金，也为未来的可持续发展奠定了坚实的基础。但是任何快速发展的公司都面临资金瓶颈，近年来，虽然公司实现了良好的经济效益，但为保障未来发展所需的资金，公司各年的净利润都已陆续投入到公司发展中，公司还需努力拓宽融资渠道，优化资本结构，才能实现优质的可持续发展。

（二）未来可预见的重大资本支出计划及资金需求量

截止本招股说明书签署日，除本次发行募集资金拟投资项目外，发行人无其他可预见的重大资本性支出。本次发行募集资金拟投资项目的详细情况参见“第十节 募集资金运用”。

十三、财务状况、盈利能力及现金流量的未来趋势分析

（一）财务状况趋势

1、资产状况趋势

公司资产结构中以货币资金、应收账款、存货及固定资产的比重较高。货币资金是公司盈利的成果同时也是未来发展中所必须的资金保障；应收账款是公司销售业绩的体现，其质量关系到公司经营业绩质量；固定资产规模是公司生产力的体现，存货的流转将体现了公司生产力的利用情况。根据本公司所处行业的经营特点及公司的发展阶段的实际情况，未来公司发展过程中盈利必然形成现金增量并将回报股东，剩余部分将继续投入公司发展中，为保障公司未来的良好发展，公司还需实施募投项目扩大产能、提升技术实力，固定资产规模将进一步增加，销售规模也将有较快的增长，预计应收账款规模及存货规模将随销售的增长适度增加，预计本公司的资产结构仍将持续。

2、负债状况趋势

报告期内，短期借款和应付账款等项目构成了公司流动负债的主要部分。公司在高速发展过程中，利用银行借款获得一定的资金有利于优化公司资本结构、拓宽融资渠道。随着公司发展规模的扩大，公司快速发展中资金需求量大，公司将适度获取银行借款以补充发展必须的资金。同时，随着公司规模的发展，公司采购增加也将形成期末应付账款的自然增长。由于公司实行稳健的资金安排策略，合理安排债务规模，短期借款和应付账款的规模将控制在一定的范围之内，预计此种负债结构仍将持续。

3、所有者权益趋势

报告期，随着公司业务的扩张，公司通过增资等方式充实资本金以适应业务发展，公司所有者权益近年大幅增长。本次发行完成后，所有者权益将进一步增加，另外，随着盈利的持续增长和累积，公司所有者权益也将持续增长。

（二）盈利能力趋势

针对对公司盈利能力的分析，发行人管理层认为：

公司报告期业务持续快速发展是管理层在行业迅速发展的趋势下，持续加强研发投入、不断完善产业链、扩大生产规模以及不断开拓市场的结果。在技术国内领先，高性价比产品及市场占有率持续增加的基础上，本公司未来有望延续近几年快速发展的趋势。

公司的盈利能力不仅来源于销售规模的扩大，也来自管理层持续的技术研发、科学的管理和严格的成本控制。预计在未来几年内，本公司将继续通过扩大生产能力、加强研发水平、不断开发新产品、深化与老客户的合作、拓展新客户等方式继续提高本公司的市场份额，提高生产协调能力和管理效率，增强盈利能力。

1、毛利率的变化趋势

公司近年来销售收入保持平稳增长，毛利率水平保持平稳，得益于公司产品技术优势，顺应客户的技术要求，提高产品的附加值，从而保持公司产品销售毛利率。未来公司将继续加大科研投入，保持公司产品的毛利率水平。

2、产品领域的扩张

公司产品具备替代进口及对外出口的能力，近年来，产品市场份额的提高幅度明显，公司将进一步加强研发及技术服务，提高产能产量和产品的性价比，随着公司品牌影响力的提高，公司的销售额将不断增大，盈利水平将不断提高。

（三）发展前景

发行人作为功率半导体分立器件行业的技术领先企业，长期专注于功率半导体分立器件的研发、设计、生产和销售，公司现已建立了较完善的研发生产和销售的管理体系，具备业内领先的技术开发能力，在业内形成了较完善的销售网络，拥有稳定的客户群体。

发行人的管理层认为：公司所处行业发展前景广阔，公司业务发展目标明确，技术、市场和人才基础坚实，盈利预期良好，具有较强的可持续盈利能力。本次募投项目实施后，公司生产能力及技术研发条件将得到提升，资产质量更加优良，为公司的可持续性发展创造更大的发展空间。

十四、期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

截至本招股说明书签署之日，除上述事项外，本公司无资产负债表日后重要事项。

（二）或有事项

截至本招股说明书签署之日，本公司无需要披露的其他或有事项。

（三）其他重要事项

截至本招股说明书签署之日，本公司不存在重大担保、诉讼、其他重要事项。

十五、股利分配政策

（一）公司股利分配政策

公司股利分配将遵循“同股同权、同股同利”的原则，按股东持有的股份数额，以现金、股票或其他合法的方式进行分配。具体分配比例由公司董事会视公司经营发展情况提出方案，经股东大会决议后执行。根据公司章程的有关规定，公司税后利润分配顺序为：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取10%的法定公积金；
- 3、提取任意公积金，具体比例由股东大会决定；
- 4、向出资者分配利润。

公司法定公积金累计额达到公司注册资本的50%以上时，可以不再提取。

（二）最近三年股利分配情况

2013年10月8日发行人2013年度第二次临时股东大会审议通过《2012年度利润分配方案》，以可供分配利润中的2,940万元进行现金分红。该股利分配于

2013年12月30日实施完毕。

2014年4月12日发行人2013年年度股东大会审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司2013年度利润分配预案》，以可供分配利润中的3,500万元进行现金分红。该股利分配于2014年6月18日实施完毕。

（三）发行前滚存利润共享安排

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，若公司本次公开发行股票并上市成功，则首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。

（四）发行后的股利分配政策

根据公司第一届董事会第十四次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过修订后的上市后适用的《公司章程(草案)》，有关股利分配的主要规定如下：

1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况。公司应该通过及时的信息披露及信息沟通等多种渠道充分听取独立董事以及中小股东等公众投资者的意见。

2、如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。当累计未分配利润超过公司股本总数 100%时，公司可以采取股票股利的方式予以分配。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

3、公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或红股）的派发事项；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过，其中股东大会决议需要经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是中小股东等公众投资者）和独立董事的意见制定或调整股东回报计划。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

（五）发行人股东回报规划

为了明确本次发行后股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，发行人制定了股东回报规划，并予以及时修订。修订后的《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》主要内容如下：

1、股东回报规划制定考虑因素：

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

2、股东回报规划制定原则

公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东等公众投资者）

和独立董事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的百分之二十。

3、股东回报规划制定周期和相关决策机制

公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是中小股东等公众投资者）和独立董事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求及内外金融环境，并结合股东（特别是中小股东等公众投资者）和独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

4、未来三年（2014-2016）具体的分红计划

鉴于当前是公司实现跨越式发展目标的关键时期，根据《公司章程(草案)》、业务发展目标以及公司实际情况，公司将借助募集资金和留存未分配利润，进一步提升公司产能、研发技术实力，巩固公司在功率半导体器件细分行业内领先者的市场地位。

为此，公司未来三年计划将为股东提供以下投资回报：①2014-2016年，公司将每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。②在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，并由股东大会审议通过。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。

5、股东回报规划的合理性分析

（1）2011年至今，公司营业收入保持了持续增长趋势。若募集资金投资项目顺利实施，则公司未来盈利规模及盈利能力有望进一步扩大。公司目前盈利能力良好，有助于保障股东未来分红回报的持续性。

（2）2011年至今，公司现金流量状况良好，有助于保障公司现金分红政策

的实施。

(3) 受益于国家对电力电子行业产业规划政策，最近几年，公司的发展迎来历史机遇，公司正处于快速成长期，随着公司业务规模的进一步扩大，产能扩大以及采购、生产、销售环节对资金的需求将不断增长，需要有较强的资金保证。另一方面，为保持未来竞争优势，公司还将在建设研发中心、吸收高端人才上投入均面临较大的资金需求。因此，除本次募集资金外，公司还需要大量资金维持企业整体的运营和抢占新的市场空间，以保障股东长期的投资回报。

(4) 公司为中小型民营企业，外部融资规模在一定程度上受到银行信贷空间和利息成本的制约。公司运用留存利润的保持充裕的资金，不仅可以在紧缩的环境下降低财务费用和财务风险，同时，强有力的资金保障为公司的未来发展提供良好的发展基础，可持续增长为股东创造良好的回报。

综上所述，公司确定现金分红的最低比例为当年实现的可供分配利润的20%，公司股东分红回报规划合理，符合公司经营现状及股东利益。

6、履行的相关程序

发行人第一届董事会第十四次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过了关于发行上市后所适用《公司章程（草案）》、《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》。

（六）未分配利润的使用安排

公司在无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，坚持以现金分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司留存的未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

（七）发行人股东关于利润分配的承诺

公司全体股东均作出不可撤销之承诺，同意《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》，在公司上市后的股东大会根据

《公司章程》的规定通过利润分配具体方案时，表示同意并投赞成票。

发行人控股股东及实际控制均作出了承诺：“未来公司股东大会根据公司章程的规定表决利润分配的具体方案时，本方表示同意并出具赞成票。”

第十节 募集资金运用

一、本次发行筹集资金的总量及拟投资项目

(一) 本次募集资金计划及拟投资项目

本公司第一届董事会第十四次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了关于本次发行募集资金投资项目的决议。公司全体董事均已认真阅读了公司编制的募集资金运用的可行性分析报告，并确信本次募集资金投资项目符合国家产业政策及本公司的发展战略，投资项目是切实可行的。

公司本次拟申请公开发行不超过2,360万股人民币普通股（A股），实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，按轻重缓急顺序投资以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	项目履行的审批、核准或备案程序	项目环评
功率半导体器件生产线建设项目	18,696.00	备案号：启东市备2014156	启环表【2014】0519号
半导体防护器件生产线建设项目	15,774.30	备案号：启东市备2014155	启环表【2014】0518号
工程技术研究中心项目	4,500.00	备案号：启东市备2014154	启环表【2014】0520号
补充营运资金项目	22,600.00	—	—
合计	61,570.30	—	—

公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。

若本次募集资金不能满足上述项目需求，公司将通过申请银行贷款等途径自筹解决资金缺口。在募集资金到位前，股东大会授权公司董事会根据实际情况决定是否使用自筹资金进行前期投入，前期投入资金在募集资金到位后予以置换。

（二）预计募集资金投入的时间进度

本次发行的募集资金到位后，将根据所投资项目的建设进度，在三年内投入使用，按项目列表如下所示：

项目名称	项目投资总额（万元）	建设期	资金投资计划（万元）		
			T+12	T+24	T+36
功率半导体器件生产线建设项目	18,696.00	2年	6,069.27	12,626.73	-
半导体防护器件生产线建设项目	15,774.30	2年	4,998.60	10,775.70	-
工程技术研究中心项目	4,500.00	1.5年	4,300.00	200.00	-
补充营运资金项目	22,600.00		-	10,000.00	12,600.00
合计	61,570.30		15,367.87	33,602.43	12,600.00

注 1：T 为募集资金开始投入月份，T+12 表示募集资金投入第一年，以此类推。

二、募集资金投资项目与现有主营业务体系的关系

本次募集资金运用全部围绕公司主营业务进行。本次募集资金投资项目顺利实施后，公司从高端人才吸收、技术研发、产品设计制造、产能规模及管理水平等方面都将实现大幅度提升，为公司未来稳定、健康的可持续发展奠定坚实的基础。

（一）实施功率半导体器件生产线建设项目，解决产能限制及发展瓶颈

近年来，随着公司成长的步伐和技术进步，公司产品已深获市场认可，替代进口数额及对外出口数额增长较快，公司现有的生产能力已无法满足日益增长的市场需求。

公司通过实施功率半导体器件生产线建设项目，有助于巩固和扩大公司在功率半导体行业的市场份额和市场地位，有效提高公司盈利水平，同时，生产能力的提高也将进一步增强公司研发试制能力，提高技术服务质量，稳定公司的技术核心力量，提升公司综合竞争实力。

（二）实施半导体防护器件生产线建设项目，拓宽公司业务领域

半导体防护器件市场需求量巨大。人们的日常生产生活中的电子设备都需要半导体防护器件。例如，手机、家用电器、通讯设备等等电子设备当中使用半导

体防护器件，用以对昂贵的电路提供防护，以免受到突发的过高电压或过大电流损害。

目前发行人的产品主要集中于功率半导体器件，是报告期内公司的主要收入来源。然而，考虑到企业的长期可持续发展，公司业务收入来源仅仅依靠单一产品不易抵抗行业周期性波动风险，具有较大不确定性。因此，在技术复用性和大量市场需求的基础上，公司开始逐步介入半导体防护器件领域，并且生产出了一批低成本、高性能的半导体防护器件，丰富了公司的产品线，同时拓宽了公司的业务领域。

本项目的建设能进一步丰富公司的半导体器件产品线，并拓宽公司的业务领域，可以为公司抢占新市场、开拓新领域和长期可持续发展奠定良好的基础。

（三）设立研究中心，增强自主创新能力，提升公司核心竞争力

功率半导体行业是人才、技术和资金密集型的行业，行业的发展以芯片研发设计制造能力、技术创新能力、先进生产能力和综合管理能力为根本，对技术方案设计、产品性能优化、产品更新换代、后续技术服务以及为客户提供定制化开发产品能力等方面均有较高的要求，需要长时间的实践和积累。由于客户对产品性能多元化需求、对质量标准日益提高的需求以及国家对行业发展规划的需要，公司需要通过持续技术创新，实现技术突破，以高性价比的产品和服务实现核心电子元器件国产化，响应国家产业政策的发展规划。

发行人是自主创新的技术导向型高新技术企业，通过建设研究中心，有助于公司深化研发体制，吸收和稳固高端技术人员，增强自主创新能力，实现产品技术优势，公司对市场快速反应，通过技术产品功能升级和进步，进一步推动行业的发展实现国家战略，同时纵向延伸国际市场，通过高性价比产品与国际厂商竞争，树立公司全球化品牌。公司一方面通过持续研发形成具有自主知识产权的新技术、新工艺，实现产品的升级，另一方面通过高效的技术服务模式，实现对下游行业渗透，以客户需求为核心，以技术创新为原动力，推动行业进步。

（四）补充流动资金

本次募集资金增加与主营业务相关的营运资金后，为公司实现业务发展目标提供了必要的资金来源，保证了公司业务的顺利开展，有利于公司扩大业务规

模，优化公司财务结构，提升研发水平，从而提高公司的市场竞争力，实现跨越式的发展。

通过本次募集资金补充与主营业务相关的营运资金，有效规避财务风险和市场的 uncertainty。公司有能力在复杂的环境中应对各种困难，发挥公司优势，抓住发展中的机遇，即使在国际金融危机、欧债危机以及市场萎缩的恶劣情况下，公司通过实施长期发展战略，实现公司和产业的升级，凭借产品自主研发生产的优势，打破同类高端产品受制于国外厂商垄断的格局，公司在技术研发、市场占有率等方面都会有长足进步。

三、募集资金投资项目概况

（一）功率半导体器件生产线项目

1、投资概况

本项目总投资 18,696.00 万元。新建电力（功率）半导体器件芯片生产线 1 条，配套成品封装线 1 条。年产出 $\Phi 4$ 英寸圆片 42 万片，用于公司生产各类电力电子器件芯片 45,850 万只，自封装电力电子器件 4.28 亿只。

项目实施后，年均利润总额 3,029.16 万元。项目投资内部收益率为 20.62%，项目净现值（12%折现率）为 5,211.00 万元；项目投资利润率 16.20%，。从不确定性分析，本项目的盈亏平衡点为 42.03%，投资回收期为 5.97 年(含建设期)。

序号	项目	指标	单位
一	项目新增总投资	18,696.00	万元
1	新增固定资产投资	14,296.00	万元
2	其他费用	2,000.00	万元
3	预备费	325.92	万元
4	铺底流动资金	2,074.08	万元
二	年均利润总额	3,029.16	万元
三	内部收益率	20.62%	%
四	财务净现值 (ic=12%)	5,211.00	万元

五	投资回收期	5.97	年
六	投资利润率	16.20%	%
七	盈亏平衡点（运营期）	42.03%	%
八	年产值（达产后）	21,800.00	万元

2、项目选址及建设用地

功率半导体器件建设项目厂址选择在江苏省启东近海盐场滨海工业区。公司现公司已取得启国用（2012）第 0080 号建设用地，土地权证情况如下：

证书编号	地址	面积(m ²)	到期时间	用途	权属
启国用（2012）第 0080 号	启东近海盐场滨海工业区	40,000	2062 年 5 月 29 日	工业	公司

启东滨海工业园位于长江入海口北侧的黄海之滨，与日本、韩国一衣带水，东临黄海，北靠开发建设中的吕四大港(2 个 5 万吨级综合货运码头在建)和投资 250 亿元华东地区的发电企业—吕四港大唐电厂，南连上海—崇明—启东之间的沪崇启大通道，距上海浦东直线距离仅 53 公里，西接南京与启东之间的宁启高速公路以及建设中的宁启铁路和沿海高速公路。滨海工业园与上海浦东国际机场、上海外高桥港区之间，都只有一小时车程，交通条件十分便利。

启东滨海工业园区自 2005 年 3 月启动开发以来，园区的一、二期内的道路、供电、供水、排水、排污、通讯、宽带、有线电视、土地平整等已达到“八通一平”的建设标准。

3、项目实施原则及进度安排

本项目预计建设期 2 年。

本项目的建设本着质量第一、安全第一的原则按时、按质完成，投入运行，尽快创造社会和经济效益。

项目实施进度安排：

本项目计划安排 2 年时间完成，拟分成四个阶段进行。

T1 阶段（3 个月）的主要工作内容：项目筹建、立项、环评审批。

T2 阶段（12 个月）的主要工作内容：厂房建设、配套设施安装、生产设备选型、部分设备购进、安装。

T3 阶段（4 个月）的主要工作内容：部分生产设备购进、安装、调试、生产线系统调试。

T4 阶段（5 个月）的主要工作内容：总体试产、验收合格、投产销售。

项目实施进度表

项目阶段	T1 阶段			T2 阶段												T3 阶段				T4 阶段					
	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	1	2	3	4	5	
前期工作	■																								
立项审批			■																						
地质勘探		■	■																						
工程设计		■	■																						
设备签订						■	■	■	■	■	■	■													
土建及装修				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
设备安装调试													■	■	■										
人员培训																	■	■	■						
试生产																				■	■	■	■		
验收合格																								■	
正试投产																									■

1	新增固定资产投资	12,721.04	万元
2	其他费用	700.00	万元
3	预备费	268.42	万元
4	铺底流动资金	2,084.84	万元
二	年均利润总额	3516.24	万元
三	内部收益率	29.10%	%
四	财务净现值 (ic=12%)	8,542.51	万元
五	投资回收期	5.03	年
六	投资利润率	22.29%	%
七	盈亏平衡点 (运营期)	37.86%	%
八	年产值 (达产后)	23,040.00	万元

2、项目选址及建设用地

参见功率半导体器件生产线建设项目选址。

3、项目实施原则及进度安排

本项目预计建设期 2 年。

项目实施进度安排：

本项目计划安排 2 年时间完成，拟分成四个阶段进行。

T1 阶段（3 个月）的主要工作内容：项目筹建、立项、环评审批。

T2 阶段（12 个月）的主要工作内容：厂房建设、配套设施安装、生产设备选型、部分设备购进、安装。

T3 阶段（4 个月）的主要工作内容：部分生产设备购进、安装、调试、生产线系统调试。

T4 阶段（5 个月）的主要工作内容：总体试产、验收合格、投产销售。

项目实施进度表

项目阶段	T1 阶段			T2 阶段												T3 阶段				T4 阶段				
	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	十	十一	十二	1	2	3	4	1	2	3	4	5
前期工作	■																							
立项审批			■																					
地质勘探		■	■																					
工程设计		■	■																					
设备签订						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
土建及装修				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
设备安装调试													■	■	■	■	■	■						
人员培训																	■	■	■	■	■			
试生产																			■	■	■			
验收合格																						■		
正试投产																							■	
市场销售																							■	

4、项目环保评价及环保措施

本项目符合当地规划，周围交通便利，附近没有环境敏感点，不涉及对文物古迹、风景名胜区、水源保护区的破坏。本项目采取的治理措施具有技术经济可行性。在对产生的废气、生产和生活污水、固体废弃物、噪声等进行有效处置后，在建设期和运营期对周围环境的影响可控制在允许的范围内，对当地的自然环境的影响较小。

（三）工程技术研究中心项目

1、投资概况

本项目总投资 4,500 万元，其中工程费用 3,930 万元，包括净化工程投资、设备购置投资和安装工程投资，其它工程建设费用 200 万元，基本预备费包括基本预备费和涨价预备费共计 170 万元，铺底流动资金 200 万元。

序号	项目名称	金 额	占建设投资比例
—	总投资	4,500	100%
1	净化工程投资	480	10.68%
2	设备购置投资	3,250	72.22%
3	安装工程投资	200	4.44%
4	其它工程建设费用	200	4.44%
5	预备费	170	3.78%
6	铺底流动资金	200	4.44%

本项目将建设三条新产品研发试验线和一个产品性能检测和试验站，包括超快恢复功率二极管研发试验线、功率 MOSFET、IGBT 研发试验线、碳化硅器件研发试验线。研发试验线用于公司新产品、新工艺和新工装的研究开发工作，同时承担公司的产学研联合和对外合作交流的任务，吸引高端技术人才加入公司研发团队。

2、项目实施进度

项目分两年投资，第一年主要建设净化工程、采购安装设备，需净化工程投资 480 万元、设备购置投资 3,250 万元、安装工程投资 200 万元；第二年主要招聘研发人员，正式开始产品研发试制，并陆续形成专利技术和功率半导体器件产品，小批量用于航天、军工等领域，使中心在功率半导体器件研发、设计领域处于行业领先地位。

3、项目选址

工程技术研究中心拟建在江苏捷捷微电子股份有限公司的生产园区内，园内已有完整的电力电子器件芯片制造生产线和封装生产线、以及相应的生产配套

设备，有着完备的产品检测仪器和手段，有着完善的供电、给排水系统，生产、生活条件完善，为工程技术研究中心的建立和运行提供了良好的条件。

拟建项目计划利用公司原有 B 栋生产大楼的第三层，该层的建筑面积为 5,130 平方米。

（四）补充流动资金项目

1、补充流动资金的必要性

充足的流动资金是公司保持稳定增长的关键因素之一，具体来说，主要表现在以下方面：

（1）随着发行人的快速成长，销售规模增长的增长将派生出存货、应收账款等流动资产的自然增加。2013 年度，发行人应收账款周转率和存货周转率分别为 4.33 和 2.32，资金占用大，发行人因销售增长对补充流动资金具有迫切的需求。

（2）目前，行业竞争激烈，集中度不高，未来随着行业整合，集中度将进一步提高，作为行业拥有自主知识产权，国内少有的能够设计芯片并进行生产的捷捷微电，未来存在着较多的并购整合机会，保留充足的流动资金有利于公司抓住行业并购机会，实现进一步发展。

（3）未来的竞争将对发行人的产品和服务提出更高要求，需要不断研发创新，只有通过产品创新，切实解决客户应用中的问题，才能与客户共同成长，实现双赢。

（4）为保持中小股东权益和利益，发行人制定了未来分红规划，未来几年，发行人将保持至少 20% 分红，保证现金分红资金及分红后发行人的流动资金将进一步趋紧。

2、补充流动资金金额估算

报告期内，发行人通过创新提升产品及服务的价值，不断开拓优化客户并优化客户结构，营业收入实现了 6.87% 的复合增长率。保守估计，假设未来五年按此比例增长，发行人现有业务的营业收入增长情况如下表，同时，假设募投项

自 2016 年起实施，未来五年内，该等项目实施后将为发行人创造新增收入。2013 年末，发行人营运资金为 20,105.82 万元，按照 2013 年的营运资金周转情况来看，发行人未来五年营运资金需求估算如下：

单位：万元

项目	2013 年	2014 年 E	2015 年 E	2016 年 E	2017 年 E	2018 年 E	合计
营运资金需求	20,105.82	21,487.92	22,965.02	24,543.67	40,133.70	53,522.57	182,758.71
需要补充流动资金	-	1,382.10	1,477.11	1,578.64	15,590.04	13,388.87	33,416.75

上表可见，未来五年，发行人约有 3.34 亿元的营运资金缺口。考虑到 2013 年末公司货币资金账面余额 1.08 亿元，发行人估计未来五年将需要 2.26 亿元左右的资金用于补充流动资金。

四、固定资产变化与产能变动的匹配关系

（一）固定资产变化与产能变动

本次募集资金投向的功率半导体器件生产线建设项目、半导体防护器件生产线建设项目和工程技术研究中心项目，募集资金新增固定资产投资 31,317.04 万元，预计募投项目实现年均销售收入为 30,106.86 万元，新增固定资产平均投入产出比约为 0.96，接近现有固定资产的投入产比 1.03。

募投项目实施前后	固定资产原值	产量（不含自耗）		产值（万元）	单位固定资产产值
		芯片（万片）	封装产品（亿只）		
2013 年	18,888.80	50.58	3.17	19,389.60	1.03
募投项目新增产能	31,317.04	90	11.48	30,106.86	0.96

注：募投项目生产 4 英寸芯片全部用于自封装器件产品。

本次募集资金投资项目拟购置性能较为先进的生产和研发设备，使公司增强对关键生产过程的把握能力，更好地提高产品质量和性能，提升产品的竞争力。项目建成后，将提高发行人的整体技术水平和生产力水平，生产的产品可以满足公司现有订单需求和持续满足未来一段时间内国内外市场逐步提高的产品质量和技术指标要求，对公司的长远发展具有重要意义。

近年来，公司产值与固定资产的比例大约在 1 左右，本次投资项目的投资规模及新增产能基本与公司目前投入产出的实际情况相配比，体现出其内在的特点与合理性。因此，此次募集资金投资项目的固定资产变化与产能变动是具有实质匹配关系的，公司的规模扩张和产能提高在合理的范围之内。

（二）募集资金新增固定资产折旧、研发支出对未来经营成果的影响

1、募集资金新增固定资产折旧对未来经营成果的影响

募集资金新增固定资产及年折旧与摊销情况如下：

单位：万元

项 目	新增固定资产投资	年均折旧与摊销
功率半导体器件生产线项目	14,296.00	1,160.44
半导体防护器件生产线建设项目	12,721.04	1,468.15
工程技术研究中心项目	4,300.00	408.5
合 计	31,317.04	3,037.09

本项目在两年的项目建设期中，由于项目建设期的固定资产投入按照企业会计准则等相关法规规定计入在建工程，竣工决算前不需要计提折旧，从而不会对公司的经营成果产生影响。

本次募集资金投资项目建成后，功率半导体器件制造项目为生产性项目，建成后将使现有产能扩大，虽然新生产线折旧增加，但由于公司的销售规模也得到扩大，项目新增销售收入年均 30,106.86 万元，年均利润总额新增 7,700.47 万元，而募投新增年均折旧与摊销额 3,037.09 万元已在计算利润总额前扣除，项目产生的利润完全可以覆盖每年募投新增的折旧与摊销，安全边际较大，不会对公司的经营业绩产生不利影响，公司有足够的能力消化新增折旧。

2、新增研发支出对未来经营成果的影响

公司自成立以来，对功率半导体领域进行积极探索，报告期研发支出占收入的比例均超过 4%（详见本招股说明书之“第六节 业务与技术”之“六、发行人核心技术情况”），符合高新技术企业研发支出的特点。公司通过持续的研发投入，实现技术创新，形成自主知识产权。

公司本次通过建设工程技术研究中心，建立和完善企业技术创新体系，从根本上提升了公司技术创新能力。研究中心建成后，新增研发人员以及研究中心各实验室的日常运营将增加支出，但作为公司的技术核心模块，公司将继续加强研发投入，保证研发中心的正常运营，以保障公司的技术领先和人才储备。

建立研究中心是公司目前研发体制的升级，公司将继续保持原有的研发政策，新增研发支出将体现为收入规模的同步增长，对公司的未来经营成果不会造成重大不利影响。

五、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响

（一）对净资产和每股净资产的影响

本次募集资金到位后，本公司的净资产总额和每股净资产将大幅提高，净资产规模的扩大将增强本公司的抗风险能力和债务融资能力。

（二）对资产负债结构的影响

本次募集资金到位后，公司流动比率和速动比率将有较大幅度提高，资产负债率将有较大幅度下降，资产负债结构得到显著改善，大大增强公司的偿债能力和信誉度，有效降低财务风险，从而增强公司的持续发展能力和树立良好的品牌形象。

（三）对净资产收益率和盈利能力的影响

公司本次募集资金的运用围绕公司主营业务来进行。募投项目的建设完成，将扩大公司产能规模，为巩固公司在功率半导体分立器件细分行业内领先者的市场地位、实现业务发展目标奠定坚实的基础。本次募集资金到位后，公司净资产会大幅增加，由于募集资金投资当年至投产期内不会完全产生效益，净资产收益率将会在短期内降低。随着各项目的建成和达产，公司的营业收入与利润水平将大幅上升，净资产收益率和盈利能力将逐步提高。

第十一节 其他重要事项

一、对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同情况

截至本招股说明书签署日，发行人已签订的对正在履行的合同的金额或交易金额、所产生的营业收入或毛利额相应占发行人最近一个会计年度经审计的营业收入或营业利润的 10%以上的合同以及其他对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：

(一) 发行人正在履行的重要销售合同

签约单位	合同名称	合同金额 (万元)	主要内容(标的、数量、质量)	履行期限	签约日期	履约情况
浙江正泰电器股份有限公司	采购合同	-	可控硅	合同期限 2013 年 9 月至 2014 年 9 月	2013.9	正在履行
宁波施耐德配电电器制造有限公司	供货合同	-		合同有效期 2013.1.1 至 2014.12.31	2013.11.22	正在履行
常州云杰电器有限公司	产品销售合同	409.5	预计单、双向可控硅合计 420 万只	合同执行期为 2014.1.1 至 2014.12.31	2014.1.1	正在履行
深圳市槟城电子有限公司	产品销售合同	-	产品名称。规格型号、数量以产品报价单为准	合同执行期为 2014.1.1 至 2014.12.31	2014.1.3	正在履行
深圳市国王科技有限公司	产品销售合同	-	产品名称。规格型号、数量以订单为准	合同执行期为 2014.1.1 至 2014.12.31	2014.1.1	正在履行
无锡罗姆半导体科技有限公司	产品销售合同	-	参数型号、采购数量、价格根据每次订单来执行	合同执行期为 2014.1.1 至 2014.12.31	2014.1.1	正在履行
成都永铭科技有限公司	产品销售合同	-	具体数量根据每次订单为准,如需产品技术参数有变动可按正常样品试验流程来确认,特殊情况按订单价格确认	合同执行期为 2014.5.8 至 2015.5.7	2014.5.8	正在履行

(二) 发行人正在履行的重要采购合同

签约单位	合同名称	合同金额	主要内容(标的、数量、质量)	履行期限	签约日期	履约情况
Surplus global .inc	Sale agreement between Service Provider and Customer	255万美元	生产设备	至设备安装验收完毕	2014.6.18	正在履行

（三）《流动资金借款合同》

合同编号	合同名称	借款银行	签署日期	借款金额 (万元)	合同期限	年利率	担保条款	履约情况
JK05311400 0422	流动资金 借款合同	江苏银行股份有 限公司启东支行	2014.7.4	475	2014.7.4- 2015.1.3	5.6%	ZY053114000 006 担保合同	正在履行

（四）《保荐协议》和《主承销协议》

2012年3月26日，本公司与西南证券签订《保荐协议》和《主承销协议》，由西南证券股份有限公司作为本公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和主承销商。

二、发行人对外担保的情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在对外担保的情况。

三、发行人重大诉讼或仲裁事项

（一）截至本招股说明书签署日，发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

（二）截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人、发行人控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

最近三年内，本公司控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。

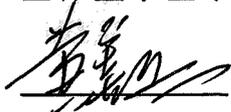
（三）截止本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未涉及刑事诉讼。

第十二节 有关声明

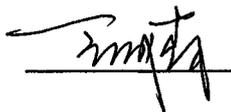
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

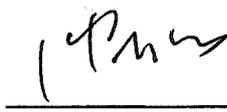
全体董事签字：



黄善兵



王成森



沈欣欣



盛波



许苏明

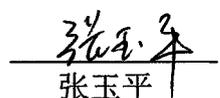


陈良



雷星晖

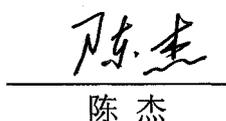
全体监事签字：



张玉平



薛治祥

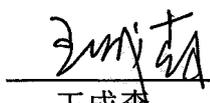


陈杰

全体高级管理人员签字：



黄善兵



王成森



张祖蕾



沈卫群



沈欣欣

江苏捷捷微电子股份有限公司

2014年8月19日

保荐人（主承销商）声明

本公司已对江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

项目协办人签名： 付新雄
付新雄

保荐代表人签名： 武胜
武胜

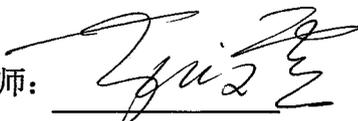
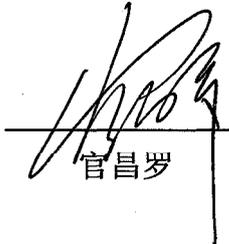
杨锦雄
杨锦雄

法定代表人签名： 余维佳
余维佳



发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书, 确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议, 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

经办律师:   
苏启云 刘 爽 官昌罗

律师事务所负责人: 
王 丽



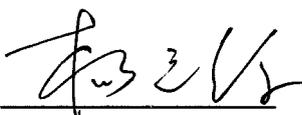
会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



林万强



杨运辉

会计师事务所负责人：



顾仁荣

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



2019年8月19日

验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告及验资事项专项复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告及验资事项专项复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：_____

林万强

杨运辉

会计师事务所负责人：_____


黄锦辉

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

2017年8月19日



验资机构关于经办验资事项的签字会计师离职的声明

本验资机构就江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票并上市出具的验资报告及验资事项专项复核报告的签字注册会计师林万强和杨运辉已从本机构离职，特此声明。

会计师事务所负责人：



黄锦辉

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）



2014年8月19日

关于利安达会计师事务所有限责任公司转制为利安达会计师事务所 (特殊普通合伙)有关事项的说明

按照《财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财会[2010]12号)的通知要求,利安达会计师事务所有限责任公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作,转制后,原利安达会计师事务所有限责任公司更名为“利安达会计师事务所(特殊普通合伙)”。原利安达会计师事务所有限责任公司的执业资格和证券资格由利安达会计师事务所(特殊普通合伙)延续。

特此说明!

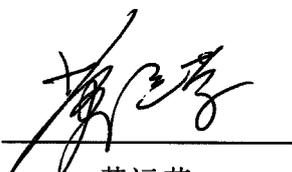
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)



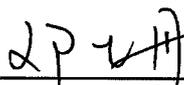
资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师：

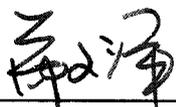

黄运荣

黄运荣



邓士丹

法定代表人：



郑文洋

沃克森（北京）国际资产评估有限公司



第十三节 附件

一、备查文件

在本次发行承销期内，下列文件均可在发行人和保荐人（主承销商）办公场所查阅：

- （一）发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告；
- （二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见；
- （三）发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见；
- （四）财务报表及审计报告；
- （五）内部控制鉴证报告；
- （六）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- （七）法律意见书及律师工作报告；
- （八）公司章程（草案）；
- （九）中国证监会核准本次发行的文件；
- （十）其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查时间、地点

（一）备查时间

周一至周五：9：00—11：30，14：00—17：00

（二）备查地点

发行人：	江苏捷捷微电子股份有限公司
地址：	江苏省启东科技创业园兴龙路8号
电话：	0513-83228813
传真：	0513-83220081

联系人： 沈欣欣、张家铨

保荐人（主承销商）： 西南证券股份有限公司

办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 29 楼

电话： 0755-83288685

传真： 0755-83288321

联系人： 武胜、杨锦雄、王晓红、李晓东、付新雄

（以下无正文）